

股票简称：斯达半导

股票代码：603290



斯达半导体股份有限公司

StarPower Semiconductor Ltd.

（浙江省嘉兴市南湖区科兴路 988 号）



向不特定对象发行可转换公司债券

募集说明书

（申报稿）

保荐人（主承销商）



中信证券股份有限公司
CITIC Securities Company Limited

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

二零二五年十月

声 明

中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。

任何投资者一经通过认购、交易、受让、继承或者其他合法方式持有本次债券，即视作同意《受托管理协议》《债券持有人会议规则》及本募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定，并同意委托中信证券股份有限公司担任受托管理人。

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列重大事项或风险因素，并认真阅读本募集说明书相关章节。

一、关于本次可转债发行符合发行条件的说明

根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法规规定，公司对申请向不特定对象发行可转换公司债券的资格和条件进行了认真审查，认为本公司符合关于向不特定对象发行可转换公司债券的各项资格和条件。

二、公司本次发行的可转换公司债券未提供担保

公司本次发行的可转债未提供担保措施。如果本次可转债存续期间出现对公司经营管理和偿债能力有重大负面影响的事件，本次可转债可能因未提供担保而存在兑付风险。

三、关于公司本次发行可转换公司债券的信用评级

大公国际资信评估有限公司对本次可转债进行了评级，根据大公国际资信评估有限公司出具的《斯达半导体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告（DGZX-R【2025】01362）》，公司主体信用等级为“AA₊st_i”，本次可转债信用等级为“AA₊st_i”，评级展望为稳定。

在本次发行的可转债存续期间，评级机构将对公司主体和本次可转债进行跟踪评级。如果由于外部经营环境、公司自身情况或评级标准变化等因素导致公司或本次可转债的信用评级级别变化，将会增大投资者的风险，对投资者的利益产生一定影响。

四、特别风险提示

公司提请投资者仔细阅读本募集说明书“风险因素”全文，并特别注意以下风险：

（一）宏观经济波动的风险

IGBT 归属于半导体行业。半导体行业渗透于国民经济的各个领域，行业整体波动性与宏观经济形势具有一定的关联性。公司产品主要应用于新能源汽车、新能源发电、工业控制及电源、变频白色家电等行业，如果宏观经济波动较大或长期处于低谷，上述行业的整体盈利能力会受到不同程度的影响，从而对公司的销售和利润带来负面影响。

（二）新能源汽车市场波动风险

根据中国汽车工业协会统计,2025 年上半年新能源汽车产销量分别为 696.8 万辆和 693.7 万辆,同比分别增长 41.4%和 40.3%,新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的 44.3%,出口市场表现尤为亮眼,新能源车出口量达 106 万辆,同比激增 75.2%。全球新能源汽车销量达到 946.9 万辆,同比增长 31.8%。新能源汽车继续保持稳定快速的增长势头,目前,新能源汽车占比已经接近 50%,可能存在后续渗透率减慢的风险。公司在此领域投入了大量研发经费,未来仍将继续加大该领域投入,虽然公司新能源汽车模块销售数量持续保持高速增长,但未来如果产业政策变化、汽车供应链器件配套、相关设施建设和推广速度以及客户认可度等因素影响,导致新能源汽车市场需求出现较大波动,将会对公司的盈利能力造成不利影响。

（三）经营业绩波动的风险

报告期内,公司的营业收入分别为 270,549.84 万元、366,296.54 万元、339,062.07 万元和 193,561.04 万元,公司归属于母公司所有者的净利润(以扣除非经常性损益前后孰低者计)分别为 76,235.69 万元、88,622.47 万元、48,736.56 万元和 26,106.82 万元。

公司在产品主要应用于新能源汽车、新能源发电、工业控制及电源、白色家电等领域,若上述下游市场出现需求波动或市场竞争加剧导致的产品单价下降等情形,可能使公司经营面临一定的不利影响,从而导致公司未来业绩存在下滑的风险。

（四）募集资金投资项目相关风险

1、募投项目建设进度不及预期的风险

公司本次募集资金投资的建设项目包括车规级 SiC MOSFET 模块制造项目、IPM 模块制造项目、车规级 GaN 模块产业化项目,是在公司现有业务的基础上依据业务发展规划所制定的。虽然公司根据行业发展现状和趋势对本次募投项目可行性进行了深入研究和充分论证,并在技术、人员、市场等方面作了较为充分的准备,但若出现募集资金不能及时到位、项目延期实施、市场或产业环境出现重大变化等情况,可能导致项目实施过程中的某一环节出现延误或停滞,公司募投项目存在不能全部按期建设完成的风险。

2、募投项目新增产能消化的风险

公司本次募集资金主要投向车规级 SiC MOSFET 模块、IPM 模块、车规级 GaN HEMT 模块等产品，募投项目建设达产后，相关产品的产能将实现较大提升。本次募投项目的新增产能规划是公司结合产业政策、行业发展趋势、市场需求及公司自身经营状况等因素谨慎论证后确定，具有较强的可行性和必要性，符合公司的战略规划和经营需要。但由于本次募投项目需要一定建设期，在项目实施过程中和项目建成后，若产业政策、市场环境等发生重大不利变化，可能导致公司新增产能无法消化的市场风险。

五、公司的利润分配政策及最近三年现金分红情况

（一）公司利润分配政策

为规范公司利润分配行为，推动公司建立科学、持续、稳定的利润分配机制，保护中小投资者合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告〔2025〕5号）等法律法规的要求，公司现行有效《公司章程》中规定的利润分配政策如下：

1、公司利润分配政策

（1）公司可以采取现金、股票或者现金加股票相结合的方式分配利润，具备现金分红条件的，应当优先采用现金分红进行利润分配；公司原则上每年进行一次利润分配，公司董事会可以根据公司情况提议在中期进行现金分红。

（2）现金分红的具体条件和比例

1）公司当年实现盈利，且弥补以前年度亏损和依法提取公积金后，累计未分配利润为正值，且审计机构对公司的该年度财务报告出具无保留意见的审计报告，公司应当采取现金方式分配利润。公司无重大资金支出等事项发生（募集资金投资项目除外），公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，但公司存在以前年度未弥补亏损的，以现金方式分配的利润不少于弥补亏损后的可供分配利润的10%。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。在公司具有成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素的情况下，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。

重大资金支出指：①公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累

计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且超过 5,000 万元人民币；②公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的 30%。

2) 公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

(3) 公司主要采取现金分红的利润分配政策，若公司营业收入增长快速，并且董事会认为公司股票价格与股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金利润分配条件下，提出并实施股票股利分配预案。

(4) 存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

(5) 公司发行证券、重大资产重组、合并分立或者因收购导致控制权发生变更的，公司应当在募集说明书或发行预案、重大资产重组报告书、权益变动报告书或者收购报告书中详细披露募集或发行、重组或者控制权发生变更后公司的现金分红政策及相应的安排、董事会对上述情况的说明等信息。

(6) 公司的利润分配应符合相关法律、法规的规定，且需要保持利润分配政策的连续性、稳定性。

2、公司利润分配的决策程序和机制

(1) 公司董事会根据公司盈利情况、资金需求和股东回报规划，结合独立董事、监事及中小股东的意见和诉求提出合理的分红建议和预案，公司在制定现金分红具体方

案时，董事会应当认真研究和论证时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见，经董事会审议通过后报公司股东大会批准后实施。如需调整利润分配方案，应重新履行上述程序。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红方案并直接提交董事会审议。公司至少每三年重新审议一次股东分红回报规划；若公司经营情况没有发生较大变化，可以参照最近一次制定或修订的分红回报规划执行，不另行制定三年分红回报规划。

（2）公司应当严格执行本章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。确有必要对本章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足本章程规定的条件，根据股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过；独立董事应对调整或变更的理由的真实性、充分性、合理性、审议程序的真实性和有效性以及是否符合本章程规定的条件等事项发表明确意见，且公司应在股东大会召开前与中小股东充分沟通交流，并及时答复中小股东关心的问题，必要时，可通过网络投票系统征集股东意见。

（3）公司调整现金分红政策的具体条件

1）公司发生亏损或者已发布预亏提示性公告的；

2）自利润分配的股东大会召开日后的两个月内，公司除募集资金、政府专项财政资金等专款专用或专户管理资金以外的现金（含银行存款、高流动性的债券等）余额均不足以支付现金股利；

3）按照既定分红政策执行将导致公司股东大会或董事会批准的重大投资项目、重大交易无法按既定交易方案实施的；

4）董事会有合理理由相信按照既定分红政策执行将对公司持续经营或保持盈利能力构成实质性不利影响的。

（4）公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。

3、现金分红的监督约束机制

（1）监事会应对董事会和管理层执行公司分红政策和股东回报规划的情况及决策

程序进行监督。

(2) 公司董事会、股东大会在对利润分配政策进行决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和中小股东的意见。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应通过多种渠道（包括但不限于开通专线电话、董秘信箱及邀请中小投资者参会等）主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

(3) 在公司有能力进行现金分红的情况下，公司董事会未做出现金分红预案的，应当说明未现金分红的原因、相关原因与实际情况是否相符合、未用于分红的资金留存公司的用途及收益情况，独立董事应当对此发表明确的独立意见。股东大会审议上述议案时，应为中小股东参与决策提供便利。

(4) 在公司盈利的情况下，公司董事会未做出现金利润分配预案或现金分红低于上述利润分配政策规定比例的，应当在定期报告中披露未分红或少分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。

(5) 公司应当在定期报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，说明是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分维护等。对现金分红政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。

（二）公司最近三年现金分红及未分配利润使用情况

1、最近三年现金分红情况

最近三年，公司利润分配情况如下表：

单位：万元

项目	2024 年	2023 年	2022 年
现金分红金额（含税）	15,230.27	27,315.87	24,529.27
归属于母公司所有者的净利润	50,766.63	91,052.60	81,764.29
占归属于母公司所有者的净利润的比率	30.00%	30.00%	30.00%
最近三年累计现金分红金额	67,075.41		
最近三年年均归属于母公司所有者的净利润	74,527.84		
最近三年累计现金分红金额/最近三年年均归属	90.00%		

项目	2024 年	2023 年	2022 年
于母公司所有者的净利润			

公司最近三年现金分红情况符合法律法规和《公司章程》的相关规定。为保持公司的可持续发展，公司历年滚存的未分配利润作为公司业务发展资金的一部分，继续投入公司生产经营，以支持公司长期可持续发展，提高公司的市场竞争力和盈利能力。

2、最近三年未分配利润使用情况

为保持公司的可持续发展，公司最近三年实现的归属于上市公司股东的净利润在提取法定盈余公积金及向股东分红后，当年剩余的未分配利润结转至下一年度，作为公司业务发展资金的一部分，主要用于日常经营、对外投资、项目开拓等方面，以支持公司长期可持续发展，提高公司的市场竞争力和盈利能力。公司未分配利润的使用安排符合公司的实际情况和公司全体股东利益。

目 录

声 明	1
重大事项提示	2
一、关于本次可转债发行符合发行条件的说明.....	2
二、公司本次发行的可转换公司债券未提供担保.....	2
三、关于公司本次发行可转换公司债券的信用评级.....	2
四、特别风险提示.....	2
五、公司的利润分配政策及最近三年现金分红情况.....	4
目 录	9
第一节 释义	12
一、一般术语.....	12
二、专业术语.....	13
第二节 本次发行概况	15
一、发行人基本情况.....	15
二、本次发行的背景和目的.....	15
三、本次发行基本情况.....	18
四、本次发行的有关机构.....	31
五、发行人与本次发行有关人员之间的关系.....	33
第三节 风险因素	34
一、与发行人相关的风险.....	34
二、与行业相关的风险.....	37
三、其他风险.....	37
第四节 发行人基本情况	40
一、公司发行前股本总额及前十名股东持股情况.....	40
二、公司组织结构及对外投资情况.....	40
三、控股股东和实际控制人的基本情况及上市以来的变化情况.....	43
四、承诺事项履行情况.....	45
五、公司董事、监事、高级管理人员.....	46
六、发行人特别表决权股份或类似安排.....	53
七、公司所处行业的基本情况.....	53

八、公司主营业务具体情况.....	61
九、公司的核心技术及研发情况.....	70
十、公司的主要固定资产及无形资产.....	76
十一、业务经营许可情况.....	79
十二、安全生产和环境保护.....	81
十三、公司上市以来重大资产重组情况.....	81
十四、公司境外经营情况.....	81
十五、报告期内的分红情况.....	81
十六、公司最近三年发行的债券情况和其他债务情况.....	89
第五节 财务会计信息与管理层分析	90
一、会计师事务所的审计意见类型及重要性水平.....	90
二、最近三年及一期财务报表.....	90
三、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及其变化情况.....	95
四、最近三年及一期主要财务指标及非经常性损益明细表.....	97
五、会计政策、会计估计及重大会计差错更正.....	99
六、财务状况分析.....	101
七、经营成果分析.....	118
八、现金流量分析.....	128
九、资本性支出分析.....	131
十、技术创新分析.....	131
十一、重大担保、仲裁、诉讼、其他或有事项和重大期后事项.....	132
十二、本次发行的影响.....	132
第六节 合规经营与独立性	134
一、公司报告期内受到的行政处罚.....	134
二、公司及董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人报告期内被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况.....	134
三、关联方资金占用情况.....	134
四、同业竞争情况.....	134
五、关联方和关联交易情况.....	136
第七节 本次募集资金运用	143
一、本次募集资金使用计划.....	143

二、本次募集资金投资项目的具体情况.....	145
三、本次募投项目与前次募投项目的区别和联系.....	155
四、本次募集资金用于扩大既有业务的相关说明.....	156
五、本次募集资金用于研发投入的情况.....	158
六、本次募投项目符合国家产业政策.....	158
七、本次发行对公司的影响分析.....	158
第八节 历次募集资金运用	160
一、前次募集资金的募集及存放情况.....	160
二、前次募集资金使用情况.....	162
三、注册会计师对前次募集资金使用情况的审核意见.....	169
第九节 声明	170
一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明.....	170
一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明.....	175
一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明.....	176
二、控股股东、实际控制人声明.....	177
三、保荐机构（主承销商）声明.....	178
保荐机构总经理声明.....	179
保荐机构董事长声明.....	180
四、律师事务所声明.....	181
五、会计师事务所声明.....	182
六、资信评级机构声明.....	184
七、发行人董事会关于本次发行的声明及承诺.....	186
第十节 备查文件	190
一、备查文件内容.....	190
二、备查文件查询时间及地点.....	190
附件一：发行人及其控股子公司专利情况	191
附件二：发行人及其控股子公司商标情况	209
附件三：发行人持有的不动产情况	210

第一节 释义

本募集说明书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下含义：

一、一般术语

公司、本公司、发行人、斯达半导、斯达半导体	指	斯达半导体股份有限公司
本募集说明书	指	《斯达半导体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》
香港斯达	指	香港斯达控股有限公司，系公司发起人及控股股东
浙江兴得利	指	浙江兴得利纺织有限公司，系公司发起人及现有股东之一
富瑞德投资	指	嘉兴富瑞德投资合伙企业（有限合伙），系公司发起人及现有股东之一
斯达控股	指	STARPOWER PACIFIC GROUP LIMITED，注册地为英属维尔京群岛，系香港斯达唯一股东
上海道之	指	上海道之科技有限公司，系公司控股子公司
浙江谷蓝	指	浙江谷蓝电子科技有限公司，系公司全资子公司
斯达电子	指	嘉兴斯达电子科技有限公司，系公司全资子公司
斯达欧洲	指	斯达半导体欧洲股份公司（StarPower Europe AG），系公司控股子公司
斯达微电子	指	嘉兴斯达微电子有限公司，系公司全资子公司
斯达集成	指	嘉兴斯达集成科技有限公司，系公司全资子公司
重庆安达	指	重庆安达半导体有限公司，系公司控股子公司
斯达香港	指	斯达半导体（香港）有限公司，系公司全资子公司
斯达重庆	指	斯达半导体（重庆）有限公司，系公司全资子公司
美垦半导体	指	美垦半导体技术有限公司，系公司控股子公司
港禾逸蓝	指	嘉兴港禾逸蓝科技有限公司
《受托管理协议》	指	《斯达半导体股份有限公司可转换公司债券受托管理协议》
《债券持有人会议规则》	指	《斯达半导体股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》
《公司章程》	指	《斯达半导体股份有限公司章程》及其修正案
本次发行、本次向不特定对象发行、本次发行的可转换公司债券、本次可转债、本次发行的可转债、本期可转债	指	斯达半导体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
实际控制人	指	沈华、胡畏
控股股东	指	香港斯达控股有限公司，为发行人之控股股东
保荐机构、保荐人、中信证券、主承销商、受托管理人	指	中信证券股份有限公司

发行人律师	指	北京海润天睿律师事务所
申报会计师	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
评级公司	指	大公国际资信评估有限公司
董事会	指	斯达半导体股份有限公司董事会
监事会	指	斯达半导体股份有限公司监事会
股东大会	指	斯达半导体股份有限公司股东大会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
报告期、报告期各期、最近三年及一期	指	2022 年度、2023 年度、2024 年度和 2025 年 1-6 月
报告期内	指	2022 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
报告期各期末	指	2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日、2024 年 12 月 31 日和 2025 年 6 月 30 日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

二、专业术语

IGBT	指	Insulated Gate Bipolar Transistor 的缩写，绝缘栅双极型晶体管，由双极结型晶体管（BJT）和金属氧化物场效应晶体管（MOSFET）组成的复合全控型电压驱动式电力电子器件，是半导体器件的一种
SiC	指	碳化硅，是一种无机物，是用石英砂、石油焦（或煤焦）、木屑（生产绿色碳化硅时需要加食盐）等原料通过电阻炉高温冶炼而成，其化学性能稳定、导热系数高、热膨胀系数小、耐磨性能好
GaN	指	氮化镓是一种无机物，是氮和镓的化合物，是一种直接能隙（direct bandgap）的半导体，可以用在高功率、高速的光电元件中
BJT	指	Bipolar Junction Transistor，双极结型晶体管，是一种电流控制的半导体分立器件
MOSFET	指	Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor，指金属氧化物场效应晶体管，是一种高频的半导体器件
IPM	指	Intelligent Power Module，智能功率模块，一种将功率开关器件和驱动电路等集成在一起的半导体模块
导通压降	指	三极管和二极管道通时，两端的电压差
晶圆	指	用于制作芯片的圆形硅晶体半导体材料
衬底	指	具有特定晶面和适当电学、光学和机械特性的用于生长外延层的洁净单晶薄片
外延	指	单晶衬底表面沿特定晶向生长原子级匹配的单晶薄层的工艺技术
二极管	指	一种具有单向传导电流的电子器件
快恢复二极管（FRD）	指	一种具有开关特性好、反向恢复时间短特点的半导体二极管
SiC MOSFET	指	以 SiC 材料制造的金属-氧化物半导体场效应晶体管，属于第三代半导体器件
GaN HEMT	指	氮化镓基高电子迁移率晶体管（High Electron Mobility Transistor）的简称，属于宽禁带半导体器件，具有高频、高效、低损耗的特点

MCU	指	一种集成化的微型计算机系统，它将处理器核心（CPU）、存储器（FLASH/RAM/ROM）、输入/输出接口（GPIO、UART、SPI 等）以及定时器/计数器等功能模块集成在一块芯片上用于控制和驱动各种机械或电子设备
SiC SBD	指	特基二极管是通过金属与 N 型半导体之间形成的接触势垒具有整流特性而制成的一种属-半导体器件
频率	指	正弦交流电流在单位时间内作周期性循环变化的次数
赫兹	指	交流电中频率的基本单位
变频器	指	把工频电源（50Hz 或 60Hz）变换成各种频率的交流电源，以实现电机的变速运行的设备
高压变频器	指	针对 3kV 至 10kV 等高电压环境下运行的电动机而开发的变频器

注：本募集说明书中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的；本募集说明书中第三方数据不存在专门为本次发行准备的情形，发行人亦未为此支付费用或提供帮助。

第二节 本次发行概况

一、发行人基本情况

中文名称：斯达半导体股份有限公司

英文名称：StarPower Semiconductor Ltd.

注册地址：浙江省嘉兴市南湖区科兴路 988 号

股票简称：斯达半导

股票代码：603290

股票上市地：上海证券交易所

二、本次发行的背景和目的

（一）本次发行的背景

1、我国功率半导体行业发展情况良好，市场需求持续增长

半导体产业作为电子信息产业的基础，是国家引领新一轮科技革命和产业变革的关键力量，其发展在提升我国科技进步和经济发展的过程中起到了举足轻重的作用。作为半导体产业的重要组成部分，功率半导体主要用于改变电力电子设备中电压和频率、直流交流转换等，是电力电子设备中电能转换与电路控制的核心器件，在整个电子产业链中几乎均有着广泛的应用。为确保功率半导体相关产业健康、快速发展，近年来我国相继出台了一系列政策支持产业发展与核心技术突破。2020 年发布的《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》明确将第三代半导体列为重点支持对象；2021 年，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 远景目标纲要》中，将第三代半导体纳入战略性新兴产业重点发展方向，明确支持宽禁带半导体材料的研发与产业化，推动其在 5G 通信、新能源汽车、光伏等领域的应用；2021 年，科技部在重点研发计划中单列第三代半导体专项，通过“战略性先进电子材料”等重点专项，资助第三代半导体材料与器件的研发项目；2023 年，工信部等六部门联合印发《关于推动能源电子产业发展的指导意见》，在“专栏 3 能源电子关键信息技术产品供给能力提升行动”功率半导体器件中提出，我国要“面向光伏、风电、储能系统、半导体照明等，发展新能源用耐高温、耐高压、低损耗、高可靠 IGBT 器件及模块，SiC、GaN

等先进宽禁带半导体材料”。

得益于我国大力推进科技创新和产业创新，除工业控制、消费电子等传统应用领域外，新能源汽车、充电桩、光伏风电储能、变频家电、数据中心、轨道交通等市场也极大助推了我国功率半导体行业的快速发展，行业整体呈稳定增长的发展态势。根据 Omdia 的数据，2023 年全球功率半导体市场规模约 503 亿美元，预计 2027 年将增长至 596 亿美元。

我国是全球主要的功率半导体消费国之一，在全球半导体产业链中占有极其重要的地位。未来随着国内产业链的进一步完善以及半导体材料、芯片设计、工艺、制造等核心技术的持续突破，国内企业的自主创新能力和市场竞争力还将持续提升，进一步推动我国功率半导体行业的发展壮大。

2、第三代半导体材料已成为功率半导体行业发展的重要趋势之一

半导体材料按照引入时间和禁带宽度不同，主要分为以硅（Si）、砷化镓（GaAs）为代表的第一代和第二代半导体材料，和以碳化硅（SiC）、氮化镓（GaN）为代表的第三代半导体材料。其中第三代半导体材料又被称为宽禁带半导体材料，因具有宽禁带、高导热率、高击穿场强、高饱和电子迁移率等特性，所制备出的半导体器件拥有强大的功率处理能力、较高的开关频率、更高的电压驱动能力、更小的尺寸和更高速的散热能力等特征，在能量效率和空间尺寸要求较高的电子器件应用中具备先天性能优势。

碳化硅（SiC）和氮化镓（GaN）是目前主流的第三代半导体材料，具有大功率、耐高压、耐高温的特点，符合当下功率半导体器件的应用发展需求，已成为行业研发和产业化应用的重点。目前，得益于 SiC 衬底材料、外延技术以及芯片设计、工艺、制造等环节的不断成熟，SiC MOSFET 模块已开始在新能源汽车主电机控制器中规模化应用。根据 CASA Research 的数据，目前国内第三代功率半导体已开始进入高速增长阶段，2023 年第三代功率器件模块市场规模约为 153.2 亿元，同比增长 45%，其中新能源汽车用第三代功率器件模块市场约 104.1 亿元，预计到 2027 年将达到 347.3 亿元；此外，GaN 已成为继 SiC 之后最受关注的第三代半导体材料，区别于 SiC 更适合高压、高功率场景，GaN 在中低压、高频率应用中展现出更强的性能优势，二者在新能源汽车驱动系统和充电系统中呈现互补发展趋势。随着下游整车厂对高效率、小型化、高可靠性功率器件的需求持续增长，GaN 模块在高性能车载充电器和充电桩领域的应用正加速

深化，产业链也在加快布局，有望成为推动新能源汽车产业快速发展的关键技术支撑。

3、变频白色家电的快速发展为 IPM 模块带来广阔市场需求

近年来，随着我国家电行业节能减排政策的持续推进以及消费者对绿色环保的关注度不断提升，变频技术在空调、冰箱、洗衣机等白色家电中的应用加速普及。相较于传统定频家电，变频技术通过动态调整电机运行频率，实现更精准的功率控制，具备节能、高效、低噪音等优势，契合家电行业向低碳、高效方向发展的趋势。IPM 模块因其集成驱动、电流检测、过流保护等功能，在提升电机驱动性能、提高系统效率方面发挥关键作用，系变频家电不可或缺的关键组件之一。因此，变频技术的广泛应用不仅推动了家电产品向高效、智能方向升级，也带来了对于 IPM 模块这一功率半导体器件更多的需求。

当前，我国家电市场正加速向高效、智能、绿色方向发展，变频家电渗透率持续提升。根据产业在线数据，2024 年中国白色家电市场总产量同比上涨 15.80%，对 IPM 模块的国内需求规模达到 4.4 亿颗，同比增长 20.8%。白色家电市场规模庞大，发展前景广阔，变频白色家电的快速发展为 IPM 模块带来了广阔市场空间。

（二）本次发行的目的

1、把握行业发展机遇，保持公司车规级功率模块的领先地位

公司自成立以来一直专注于以 IGBT 和 SiC 为主的功率半导体芯片和模块的设计研发、生产及销售，多年来持续加大技术创新和产品优化力度，相关产品深受国内外市场的认可和信赖。在 SiC 领域，公司自 2020 年起陆续获得了国内外多个 SiC MOSFET 主电机控制器项目定点，并于 2022 年实现国内首个 800V 高压 SiC 主电机控制器平台批量装车。目前，公司车规级 SiC MOSFET 芯片和模块已经在国内外主流整车厂多车型大批量装车，产品销量持续快速增长。

在新能源汽车主电机控制器领域，除车规级 IGBT 模块和 SiC MOSFET 模块外，GaN 模块也逐步成为解决方案之一。公司作为国内新能源汽车车规级功率半导体模块的主要供应商，需要丰富自身产品结构，为客户提供全系列的解决方案。2024 年，公司开发出车规级 GaN 模块，针对 30kW-150kW 车用驱动应用，预计将于 2027 年进入装车应用阶段。

通过车规级 SiC MOSFET 模块制造项目和车规级 GaN 模块产业化项目的实施，公司将充分利用自身在新能源汽车领域的行业地位及技术优势，把握新能源汽车领域快速

发展的历史机遇，顺应第三代半导体技术发展趋势，加速产品迭代升级，抢占车规级第三代功率半导体市场先机，满足客户对车规级第三代功率模块的技术和市场需求，夯实公司在车规级功率器件领域的竞争优势，保持公司在新能源汽车领域的领先地位。

2、丰富公司白色家电领域产品结构，进一步提升公司在白色家电领域的市场占有率与行业地位

公司 IPM 模块已在工业变频器、伺服器、车用空调等领域广泛应用，产品技术成熟、质量稳定，得到了客户的高度认可。白色家电行业是公司重点布局行业之一，公司已在大型商用变频空调领域积累了一大批高黏性的家电行业客户，与美的、格力、海信、海尔等国内主流家电行业客户形成了密切的合作关系。通过 IPM 模块制造项目的实施，公司将依托现有优质家电行业客户群体，加快 IPM 模块在白色家电领域的市场渗透，推动产品在变频白色家电等应用场景中的规模化配套，进一步提升公司在白色家电领域的市场占有率与行业地位。

3、降低公司财务风险，保障公司的持续、稳定、健康发展

本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金部分用于补充流动资金，有利于缓解公司的资金压力，推进公司业务规模的拓展，保障了公司研发创新及业务扩张等活动的持续正常开展，降低公司财务风险，保障公司的持续、稳定、健康发展。

三、本次发行基本情况

（一）本次发行的基本条款

1、发行证券的种类

本次发行证券的品种为向不特定对象发行可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该等可转换公司债券及未来转换的 A 股股票将在上海证券交易所上市。

2、发行规模

根据相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 150,000.00 万元（含本数），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在上述额度范围内确定。

3、票面金额和发行价格

本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行。

4、债券期限

本次发行的可转换公司债券期限为自发行之日起六年。

5、票面利率

本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

本次可转换公司债券在发行完成前如遇银行存款利率调整，则股东大会授权董事会（或由董事会授权人士）对票面利率作相应调整。

6、付息的期限和方式

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还未偿还的可转换公司债券本金并支付最后一年利息。

（1）年利息计算

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为： $I=B \times i$

I：指年利息额；

B：指本次可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的本次可转债票面总金额；

i：指本次可转换公司债券当年票面利率。

（2）付息方式

1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次可转换公司债券发行首日。

2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当

日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会或董事会授权人士根据相关法律、法规及上海证券交易所的规定确定。

3) 付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司 A 股股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

4) 在本次发行的可转换公司债券到期日之后的五个交易日内，公司将偿还所有到期未转股的可转换公司债券本金及最后一年利息。

5) 本次发行的可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人承担。

7、转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。

8、转股价格的确定及调整

(1) 初始转股价格的确定依据

本次可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。具体初始转股价格由公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）在发行前根据市场状况与保荐机构（主承销商）协商确定。

若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算。

前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

(2) 转股价格的调整方式及计算公式

在本次可转债发行之后，若公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因

本次可转债转股而增加的股本）或配股、派送现金股利等情况使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： $P1=P0/(1+n)$

增发新股或配股： $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$

上述两项同时进行： $P1=(P0+A\times k)/(1+n+k)$

派送现金股利： $P1=P0-D$

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A\times k)/(1+n+k)$

其中： $P0$ 为调整前转股价， n 为送股或转增股本率， k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价， D 为每股派送现金股利， $P1$ 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依此进行转股价格调整，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他信息披露媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后、转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作方法将依据届时国家有关法律法规、证券监管部门和上海证券交易所的相关规定来制订。

9、转股价格向下修正条款

（1）修正条件及修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85% 时，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的

较高者。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

(2) 修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他信息披露媒体刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

10、转股股数的确定方式

本次可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为： $Q=V/P$ ，并以去尾法取一股的整数倍。

其中：Q 指转股数量；V 为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额；P 为申请转股当日有效的转股价格。

本次发行的可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。本次发行的可转换公司债券持有人申请转股后，转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额，公司将按照上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司等机构的有关规定，在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券余额及该余额对应的当期应计利息。

11、赎回条款

(1) 到期赎回条款

在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转换公司债券，具体赎回价格由公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）在本次发行前根据发行时市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

(2) 有条件赎回条款

在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果下述两种情形的任意一种出现时，公

司有权按照本次可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转换公司债券：

1) 公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；

2) 当本次可转债未转股余额不足人民币 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为： $I_A = B \times i \times t / 365$

I_A ：指当期应计利息；

B ：指本次可转债持有人持有的将赎回的本次可转债票面总金额；

i ：指本次可转债当年票面利率；

t ：指计息天数，首个付息日前，指从计息起始日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）；首个付息日后，指从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

本次可转债的赎回期与转股期相同，即发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

12、回售条款

（1）有条件回售条款

在本次可转换公司债券最后两个计息年度内，如果公司股票收盘价在任何连续三十个交易日低于当期转股价格 70% 时，本次可转债持有人有权将其持有的本次可转债全部或部分以面值加上当期应计利息回售给公司。

若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上

述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起按修正后的转股价格重新计算。

当期应计利息的计算方式参见赎回条款的相关内容。

本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，可转换公司债券持有人在每个计息年度回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。

（2）附加回售条款

若本次可转债募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺相比出现重大变化，且根据中国证监会或上海证券交易所的相关规定被视作改变募集资金用途或被认定为改变募集资金用途的，本次可转债持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的部分或者全部本次可转债的权利。在上述情形下，本次可转债持有人可以在公司公告后的回售申报期内进行回售，本次回售申报期内不实施回售的，自动丧失该回售权。

当期应计利息的计算方式参见赎回条款的相关内容。

13、转股年度有关股利的归属

因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转换公司债券转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。

14、发行方式及发行对象

本次可转换公司债券的具体发行方式由公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）与保荐机构（主承销商）协商确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

15、向原股东配售的安排

本次发行的可转换公司债券向公司现有股东优先配售，现有股东有权放弃优先配售权。向现有股东优先配售的具体比例由公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）

在本次发行前根据市场情况与保荐人（主承销商）协商确定，并在本次发行的可转换公司债券的发行公告中予以披露。

公司现有股东享有优先配售之外的余额和现有股东放弃优先配售部分采用网下对机构投资者发售及/或通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由承销商包销。具体发行方式由公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）在本次发行前根据市场情况与保荐人（主承销商）协商确定。

16、债券持有人会议相关事项

（1）债券持有人的权利

- 1) 依照其所持有可转债数额享有约定利息；
- 2) 根据约定条件将所持有的可转债转为公司股份；
- 3) 根据约定的条件行使回售权；
- 4) 依照法律、行政法规及《公司章程》的规定转让、赠与或质押其所持有的可转债；
- 5) 依照法律、《公司章程》的规定获得有关信息；
- 6) 按约定的期限和方式要求公司偿付可转债本息；
- 7) 依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权。
- 8) 法律、行政法规及《公司章程》所赋予的其作为公司债权人的其他权利。

（2）债券持有人的义务

- 1) 遵守公司发行可转债条款的相关规定，遵守《可转债募集说明书》的相关约定；
- 2) 依其所认购的可转债数额缴纳认购资金；
- 3) 遵守债券持有人会议形成的有效决议；
- 4) 除法律、法规规定及《可转债募集说明书》约定之外，不得要求公司提前偿付可转债的本金和利息；
- 5) 债券受托管理人依受托管理协议约定所从事的受托管理行为的法律后果，由本

次债券持有人承担。债券受托管理人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后所从事的行为，未经债券持有人会议决议追认的，不对全体债券持有人发生效力，由债券受托管理人自行承担其后果及责任；

6) 不得从事任何有损公司、债券受托管理人及其他债券持有人合法权益的活动；

7) 如债券受托管理人根据受托管理协议约定对公司启动诉讼、仲裁、申请财产保全或其他法律程序的，债券持有人应当承担相关费用（包括但不限于诉讼费、律师费、公证费、各类保证金、担保费，以及债券受托管理人因按债券持有人要求采取的相关行动所需的其他合理费用或支出），不得要求债券受托管理人作为其先行垫付；

8) 法律、行政法规及《公司章程》规定应当由可转债持有人承担的其他义务。

(3) 在本次可转债存续期间内及期满赎回期限内，当出现以下情形之一时，应当召集债券持有人会议

1) 公司拟变更《可转债募集说明书》的约定；

①变更债券偿付基本要素（包括偿付主体、期限、票面利率调整机制等）；

②变更增信或其他偿债保障措施及其执行安排；

③变更债券投资者保护措施及其执行安排；

④变更《可转债募集说明书》约定的募集资金用途；

⑤其他涉及债券本息偿付安排及与偿债能力密切相关的重大事项变更。

2) 拟修改本债券持有人会议规则；

3) 拟变更债券受托管理人或受托管理协议的主要内容（包括但不限于受托管理事项授权范围、利益冲突风险防范解决机制、与债券持有人权益密切相关的违约责任等约定）；

4) 公司不能按期支付当期应付的本次可转债本息；

5) 公司减资（因员工持股计划、股权激励或公司为维护公司价值及股东权益所必需回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散或者申请破产或者依法进入破产程序；

6) 担保人（如有）或者其他偿债保障措施发生重大变化；

7) 公司董事会、单独或者合计持有本次可转债未偿还债券面值总额 10%以上的债

券持有人书面提议召开；

- 8) 公司管理层不能正常履行职责，导致公司债务清偿能力面临严重不确定性；
- 9) 公司提出债务重组方案的；
- 10) 发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；
- 11) 根据法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所及债券持有人会议规则的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。

(4) 下列机构或人士可以书面提议召开债券持有人会议：

- 1) 公司董事会；
- 2) 单独或合计持有未偿还债券面值总额 10%以上的持有人；
- 3) 可转债受托管理人；
- 4) 中国证监会规定的其他机构或人士。

(5) 投资者认购、持有或受让本次可转债，均视为其同意本次可转债债券持有人会议规则的所有规定并接受其约束。

17、本次募集资金用途

本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币 150,000.00 万元（含本数），募集资金总额扣除发行费用后用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额
1	车规级 SiC MOSFET 模块制造项目	100,245.26	60,000.00
2	IPM 模块制造项目	30,080.35	27,000.00
3	车规级 GaN 模块产业化项目	30,107.68	20,000.00
4	补充流动资金项目	43,000.00	43,000.00
合计		203,433.29	150,000.00

在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。

项目投资总额高于本次募集资金净额部分由公司自有资金或自筹方式解决。在上

述募集资金投资项目的范围内，公司董事会或董事会授权人士可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的具体金额进行适当调整。

18、担保事项

本次发行的可转换公司债券不提供担保。

19、评级事项

大公国际资信评估有限公司对本次发行的可转债进行了评级，根据大公国际资信评估有限公司出具的《斯达半导体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告（DGZX-R【2025】01362）》，公司主体信用等级为“AA⁺_{stt}”，本次可转债信用等级为“AA⁺_{stt}”，评级展望为稳定。

在本次发行的可转债存续期间，大公国际资信评估有限公司将每年至少进行一次跟踪评级，并出具跟踪评级报告。

20、募集资金存管

公司已经制订了募集资金管理相关制度，本次发行可转换公司债券的募集资金将存放于公司董事会指定的募集资金专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会或董事会授权人士确定，并在发行公告中披露募集资金专项账户的相关信息。

21、本次发行方案的有效期

公司本次可转债发行方案的有效期为十二个月，自本次发行方案经股东大会审议通过之日起计算。

（二）违约责任及争议解决机制

1、以下任一事件均构成公司在受托管理协议和本期可转债项下的违约事件

（1）在本期可转债到期时，公司未能偿付到期应付本金和/或利息；

（2）公司不履行或违反受托管理协议项下的任何承诺或义务（第（1）项所述违约情形除外）且将对公司履行本期可转债的还本付息产生重大不利影响，在经可转债受托管理人书面通知，或经单独或合并持有本期可转债未偿还面值总额 10%以上的可转债持有人书面通知，该违约在上述通知所要求的合理期限内仍未予纠正；

（3）公司在其资产、财产或股份上设定担保以致对公司就本期可转债的还本付息

能力产生实质不利影响,或出售其重大资产等情形以致对公司就本期可转债的还本付息能力产生重大实质性不利影响;

(4) 在本期可转债存续期间内,公司发生解散、注销、吊销、停业、清算、丧失清偿能力、被法院指定接管人或已开始相关的法律程序;

(5) 任何适用的现行或将来的法律、规则、规章、判决,或政府、监管、立法或司法机构或权力部门的指令、法令或命令,或上述规定的解释的变更导致公司在受托管协议或本期可转债项下义务的履行变得不合法;

(6) 在本期可转债存续期间,公司发生其他对本期可转债的按期兑付产生重大不利影响的情形。

2、违约责任及其承担方式

上述违约事件发生时,公司应当承担相应的违约责任,包括但不限于按照募集说明书的约定向可转债持有人及时、足额支付本金及/或利息以及迟延履行本金及/或利息产生的罚息、违约金等,并就可转债受托管理人因公司违约事件承担相关责任造成的损失予以赔偿。

3、可转债发生违约后的诉讼、仲裁或其他争议解决机制

本期可转债发行适用于中国法律并依其解释。本期可转债发行和存续期间所产生的争议,首先应在争议各方之间协商解决;协商不成的,应在公司住所所在地有管辖权的人民法院通过诉讼解决。

当产生任何争议及任何争议正按前条约定进行解决时,除争议事项外,各方有权继续行使本期可转债发行及存续期的其他权利,并应履行其他义务。

(三) 发行方式与发行对象

本次可转换公司债券的具体发行方式由公司股东大会授权董事会(或董事会授权人士)与保荐人(主承销商)协商确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。

(四) 承销方式及承销期

本次发行的可转换公司债券由保荐机构(主承销商)中信证券股份有限公司以余额

包销方式承销。

本次可转换公司债券的承销期为【】年【】月【】日至【】年【】月【】日。

（五）发行费用

单位：万元

项目	金额
保荐及承销费用	【】
律师费用	【】
审计、资信评级及验资费用	【】
信息披露、路演推介、登记及其他费用	【】
合计	【】

（六）承销期间的停牌、复牌及证券上市的时间安排

1、承销期间的停牌、复牌及与本次发行有关的时间安排

日期	发行安排	停牌安排
T-2 日	1、刊登《募集说明书》《募集说明书提示性公告》《发行公告》《网上路演公告》	正常交易
T-1 日	1、原股东优先配售股权登记日 2、网上路演	正常交易
T 日	1、发行首日 2、刊登《发行提示性公告》 3、原股东优先配售认购日（缴付足额资金） 4、网上申购（无需缴付申购资金） 5、确定网上中签率	正常交易
T+1 日	1、刊登《网上中签率及优先配售结果公告》 2、网上申购摇号抽签	正常交易
T+2 日	1、刊登《网上中签结果公告》 2、网上投资者根据中签号码确认认购数量并缴纳认购款（投资者确保资金账户在 T+2 日日终有足额的转债认购资金）	正常交易
T+3 日	保荐人（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额	正常交易
T+4 日	1、刊登《发行结果公告》 2、向发行人划付募集资金	正常交易

上述日期为交易日，如相关监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重大突发事件影响发行，公司将与保荐人（主承销商）协商后修改发行日程并及时公告。

2、本次发行证券上市的时间安排和申请上市证券交易所

本次发行结束后，公司将尽快向上交所申请本次发行的可转换公司债券上市挂牌交易，具体上市时间将另行公告。

（七）本次发行证券的上市流通

本次发行结束后，所有投资者均无持有期限限制，公司将尽快申请可转换公司债券在上海证券交易所挂牌上市交易，具体上市时间公司将另行公告。

（八）本次发行符合理性融资，合理确定融资规模

本次募投项目符合行业发展趋势，突出上市公司主营业务未来发展方向。本次募投项目的资金需求，系综合考虑公司经营状况确定的融资规模，具有合理性。

本次发行属于向不特定对象发行可转换公司债券，不适用《证券期货法律适用意见第18号》第四条中关于融资间隔的规定。

四、本次发行的有关机构

（一）发行人

名称：斯达半导体股份有限公司

法定代表人：沈华

住所：浙江省嘉兴市南湖区科兴路988号

联系人：李君月

联系电话：0573-82586699

传真：0573-82588288

（二）保荐人（主承销商）

名称：中信证券股份有限公司

法定代表人：张佑君

住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

保荐代表人：郑绪鑫、孟夏

项目协办人：孙骏

经办人员：陈灏蓝、余梓轩、苏天毅、王祝遥、凌峰、马凯、杨翔

联系电话：021-20262000

传真：021-20262004

（三）律师事务所

名称：北京海润天睿律师事务所

负责人：颜克兵

住所：北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5 层、9 层、10 层、13 层、17 层

经办律师：王振、周德芳、张豪东

联系电话：010-65219696

（四）会计师事务所

名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：杨志国

住所：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

签字注册会计师：杨景欣、欧阳妍霆、周芳芳（已离职）

联系电话：021-23280000

传真：021-63392558

（五）申请上市的证券交易所

名称：上海证券交易所

住所：上海市浦东新区杨高南路 388 号

联系电话：021-68808888

传真：021-68804868

（六）收款银行

户名：中信证券股份有限公司

账号：【】

开户行：中信银行北京瑞城中心支行

（七）资信评级机构

名称：大公国际资信评估有限公司

法定代表人：吕柏乐

住所：北京市西城区三里河二区甲 18 号 01-04

经办评级人员：张行行、房思旗

联系电话：010-67413300

传真：010-67413555

（八）登记结算机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

住所：上海市浦东新区杨高南路 188 号

联系电话：021-58708888

传真：021-58899400

五、发行人与本次发行有关人员之间的关系

截至 2025 年 6 月 30 日，保荐机构、主承销商和受托管理人中信证券自营业务股票账户持有发行人 107,397 股，信用融券专户持有发行人 4,760 股，中信证券全资子公司合计持有发行人 107,100 股，中信证券控股子公司华夏基金管理有限公司持有发行人 480,260 股，合计占发行人总股本的 0.29%。中信证券已建立并执行严格的信息隔离墙制度，上述情形不会影响中信证券公正履行保荐及承销责任。

除上述情形外，发行人与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间不存在其他直接或间接的股权关系或其他利益关系。

第三节 风险因素

一、与发行人相关的风险

（一）募集资金投资项目相关风险

1、募投项目建设进度不及预期的风险

公司本次募集资金投资的建设项目包括车规级 SiC MOSFET 模块制造项目、IPM 模块制造项目、车规级 GaN 模块产业化项目，是在公司现有业务的基础上依据业务发展规划所制定的。虽然公司根据行业发展现状和趋势对本次募投项目可行性进行了深入研究和充分论证，并在技术、人员、市场等方面作了较为充分的准备，但若出现募集资金不能及时到位、项目延期实施、市场或产业环境出现重大变化等情况，可能导致项目实施过程中的某一环节出现延误或停滞，公司募投项目存在不能全部按期建设完成的风险。

2、募投项目新增产能消化的风险

公司本次募集资金主要投向车规级 SiC MOSFET 模块、IPM 模块、车规级 GaN HEMT 模块等产品，募投项目建设达产后，相关产品的产能将实现较大提升。本次募投项目的新增产能规划是公司结合产业政策、行业发展趋势、市场需求及公司自身经营状况等因素谨慎论证后确定，具有较强的可行性和必要性，符合公司的战略规划和经营需要。但由于本次募投项目需要一定建设期，在项目实施过程中和项目建成后，若产业政策、市场环境等发生重大不利变化，可能导致公司新增产能无法消化的市场风险。

3、募投项目效益不达预期的风险

本次募投项目中，车规级 SiC MOSFET 模块制造项目、IPM 模块制造项目和车规级 GaN 模块产业化项目进行了效益测算，待项目建设完成并达产后，预计可获得较好的经济效益。本次募投项目效益测算是基于项目如期建设完毕并按计划投产后实现销售，因此若项目建设进度不及预期、产品价格或成本出现大幅波动或者未来行业技术发展趋势出现重大变化，可能对本次募投项目的效益释放带来一定影响，募投项目可能面临短期内不能实现预测收入和利润的风险。同时，由于下游客户实际采购需求和本次募投项目的测算可能存在差距，如果本次募投项目的销售进展无法达到预期，可能导致本次募投项目面临营业收入和利润总额等经营业绩指标下滑，投资回报率降低的风险。

（二）经营风险

1、客户集中度较高的风险

报告期内，公司对前五名客户的销售金额合计分别为 115,289.00 万元、132,791.92 万元、113,483.61 万元和 66,610.24 万元，占公司营业收入的比例分别为 42.61%、36.25%、33.47%和 34.41%。如果未来部分大客户经营情况不利，或选择其他供应商，从而降低对公司产品的采购，将会影响公司经营业绩。

2、原材料价格波动风险

公司产品主要原材料为 SiC MOSFET 芯片、IGBT 芯片、快恢复二极管芯片、GaN HEMT 芯片等功率半导体芯片以及 DBC、散热基板和其他材料，直接材料占公司产品总成本比例较高。公司原材料的采购价格依据市场价格确定，近年市场价格有所波动，由于直接材料成本占公司产品成本比例较高，其价格的波动会导致产品销售成本、毛利的波动。受市场需求变动等多方面因素影响，公司未来主要材料的价格存在一定不确定性，公司因此面临原材料价格波动的风险。

3、研发投入未能有效成果转化的风险

报告期内，公司研发投入分别为 18,888.09 万元、28,741.58 万元、35,429.93 万元和 22,967.91 万元，随着公司围绕主业持续开展研发活动，公司研发人员以及研发项目投入增加，导致研发投入呈持续上升趋势。若研发投入持续增加，但研发投入未能有效实现成果转化，将对公司的经营业绩产生不利影响。

4、车规级 IGBT 模块在新能源汽车领域收入下降的风险

报告期内，公司 IGBT 模块在新能源汽车领域的收入和占比分别为 89.85%、93.57%、87.90%和 75.74%。目前，SiC MOSFET 模块主要应用于新能源汽车的高端车型，但随着 SiC MOSFET 模块成本的不断下降以及新能源汽车装配的电池容量不断上升，越来越多车型的主电机控制器选用 SiC MOSFET 的解决方案。未来，若主流的新能源汽车选用 SiC MOSFET 解决方案，公司车规级 IGBT 模块在新能源汽车领域的收入可能存在下降的情形，会对公司收入结构产生一定的影响。

（三）财务风险

1、经营业绩波动的风险

报告期内，公司的营业收入分别为 270,549.84 万元、366,296.54 万元、339,062.07 万元和 193,561.04 万元，公司归属于母公司所有者的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者计）分别为 76,235.69 万元、88,622.47 万元、48,736.56 万元和 26,106.82 万元。

公司在产品主要应用于新能源汽车、新能源发电、工业控制及电源、白色家电等领域，若上述下游市场出现需求波动或市场竞争加剧导致的产品单价下降等情形，可能使公司经营面临一定的不利影响，从而导致公司未来业绩存在下滑的风险。

2、毛利率变动的风险

报告期内，公司主营业务毛利率分别为 40.34%、37.53%、31.37%和 29.70%。公司主营业务毛利率变动主要受产品销售价格、原材料采购价格、市场竞争程度、技术更新换代等因素的影响。同时，随着公司产品种类增加，不同产品的售价及成本存在一定差异，不同产品销售收入占比的结构性变化也会对公司主营业务毛利率产生较大影响。若未来上述影响因素发生重大不利变化，公司毛利率将会面临下降的风险，从而对公司盈利能力造成不利影响。如果公司毛利率出现大幅下降的情形，公司可能存在本次可转债发行上市当年营业利润比上年下滑超过 50%的风险。

3、存货跌价的风险

报告期各期末，公司存货账面余额分别为 70,447.40 万元、126,340.11 万元、131,528.59 万元和 162,104.66 万元。公司已按照会计政策的要求并结合存货的实际状况计提了存货跌价准备，但仍不能排除市场环境发生变化，或其他难以预计的原因，导致存货无法顺利实现销售，或者存货价格出现大幅下跌的情况，使得公司面临存货跌价风险。

（四）税收优惠政策风险

公司为高新技术企业，报告期内执行 15%的企业所得税税率。另外，公司根据《财政部税务总局国家发展改革委工业和信息化部关于提高集成电路和工业母机企业研发费用加计扣除比例的公告》（财政部税务总局国家发展改革委工业和信息化部公告 2023 年第 44 号）规定：集成电路企业和工业母机企业开展研发活动中实际发生的研发费用，

未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，在 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日期间，再按照实际发生额的 120%在税前扣除；形成无形资产的，在上述期间按照无形资产成本的 220%在税前摊销。

此外，公司根据《财政部税务总局关于集成电路企业增值税加计抵减政策的通知》（财税〔2023〕17 号），自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，按照当期可抵扣进项税额加计 15%抵减应纳增值税税额。

如果相关税收优惠政策取消、优惠力度下降，或者公司不再满足享受前述税收优惠的条件，将对公司的经营业绩产生不利影响。

二、与行业相关的风险

（一）新能源汽车市场波动风险

根据中国汽车工业协会统计，2025 年上半年新能源汽车产销量分别为 696.8 万辆和 693.7 万辆，同比分别增长 41.4%和 40.3%，新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的 44.3%，出口市场表现尤为亮眼，新能源车出口量达 106 万辆，同比激增 75.2%。全球新能源汽车销量达到 946.9 万辆，同比增长 31.8%。新能源汽车继续保持稳定快速的增长势头，目前，新能源汽车占比已经接近 50%，可能存在后续渗透率减慢的风险。虽然公司新能源汽车模块销售数量持续保持高速增长，但未来如果产业政策变化、汽车供应链器件配套、相关设施建设和推广速度以及客户认可度等因素影响，导致新能源汽车市场需求出现较大波动，将会对公司的盈利能力造成不利影响。

（二）市场竞争加剧的风险

随着 IGBT、SiC MOSFET 等功率器件的广泛应用，市场普遍看好产业前景，目前众多国内企业开始介入该领域。虽然本行业的门槛较高，但部分国内竞争对手经过几年的技术积累，亦可能开发出与本公司具有同等竞争力的产品。同时，中国作为全球最重要的功率半导体市场之一，国外大型跨国生产厂商亦持续加大在中国市场的业务拓展。因此，综合国内外市场情况，未来公司可能会面临较为激烈的市场竞争。

三、其他风险

（一）汇率波动的风险

公司在海外的采购与销售业务，通常以欧元、瑞士法郎、美元等外币定价并结算，

外汇市场汇率的波动会影响公司所持货币资金的价值，从而影响公司的资产价值。近年来国家根据国内外经济金融形势和国际收支状况，不断推进人民币汇率形成机制改革，增强了人民币汇率的弹性，但如果未来汇率出现大幅波动或者我国汇率政策发生重大变化，有可能会对公司的经营业绩产生一定的不利影响。

（二）与本次可转债相关的风险

1、本息兑付风险

本次发行可转债的存续期内，公司需按可转债的发行条款就可转债未转股的部分每年偿付利息及到期兑付本金。除此之外，在可转债触发回售条件时，公司还需承兑投资者可能提出的回售要求。受国家政策、法规、行业和市场等多种不可控因素的影响，公司的经营活动如未达到预期的回报，将可能使公司不能从预期的还款来源获得足够的资金，进而影响公司对可转债本息的按时足额兑付，以及对投资者回售要求的承兑能力。

2、可转债到期未转股的风险

本次可转债在转股期限内是否转股取决于转股价格、公司股票价格、投资者偏好及其对公司未来股价预期等因素。若本次可转债未能在转股期限内转股，公司则需对未转股的本次可转债支付利息并兑付本金，从而增加公司的财务费用和资金压力。

3、可转债二级市场价格波动的风险

可转债作为一种具有债券特性且附有股票期权的混合型证券，其二级市场价格受市场利率、票面利率、债券剩余期限、转股价格、转股价格向下修正条款、上市公司股票价格走势、赎回条款、回售条款及投资者心理预期等诸多因素的影响，这需要可转债的投资者具备一定的专业知识。本次发行的可转债在上市交易过程中，市场价格存在波动风险，甚至可能会出现异常波动或与其投资价值背离的现象，从而可能使投资者不能获得预期的投资收益。为此，公司提醒投资者必须充分认识到债券市场和股票市场中可能遇到的风险，以便作出正确的投资决策。

4、可转债转股后摊薄每股收益和净资产收益率的风险

本次发行的可转债募集资金投资项目将在可转债存续期内逐渐产生收益，可转债进入转股期后，如果投资者在转股期内转股过快，将会在一定程度上摊薄公司的每股收益和净资产收益率，因此公司在转股期内可能面临每股收益和净资产收益率被摊薄的风险。

5、信用评级变化的风险

大公国际资信评估有限公司对本次发行的可转债进行了评级,根据大公国际资信评估有限公司出具的《斯达半导体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告(DGZX-R【2025】01362)》,公司主体信用等级为“AA₊”,本次可转债信用等级为“AA₊”,评级展望为稳定。大公国际资信评估有限公司将持续关注公司经营环境的变化、经营或财务状况的重大事项等因素,并出具跟踪评级报告。如果由于公司外部经营环境、自身或评级标准等因素变化,导致本次债券的信用评级级别发生变化,将会增大投资者的风险,对投资人的利益产生一定影响。

6、未提供担保的风险

公司本次发行可转债,按相关规定符合不设担保的条件,因而未提供担保措施。如果可转债存续期间出现对公司经营管理和偿债能力有重大负面影响的事件,可转债可能因未提供担保而增加兑付风险。

第四节 发行人基本情况

一、公司发行前股本总额及前十名股东持股情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司总股本为 239,473,466 股，前十名股东持股情况如下：

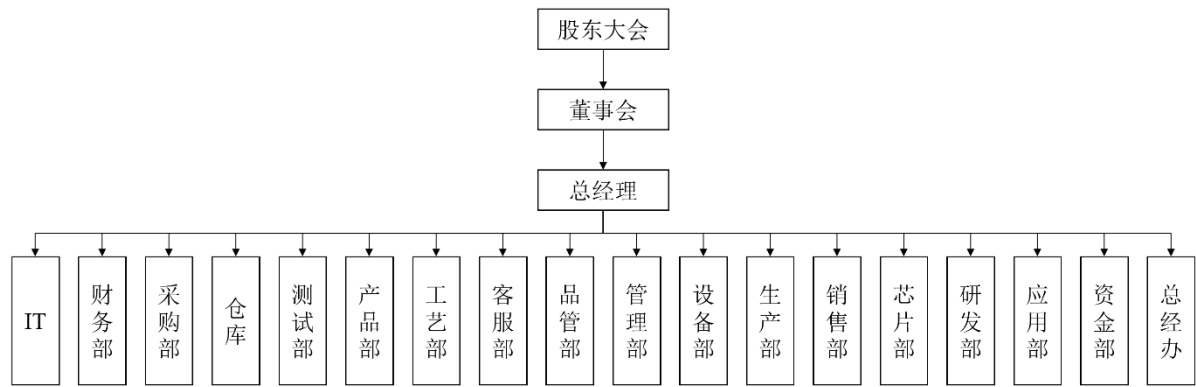
单位：股

序号	股东名称	股东性质	持股数量	占总股本比例 (%)	持有有限售条件的股份数量
1	斯达控股	境外法人	99,773,520	41.66	-
2	浙江兴得利	境内非国有法人	29,493,471	12.32	-
3	富瑞德投资	境内非国有法人	7,481,230	3.12	-
4	香港中央结算有限公司 (陆股通)	境外法人	4,279,448	1.79	-
5	中国农业银行股份有限公司-中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	1,814,940	0.76	-
6	国投招商投资管理有限公司-先进制造产业投资基金二期（有限合伙）	其他	1,272,726	0.53	-
7	国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金	其他	1,271,070	0.53	-
8	李晓春	境内自然人	915,216	0.38	-
9	福建天宝矿业投资集团股份有限公司	境内非国有法人	899,900	0.38	-
10	戴志展	境外自然人	807,986	0.34	-
合计			148,009,507	61.81	-

二、公司组织结构及对外投资情况

（一）公司组织结构图

截至 2025 年 6 月 30 日，发行人的组织结构图如下：



(二) 重要子公司基本情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司有 13 家控股子公司、1 家参股公司，重要子公司的具体情况如下：

1、上海道之

名称	上海道之科技有限公司	
统一社会信用代码	91310114059383050W	
类型	其他有限责任公司	
住所	上海市嘉定区清能路 85 号	
法定代表人	陈幼兴	
注册资本	21,030 万元	
股东构成	斯达半导持股 99.50%，浙江兴得利持股 0.5%	
成立日期	2013 年 1 月 4 日	
营业期限	2013 年 1 月 4 日至 2033 年 1 月 3 日	
主营业务	芯片的研发与销售，新能源汽车 IGBT 模块的生产与销售	
经营范围	从事新能源技术、节能技术、环保技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，IGBT 芯片的设计与 IGBT 模块的生产，半导体芯片、元器件的设计，从事货物进出口及技术进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】	
主要财务数据（万元）	项目	2024 年 12 月 31 日/2024 年度
	总资产	164,715.57
	净资产	137,635.03
	营业收入	206,008.96
	净利润	46,078.48

注：2024 年年度财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计

2、浙江谷蓝

名称	浙江谷蓝电子科技有限公司	
统一社会信用代码	91330481307391982N	
类型	一人有限责任公司	
住所	浙江省海宁市海洲街道文康路 1 号 1-3 幢	
法定代表人	龚央娜	
注册资本	1,250 万元	
股东构成	斯达半导持股 100%	
成立日期	2014 年 6 月 20 日	
营业期限	2014 年 6 月 20 日至 2064 年 6 月 19 日	
主营业务	半导体分立器件的生产和销售	
经营范围	一般项目：半导体分立器件制造；集成电路芯片设计及服务；半导体分立器件销售；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。	
主要财务数据（万元）	项目	2024 年 12 月 31 日/2024 年度
	总资产	6,729.47
	净资产	1,066.26
	营业收入	13,412.64
	净利润	822.29

注：2024 年年度财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计

3、斯达微电子

名称	嘉兴斯达微电子有限公司	
统一社会信用代码	91330402MA2JG80587	
类型	有限责任公司（外商投资企业法人独资）	
住所	浙江省嘉兴市南湖区大桥镇凌公塘路 3339 号（嘉兴科技城）1 号楼 220 室	
法定代表人	陈幼兴	
注册资本	210,933.16 万元	
股东构成	斯达半导持股 100%	
成立日期	2021 年 2 月 26 日	
营业期限	2021 年 2 月 26 日至长期	
主营业务	IGBT 芯片及 SiC 芯片的研发、生产和销售	
经营范围	一般项目：半导体分立器件制造；半导体分立器件销售；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；机械设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准	

	批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。	
主要财务数据（万元）	项目	2024 年 12 月 31 日/2024 年度
	总资产	462,845.57
	净资产	201,069.54
	营业收入	31,151.72
	净利润	-12,953.82

注：2024 年年度财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计

4、斯达欧洲

名称	Starpower Europe AG	
注册资本	60 万瑞士法郎	
股东构成	斯达半导持股 70.00%，Peter Frey 持股 30.00%	
注册地址	Ai Cìòss , 6593 Cadenazzo	
成立日期	2014-5-14	
主营业务	国际业务的拓展和前沿功率半导体芯片及模块的设计和研发	
主要财务数据（万元）	项目	2024 年 12 月 31 日/2024 年度
	总资产	12,501.74
	净资产	3,422.93
	营业收入	23,891.94
	净利润	1,281.71

注：2024 年年度财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计

三、控股股东和实际控制人的基本情况及上市以来的变化情况

（一）控股股东的基本情况

1、控股股东的基本情况

截至 2025 年 6 月 30 日，香港斯达持有斯达半导 41.66%的股权，为公司的控股股东。该公司基本情况如下：

项目	基本情况
企业名称	香港斯达控股有限公司
成立时间	2010 年 11 月 29 日
股份总数	10,000 股（每股面值 1 港元）
股本金总额	10,000 港元
董事	斯达控股、沈华、胡畏

注册地址	香港中环永和街 23-29 号俊和商业中心 13 楼
------	----------------------------

2、控股股东的股权结构

截至 2025 年 6 月 30 日，香港斯达的股权结构如下：

序号	股东名称	股份数	股份比例
1	斯达控股	10,000	100.00%
	合计	10,000	100.00%

斯达控股系 2010 年 11 月 11 日于英属维尔京群岛成立的公司，斯达控股的股份总数为 50,000 股，其中，沈华持有 35,000 股，持股比例为 70%；胡畏持有 15,000 股，持股比例为 30%。

3、控股股东主要财务数据

最近一年，香港斯达的主要财务数据如下：

单位：万港元

项目	2024 年 12 月 31 日
总资产	36,115.82
净资产	31,840.43
项目	2024 年度
营业收入	11,185.83
净利润	10,967.70

注：以上财务数据经林耀海会计师事务所审计。

（二）实际控制人的基本情况

截至 2025 年 6 月 30 日，沈华、胡畏夫妇分别持有斯达控股 70%和 30%的股份，并通过斯达控股间接持有香港斯达 100%的股份，实际支配了香港斯达所持公司 41.66%的股份，为公司实际控制人。公司实际控制人基本情况如下：

沈华先生，董事长、总经理，1995 年获得美国麻省理工学院材料学博士学位，1995 年 7 月至 1999 年 7 月任西门子半导体部门（英飞凌前身，1999 年成为英飞凌公司）高级研发工程师，1999 年 8 月至 2006 年 2 月任 XILINX 公司高级项目经理，公司设立以来一直担任公司董事长和总经理。沈华先生目前兼任香港斯达董事、斯达控股董事、斯达欧洲董事长和重庆安达总经理。

胡畏女士，董事、副总经理，1994 年获美国斯坦福大学工程经济系统硕士学位，

1995 年至 2001 年任美国 Providian Financial 公司市场总监、执行高级副总裁助理、公司战略策划部经理，2005 年回国创办公司，现任公司董事兼副总经理。胡畏女士目前兼任香港斯达董事、斯达控股董事、斯达欧洲董事、港禾逸蓝董事。

（三）发行人上市以来控股股东和实际控制人变动情况

发行人上市以来控股股东和实际控制人未发生过变化。

（四）控股股东和实际控制人的股权质押情况

报告期内，控股股东和实际控制人均不存在股份质押的情况。

（五）控股股东和实际控制人控制的其他企业情况

公司控股股东、实际控制人控制的其他企业请参见本募集说明书“第六节 合规经营与独立性”之“五、关联方和关联交易情况”。

四、承诺事项履行情况

（一）报告期内公司及相关人员作出的重要承诺及履行情况

报告期内，公司及相关人员已作出的重要承诺及其履行情况参见公司于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《斯达半导体股份有限公司 2024 年年度报告》之“第六节 重要事项”之“一、承诺事项履行情况”。

截至本募集说明书签署日，公司、控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员不存在未履行向投资者所做出的公开承诺的情形。

（二）本次发行相关的承诺事项

1、公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺

公司全体董事、高级管理人员就公司本次向不特定对象发行可转换公司债券填补即期回报措施能够得到切实履行等相关事项作出以下承诺：

“1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

2、承诺对本人的职务消费行为进行约束；

3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；

4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

5、承诺如公司未来实施股权激励方案，则未来股权激励方案的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

6、本承诺出具日后至公司本次向不特定对象发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会、上海证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会、上海证券交易所该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会、上海证券交易所的最新规定出具补充承诺；

7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。”

2、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人对公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺

公司控股股东、实际控制人及其一致行动人就公司本次向不特定对象发行可转换公司债券填补即期回报措施能够得到切实履行等相关事项作出如下承诺：

“1、不会越权干预公司的经营管理活动，不会侵占公司利益；

2、自本承诺出具日至公司本次向不特定对象发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会、上海证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会、上海证券交易所该等规定时，本单位/本人承诺届时将按照中国证监会、上海证券交易所的最新规定出具补充承诺；

3、切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。”

五、公司董事、监事、高级管理人员

（一）董事、监事、高级管理人员基本情况

1、董事

公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。现任董事基本情况如下表：

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期
沈华	董事长、总经理	男	61	2023 年 10 月	2026 年 10 月
陈幼兴	副董事长	男	63	2023 年 10 月	2026 年 10 月
胡畏	董事、副总经理	女	61	2023 年 10 月	2026 年 10 月
龚央娜	董事	女	43	2023 年 10 月	2026 年 10 月
沈小军	独立董事	男	43	2023 年 10 月	2026 年 10 月
崔晓钟	独立董事	男	55	2023 年 10 月	2026 年 10 月
吴兰鹰	独立董事	男	69	2023 年 10 月	2026 年 10 月

上述各位董事简历如下：

沈华先生，董事长、总经理，1995 年获得美国麻省理工学院材料学博士学位，1995 年 7 月至 1999 年 7 月任西门子半导体部门（英飞凌前身，1999 年成为英飞凌公司）高级研发工程师，1999 年 8 月至 2006 年 2 月任 XILINX 公司高级项目经理，公司设立以来一直担任公司董事长和总经理。沈华先生目前兼任香港斯达董事、斯达控股董事、斯达欧洲董事长和重庆安达总经理。

陈幼兴先生，副董事长，1995 年至 1997 年任海宁兴业包覆丝厂厂长，1998 年至今一直担任浙江兴得利董事长。陈幼兴先生现任斯达半导副董事长，兼任浙江艾美泰克电子科技有限公司执行董事兼总经理、浙江湾谷纺织有限公司执行董事兼经理、浙江湾河纺织有限公司董事兼经理、上海道之执行董事、重庆安达董事和海宁市斜桥镇商会副会长。

胡畏女士，董事、副总经理，1994 年获美国斯坦福大学工程经济系统硕士学位，1995 年至 2001 年任美国 Providian Financial 公司市场总监、执行高级副总裁助理、公司战略策划部经理，2005 年回国创办公司，现任公司董事兼副总经理。胡畏女士目前兼任香港斯达董事、斯达控股董事、斯达欧洲董事、港禾逸蓝董事。

龚央娜女士，董事，2006 年 11 月加入公司，现任资金部经理。龚央娜女士目前兼任浙江谷蓝执行董事、富瑞德投资执行事务合伙人，兼任浙江谷蓝执行董事、斯达半导体（重庆）有限公司董事、嘉兴斯达电子科技有限公司监事、富瑞德投资执行事务合伙人、港禾逸蓝经理。

沈小军先生，独立董事，博士，嘉兴大学材纺学院教授。2015 年 3 月至 2015 年 6 月在德国凯撒斯劳滕工业大学复合材料研究所访学。2017 年 10 月入选浙江省高等学校

中青年学科带头人。2023 年 10 月任斯达半导独立董事。

崔晓钟先生，独立董事，博士，嘉兴大学商学院会计系主任，嘉兴大学 MPAcc 中心执行主任，嘉兴市审计学会副会长。2023 年 10 月任斯达半导独立董事，兼任印纪娱乐传媒股份有限公司（非上市）独立董事、浙江佑威新材料股份有限公司（非上市）独立董事、浙江亚特电器股份有限公司（非上市）独立董事、浙江亚达绿能科技股份有限公司（非上市）独立董事。

吴兰鹰先生，独立董事，硕士，1970 年至 1983 年在昆明铁路局任职，1986 年至 1987 年在北京交通大学任职，1987 年至 2016 年，历任北京科技大学数理学院讲师、副教授。2023 年 10 月任斯达半导独立董事。

2、监事

公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。现任监事基本情况如下表：

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期
刘志红	监事会主席	男	41	2023 年 10 月	2026 年 10 月
毛国锋	监事	男	52	2023 年 10 月	2026 年 10 月
胡少华	职工代表监事	男	43	2023 年 10 月	2026 年 10 月

上述各位监事简历如下：

刘志红先生，监事，浙江大学电力电子与电力传动专业博士学位。2006 年加入公司，历任公司设计工程师、研发部经理，现任公司研发部总监。

胡少华先生，监事，浙江大学材料科学与工程专业硕士学位。2007 年加入本公司，历任公司工艺工程师，工艺部经理，现任公司工艺部总监。

毛国锋先生，监事，香港大学 SPACE 中国商业学院研究生学历。2003 年 07 月至 2014 年 12 月任深圳市中自网络科技有限公司副总经理，2015 年 1 月至 8 月任深圳市旭日伟业科技有限公司副总裁，2015 年 09 月加入公司，现任公司品牌总监。

3、高级管理人员

公司现任高级管理人员基本情况如下表：

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期
沈华	董事长、总经理	男	61	2023 年 10 月	2026 年 10 月
胡畏	董事、副总经理	女	61	2023 年 10 月	2026 年 10 月

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期
汤艺	副总经理	女	52	2023 年 10 月	2026 年 10 月
李云超	副总经理	男	59	2023 年 10 月	2026 年 10 月
戴志展	副总经理	男	54	2023 年 10 月	2026 年 10 月
张哲	副总经理、董事会秘书、财务总监	男	38	2023 年 10 月	2026 年 10 月

上述各位高级管理人员简历如下：

沈华先生，董事长、总经理，请参阅本节“1、董事”。

胡畏女士，董事、副总经理，请参阅本节“1、董事”。

汤艺女士，副总经理，2003 年博士毕业于美国仁斯利尔理工学院（RPI）电子工程系，2003 年 7 月至 2015 年 3 月在美国国际整流器公司（International Rectifier）工作，历任集成半导体器件高级工程师、主管工程师、高级主管工程师、IGBT 器件设计经理、IGBT 器件设计高级经理。2015 年加入公司，现任公司副总经理，负责 IGBT 芯片技术研发工作。

李云超先生，副总经理，1987 年至 2000 年任中国工商银行嘉兴市分行工会行政干事，2000 年至 2005 年任嘉兴新秀箱包制造有限公司行政主管、总经理助理、分厂厂长，2005 年至 2009 年任嘉兴凯隆塑胶制造有限公司常务副总经理，2009 年 3 月加入公司，任副总经理，同时兼任嘉兴盛隆拉链制造有限公司董事、平湖市兆涌五金塑胶制造有限公司监事、嘉兴市凯隆塑胶制造有限公司监事。

戴志展先生，副总经理，中国台湾省国立清华大学电机工程研究所硕士。1999 年 9 月至 2002 年 11 月在昀瑞公司工作，历任研发课课长、研发部经理；2002 年 11 月至 2009 年 2 月在乾坤科技股份有限公司工作，历任研发处经理、电源应用部资深经理。2009 年 2 月加入公司，现任公司副总经理。

张哲先生，董事会秘书、财务总监、副总经理，南开大学工商管理硕士。2008 年 5 月份加入公司，2010 年至 2016 年任客服部经理，2016 年 6 月至今任公司财务总监，2017 年 10 月至今担任公司董事会秘书、副总经理。张哲先生目前兼任上海道之监事、重庆安达监事。

（二）董事、监事、高级管理人员对外兼职情况

截至本募集说明书签署日，公司现任董事、监事和高级管理人员的主要对外兼职情

况如下：

姓名	在公司职务	兼职单位	兼职职务	兼职单位与公司关系
沈华	董事长、总经理	香港斯达	董事	公司控股股东
		斯达控股	董事	公司间接控股股东
胡畏	董事、副总经理	香港斯达	董事	公司控股股东
		斯达控股	董事	公司间接控股股东
		港禾逸蓝	董事	公司关联方
陈幼兴	副董事长	浙江兴得利	执行董事、总经理	公司股东
		浙江艾美泰克电子科技有限公司	执行董事、总经理	公司关联方
		浙江湾谷纺织有限公司	执行董事、总经理	公司关联方
		福州兴得利投资有限公司	执行董事、经理	公司关联方
		浙江湾河纺织有限公司	董事、经理	公司关联方
龚央娜	董事	富瑞德投资	执行事务合伙人	公司股东
		港禾逸蓝	经理	公司关联方
李云超	副总经理	嘉兴盛隆拉链制造有限公司	董事	公司关联方
崔晓钟	独立董事	印纪娱乐传媒股份有限公司	独立董事	无
		浙江佑威新材料股份有限公司	独立董事	无
		浙江亚特电器股份有限公司	独立董事	无
		浙江亚达绿能科技股份有限公司	独立董事	无
		嘉兴大学	教师、MPAcc 中心 执行主任	无
沈小军	独立董事	嘉兴大学	教授、科技处 副处长	无

（三）董事、监事、高级管理人员薪酬情况

2024 年度，公司董事、监事、高级管理人员在公司领取薪酬情况如下：

单位：万元

姓名	所任职务	任职状态	2024 年薪酬总额
沈华	董事长、总经理	现任	132.48
陈幼兴	副董事长	现任	-
胡畏	董事、副总经理	现任	105.69
龚央娜	董事	现任	27.96
沈小军	独立董事	现任	9.00
崔晓钟	独立董事	现任	9.00
吴兰鹰	独立董事	现任	9.00

姓名	所任职务	任职状态	2024 年薪酬总额
刘志红	监事会主席	现任	53.19
胡少华	职工代表监事	现任	50.89
汤艺	副总经理	现任	117.17
李云超	副总经理	现任	40.51
戴志展	副总经理	现任	70.70
张哲	副总经理、董事会秘书、财务总监	现任	46.48
毛国锋	监事	现任	34.26
合计			706.31

（四）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员持股情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司现任董事、监事、高级管理人员直接及间接持有公司股份情况如下：

姓名	职务	持股数量（股）	持股比例	持股方式
沈华	董事长、总经理	69,841,464	29.16%	间接
胡畏	董事、副总经理	29,932,056	12.50%	间接
陈幼兴	副董事长	22,415,038	9.36%	间接
龚央娜	董事	1,736,759	0.73%	间接
刘志红	监事会主席	271,127	0.11%	间接
胡少华	职工代表监事	271,127	0.11%	间接
毛国锋	监事	168,328	0.07%	间接
汤艺	副总经理	496,500	0.21%	直接
李云超	副总经理	682,745	0.29%	间接
戴志展	副总经理	807,986	0.34%	直接
张哲	副总经理、董事会秘书、财务总监	1,052,715	0.44%	间接
合计		127,675,845	53.32%	-

（五）报告期内，董事、监事、高级管理人员变动情况

报告期内，公司选举、更换董事、监事及聘任高级管理人员的情况主要内容如下：

变动日期	姓名	变动前职务	变动后职务	变动原因
2023 年 10 月	沈小军	-	独立董事	董事会换届选举
2023 年 10 月	崔晓钟	-	独立董事	董事会换届选举
2023 年 10 月	吴兰鹰	-	独立董事	董事会换届选举
2023 年 10 月	徐攀	独立董事	-	届满离任

变动日期	姓名	变动前职务	变动后职务	变动原因
2023 年 10 月	黄苏融	独立董事	-	届满离任
2023 年 10 月	郭清	独立董事	-	届满离任
2023 年 10 月	许浩平	副总经理	-	届满离任
2022 年 4 月	李君月	监事	-	因个人原因离任
2022 年 4 月	毛国峰	-	监事	监事会补选

报告期内，公司的董事、监事、高级管理人员未发生重大变化。上述人员的变动是基于公司的规范运作及公司生产经营的需要而作出的调整，已履行了必要的法律程序。

（六）公司对董事、高级管理人员及其他员工的激励情况

1、员工持股平台

截至 2025 年 6 月末，富瑞德投资直接持有公司 7,481,230 股股份，占公司总股本的比例为 3.12%，系公司员工持股平台。其基本情况如下：

企业名称	嘉兴富瑞德投资合伙企业（有限合伙）
住所	浙江省嘉兴市南湖区东栅街道南江路 1856 号基金小镇 1 号楼 205 室-52
企业类型	有限合伙企业
认缴出资额	1,263.50 万元
实缴出资额	1,263.50 万元
统一社会信用代码	913304025793156096
执行事务合伙人	龚央娜
成立日期	2011 年 6 月 30 日
合伙期限	2011 年 6 月 30 日至 2031 年 6 月 29 日
经营范围	实业投资、投资咨询服务。
登记状态	存续（在营、开业、在册）

截至 2025 年 6 月末，富瑞德投资合伙人共计 49 名，具体情况如下：

单位：万元

序号	合伙人名称	财产份额	出资比例	合伙人类别
一、现任及报告期内曾经的董事、监事及高级管理人员		735.62	58.22%	
1	龚央娜	293.32	23.21%	普通合伙人
2	张哲	177.79	14.07%	有限合伙人
3	李云超	115.31	9.13%	有限合伙人
4	胡少华	45.79	3.62%	有限合伙人

序号	合伙人名称	财产份额	出资比例	合伙人类别
5	刘志红	45.79	3.62%	有限合伙人
6	许浩平	29.19	2.31%	有限合伙人
7	毛国锋	28.43	2.25%	有限合伙人
二、公司其他员工（42 人）		527.88	41.78%	均为有限合伙人
合计		1,263.50	100.00%	-

六、发行人特别表决权股份或类似安排

截至本募集说明书签署日，公司不存在特别表决权股份或类似安排情形。

七、公司所处行业的基本情况

（一）公司所处行业的分类

公司的主营业务是以 IGBT 和 SiC 为主的功率半导体芯片和模块的设计研发、生产及销售。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业，行业代码为“C39”；根据国家统计局发布的《国民经济行业分类（2017 年修订）》（GB/T4754-2017），公司所属行业为半导体分立器件制造，行业代码为“C3972”。

（二）行业监管体制及最近三年监管政策的变化

1、行业主管部门及监管体制

本行业宏观管理部门为国家发改委，主要负责产业政策的制定，推进可持续发展战略，组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用等。

工业和信息化部是半导体分立器件制造行业的主管部门，其主要职责包括：提出新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施工业、通信业、信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级；制定并组织实施工业、通信业的行业规划、计划和产业政策；监测分析工业、通信业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导；指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业等。

协调指导本行业发展的行业协会主要有中国电器工业协会电力电子分会及中国半

导体行业协会分立器件分会。行业协会履行行业管理职责，贯彻落实政府有关的政策、法规，协助政府开展行业统计、标准化、科技成果奖的评比、反倾销反补贴和保障措施等工作。

2、最近三年监管政策变化

目前，我国已针对集成电路产业及 IGBT 行业推出一系列法律及法规。同时，由于 IGBT 具有巨大的国内和国际市场，且在产业结构升级、节能减排、新能源等领域发挥着不可替代的重要作用，为了鼓励国内 IGBT 产业的发展，打破国外企业在此领域的垄断，增强科技创新能力，推进节能降耗，建设资源节约型和环境友好型社会，近年来，政府部门制订了一系列政策鼓励、促进国内 IGBT 行业的发展。

序号	时间	发布机构	政策名称	内容概要
1	2020 年 8 月	国务院	新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策	在先进存储、先进计算、先进制造、高端封装测试、关键装备材料、新一代半导体技术等领域，结合行业特点推动各类创新平台建设。科技部、国家发展改革委、工业和信息化部等部门优先支持相关创新平台实施研发项目
2	2021 年 3 月	全国人大	中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要	将第三代半导体纳入战略性新兴产业重点发展方向，支持宽禁带半导体材料的研发与产业化，推动其在 5G 通信、新能源汽车、光伏等领域的应用
3	2021 年 12 月	中央网络安全和信息化委员会	“十四五”国家信息化规划	加快集成电路关键技术攻关。推动计算芯片、存储芯片等创新，加快集成电路设计工具、重点装备和高纯靶材等关键材料研发，推动绝缘栅双极型晶体管（IGBT）、微机电系统（MEMS）等特色工艺突破。
4	2023 年 1 月	工信部等六部联合发表	关于推动能源电子产业发展的指导意见	加快功率半导体器件等面向光伏发电、风力发电、电力传输、新能源汽车、轨道交通推广。提高长寿命、高效率的 LED 技术水平，推动新型半导体照明产品在智慧城市、智能家居等领域应用，发展绿色照明、健康照明
5	2024 年 3 月	国务院	政府工作报告	大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力。充分发挥创新主导作用，以科技创新推动产业创新，加快推进新型工业化，提高全要素生产率，不断塑造发展新动能新优势，促进社会生产力实现新的跃升”；“深入实施科教兴国战略，强化高质量发展的基础支撑。瞄准国家重大战略需求和产业发展需要，部署实施一批重大科技项目”

序号	时间	发布机构	政策名称	内容概要
6	2024 年 7 月	中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议	中共中央关于进一步全面深化改革推进中国式现代化的决定	加强关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术创新，加强新领域新赛道制度供给，建立未来产业投入增长机制，完善推动新一代信息技术、人工智能、航空航天、新能源、新材料、高端装备、生物医药、量子科技等战略性新兴产业发展政策和治理体系，引导新兴产业健康有序发展；健全提升产业链供应链韧性和安全水平制度。抓紧打造自主可控的产业链供应链，健全强化集成电路、工业母机、医疗装备、仪器仪表、基础软件、工业软件、先进材料等重点产业链发展体制机制，全链条推进技术攻关、成果应用
7	2025 年 7 月	国家发展改革委办公厅、国家能源局综合司、工业和信息化部办公厅、交通运输部办公厅	关于促进大功率充电设施科学规划建设的通知	推动大功率充电技术创新应用。充电运营企业要加强充电装备技术升级，提高大功率充电设施的运行效率和使用寿命。鼓励对分体式设备采用大功率充电优先的功率分配策略。加快高压碳化硅模块、主控芯片等核心器件国产化替代，推动涵盖零部件、系统集成、运营服务的充电产业链整体升级

（三）行业概况及市场发展情况

1、国内外功率半导体市场规模持续上升

功率半导体主要用于电力设备的电能变换和电路控制，是进行电能处理的核心器件，弱电控制与强电运行间的桥梁，细分产品主要有 MOSFET、IGBT、BJT 等。随着世界各国对节能减排的需求越来越迫切，功率半导体器件已从传统的工业控制和 4C（通信、计算机、消费电子、汽车）领域迈向新能源、新能源汽车、轨道交通、智能电网、变频家电等诸多产业。功率半导体的发展使得变频设备广泛的应用于日常的消费，促进了清洁能源、电力终端消费、以及终端消费电子的产品发展。根据 Omida 的数据及预测，2023 年全球功率半导体市场规模达到 503 亿美元，预计 2027 年市场规模将达到 596 亿美元。中国是最大的功率半导体市场之一，根据中研普华产业研究院《2025-2030 年中国功率半导体器件行业发展潜力建议及深度调查预测报告》数据显示，2024 年中国功率半导体市场规模达 1,752.55 亿元，同比增长 15.3%，近五年复合增长率（CAGR）达 12%，显著高于全球 6.9% 的平均水平。

2、IGBT 是目前发展最快的功率半导体器件之一

IGBT 模块是变频器、工业电源、伺服器等工业控制及电源行业的核心元器件，广

泛应用于新能源、新能源汽车、工业控制与电源、白色家电、AI 服务器电源、数据中心、机器人及低空/高空飞行器等领域。根据 WSTS 数据显示，2023 年全球 IGBT 市场规模达到 90 亿美元，预计 2026 年将达到 121 亿美元；中国是全球 IGBT 最大的消费市场，2023 年中国 IGBT 市场规模达 32 亿美元，预计到 2026 年中国 IGBT 市场规模将达到 42 亿美元。

3、以碳化硅（SiC）、氮化镓（GaN）为代表的第三代半导体市场规模迅速增长

近年来，以碳化硅（SiC）、氮化镓（GaN）等材料为代表的化合物半导体因其宽禁带、高饱和漂移速度、高临界击穿电场等优异的性能而饱受关注。其中碳化硅功率器件受下游新能源汽车等行业需求拉动，市场规模增长快速。根据 IHS 数据，受新能源汽车行业庞大的需求驱动，以及光伏风电和充电桩等领域对于效率和功耗要求提升的影响，预计到 2027 年碳化硅功率器件的市场规模将超过 100 亿美元，2018-2027 年的复合增速接近 40%。

（四）行业的竞争格局与主要竞争对手

全球范围内，目前功率半导体市场主要由欧洲、日本及美国企业占领，国内企业通过多年的技术积累和发展，逐步拓展在全球市场中的市场份额。除公司外，目前功率半导体国内外主要参与者如下：

（1）英飞凌科技公司（Infineon Technologies）

英飞凌科技公司是德国半导体制造商，成立于 1999 年，专注于汽车电子、工业电子、功率半导体和安全芯片。其前身是西门子的半导体部门，在功率器件（如 IGBT）、汽车微控制器、安全解决方案等领域处于全球领先地位。

（2）三菱电机株式会社（Mitsubishi Electric Corporation）

三菱电机株式会社是三菱集团的核心企业之一，成立于 1921 年。三菱电机在全球的电力设备、通信设备、工业自动化、电子元器件、家电等市场占据着重要的地位。三菱电机半导体产品包括功率模块（IGBT、IPM、MOSFET 等）、微波/射频和高频光器件、光模块和标准工业用的 TFTLCD 等。

（3）富士电机株式会社（Fuji Electric）

富士电机株式会社成立于 1923 年，在全球生产和销售 IGBT、MOSFET 等功率半

导体。富士电机 IGBT 芯片的设计和生产主要集中在本国进行，在英国、日本和菲律宾都设有功率器件生产工厂。作为业内领先的 IGBT 企业，富士电机主要生产 IGBT 模块和 IPM 模块，产品在工业控制和变频家电中广泛使用。

（4）赛米控（SEMİKRON）

赛米控成立于 1951 年，总部位于德国纽伦堡，是全球领先的电力电子制造商，发明了全球第一款带绝缘设计的功率模块，主要生产中等功率输出范围（约 2KW 至 10MW）中广泛应用的电力电子组件和系统。生产产品包括芯片、分立器件、二极管、晶闸管、IGBT 功率模块和系统功率组件。

（5）中车时代

中车时代成立于 2005 年，总部位于湖南省株洲市。根据中车时代官网介绍，中车时代立足于交通和能源两大赛道，以创一流和高质量发展为目标，始终坚持创新驱动和同心多元化发展，致力于为社会提供安全、智能、绿色、舒适的高端装备，立志成为交通与能源领域电气系统全面解决方案全球首选供应商和世界一流专业领军示范企业。

（6）士兰微

士兰微坐落于杭州高新技术产业开发区，是专业从事集成电路芯片设计以及半导体微电子相关产品生产的高新技术企业，于 2003 年 3 月在上海证券交易所上市，产品覆盖功率半导体和半导体化合物器件、功率驱动与控制系统、MEMS 传感器、ASIC 产品、光电产品等多个领域。

（五）公司的竞争优势及市场地位

1、公司的竞争优势

（1）技术优势

公司自成立以来一直以技术发展和产品质量为公司之根本，并以开发新产品、新技术为公司的主要工作，持续大幅度地增加研发投入，培养、组建了一支高素质的国际型研发队伍，涵盖了 IGBT 芯片、快恢复二极管芯片、SiC MOSFET 芯片和 IGBT 和 SiC MOSFET 模块的设计、工艺开发、产品测试、产品应用等，在半导体技术、电力电子、控制、材料、力学、热学、结构等多学科具备了深厚的技术积累。目前，公司已经实现自主 IGBT 芯片、快恢复二极管芯片、SiC MOSFET 芯片的量产，以及 IGBT 和 SiC

MOSFET 模块的大规模生产和销售。

(2) 快速满足客户个性化需求的优势

客户的个性化需求主要是对芯片特性及模块的电路结构、拓扑结构、外形和接口控制的个性化要求等。

公司拥有 IGBT、SiC MOSFET 等芯片及模块的设计和应用专家，并成立了专门的应用部，能够快速、准确地理解客户的个性化需求，并将这种需求转化成产品要求；同时，公司建立了将客户需求快速有效地转化成产品的新产品开发机制，目前公司已形成上百种个性化产品，这些个性化产品成为公司保持与现有客户长期稳定合作的重要基础；另外，与国际品牌厂商相比，公司采用了直销模式，直接与客户对接，从而进一步提升了服务客户的效率。

因此，与国外竞争对手相比，公司与下游客户的沟通更加便捷和顺畅，在对响应客户需求的速度、供货速度、产品适应性及持续服务能力等各方面都表现出优势。

(3) 细分行业的领先优势

公司自成立以来一直专注于以 IGBT 和 SiC 为主的功率芯片和模块的设计研发、生产和销售，针对细分行业客户对产品性能、拓扑结构等的不同要求，公司开发了不同系列的 IGBT/SiC 产品，在新能源汽车、新能源发电、工业控制等细分市场领域形成了较大的竞争优势。

在新能源汽车领域，公司是国内车规级 IGBT/SiC 模块的主要供应商，公司积极开拓海外市场并获得了多家国外头部 Tier1 的项目定点；在新能源发电领域，公司已是国内多家主流光伏逆变器客户、风电逆变器客户的主要供应商，并且与头部企业建立了深入的战略合作关系，公司根据客户需求不断推出符合市场需求的具有市场竞争力的产品；在工业控制领域，公司目前已经成为国内多家头部变频器企业 IGBT 模块的主要供应商，同时公司已经是工控行业多家国际头部企业的正式供应商。

(4) 先发优势

IGBT/SiC 模块不仅应用广泛，且是下游产品中的核心器件，一旦出现问题会导致产品无法使用，给下游企业带来较大损失，替代成本较高，因此一般下游企业都会经过较长的认证期后才会大批量采购，新的品牌进入市场需要面临长期较大的资金投入和

场开发的困难，公司的先发优势明显。随着公司生产规模的扩大，自主芯片的批量导入和迭代，在供货稳定性及产品先进性上的优势会进一步巩固，从而提高潜在竞争对手进入本行业的壁垒。

（5）人才优势

人才是半导体行业的重要因素，是功率半导体企业求生存、谋发展的先决条件。公司创始人为半导体行业技术专家，具备丰富的知识、技术储备及行业经验；公司拥有多名具有国内外一流研发水平的技术人员，多人具备在国际著名功率半导体公司承担研发工作的经历；公司的核心技术团队稳定，大多数人在本公司拥有十年以上的工作经验。2023 年，公司在瑞士苏黎世成立新的研发中心，苏黎世研发中心是公司 2014 年成立德国纽伦堡研发中心后在欧洲设立的第二个海外研发中心，公司将不断补充高素质的专业技术团队，进一步加大对下一代 IGBT、SiC、MCU、GaN 以及先进封装技术的研发力度。专业的人才团队为公司的持续稳定发展奠定了良好基础，公司人才方面的优势为公司的持续发展提供了动力。

（6）合理的业务模式优势

公司选择了以直销为主、经销为辅的销售模式，可迅速了解客户需求，同时通过经销迅速拓展市场份额，提高市场声誉。此外，公司可以根据客户性质，灵活的选择直销和经销的维护方式，更好地服务客户。

公司芯片生产采取“Fabless+IDM 双轮驱动”的混合业务模式，通过与华虹半导体等全球头部代工厂深度合作，聚焦芯片设计能力与客户需求匹配效率，快速满足客户需求同时减小了投资风险，避免了 IDM 公司资产过重的特点。同时，通过自建 6 英寸 SiC MOSFET 芯片和 3300V 以上高压 IGBT 芯片生产线，掌握关键工艺节点自主权，缩短产品开发周期，为新能源汽车、智能电网等场景提供定制化解决方案。

（7）较强的市场开拓能力

公司坚定以“研发推动市场，市场反馈研发”的发展思路，形成研发与销售之间的闭环。该种良性循环使公司实现了一定技术积累的同时，具备了较强的市场开拓能力，实现了销售的快速增长。

2、公司的行业地位

据 Omdia 2023 年发布的全球功率半导体市场报告，在 2022 年度 IGBT 模块供应商全球市场份额排名中，斯达半导排名第 5 位，在中国企业中排名第 1 位，全球份额约为 4.3%。公司目前相比排名第一的英飞凌 31.70% 的市场份额仍有较大的差距。市场排名前十中的企业，除了公司和中车时代（两者合计份额约为 8.4%），其他均为外国企业，该行业仍处于外国企业垄断的局势之中。

在 SiC 领域，公司自 2020 年起陆续获得了国内外多个 SiC MOSFET 主电机控制器项目定点，并于 2022 年实现国内首个 800V 高压 SiC 主电机控制器平台批量装车。目前，公司车规级 SiC MOSFET 芯片和模块已经在国内外主流整车厂多车型大批量装车，产品销量持续快速增长。

3、行业壁垒

（1）技术壁垒

1）芯片设计

IGBT 芯片、SiC MOSFET 芯片是 IGBT 模块、SiC MOSFET 模块的核心，其设计工艺极为复杂，不仅要保持模块在大电流、高电压、高频率的环境下稳定工作，还需保持开闭和损耗、抗短路能力和导通压降维持平衡。快恢复二极管芯片在 IGBT 模块中与 IGBT 芯片配合使用，需要承受高电压、大电流的同时，要求具有极短的反向恢复时间和反向恢复损耗。企业只有具备深厚的技术底蕴和强大的创新能力，积累丰富的经验和知识储备，才能在行业中立足。因此，行业内的后来者往往需要经历一段较长的技术摸索和积累，才能和业内已经占据技术优势的企业相抗衡。

2）模块设计及制造工艺

IGBT、SiC MOSFET 等模块对产品的可靠性和质量稳定性要求较高，生产工艺复杂，包括：①模块的结构-热-电路设计技术、模块的电磁场、温度场及应力场仿真优化技术；②模块的焊接、烧结、键合及注塑等核心工艺技术；③模块的静态、动态电参数及热参数测试技术；④模块的可靠性试验及寿命评估技术等。目前国内具有相关实践、经验丰富的研发技术人才仍然比较缺乏，新进入的企业要想熟练掌握芯片和模块的设计、制造工艺，实现大规模生产，需要花费较长的时间培养人才、学习探索及技术积累。

（2）品牌和市场壁垒

公司产品是下游行业的关键零部件，其性能表现、稳定性和可靠性对下游客户来说至关重要，因此认证周期较长，替换成本高。对于新增供应商，客户往往会保持谨慎态度，不仅会综合评定供应商的实力，而且通常要经过产品单体测试、整机测试、多次小批量试用等多个环节之后，才会做出大批量采购决策，采购决策周期较长。因此，新进入本行业者即使生产出产品，也需要耗费较长时间才能赢得客户的认可。

（3）资金壁垒

公司所属行业属于资本密集型行业，产业链涵盖芯片设计、芯片制造、模块制造及测试等环节，其生产、测试设备基本需要进口，设备成本较高，同时产品的研发和市场开拓都需要较长时间，客户往往要经过较长时间试用才会认可新的品牌，此外，本行业对流动资金需求量也较大，新进入者在前期往往面临投入大、产出少的情况，需要较强的资金实力作后盾，才能持续进行产品的研发、生产和销售。

（六）公司所在行业与上下游行业之间的关联性

公司的上游企业主要为晶圆制造外协加工商以及 DBC、散热基板等原材料供应商。公司与上游供应商均建立了稳定的合作关系，能够满足公司经营需要。

本行业下游客户分布广泛，包括新能源、新能源汽车、工业控制与电源、白色家电、AI 服务器电源、数据中心、机器人及低空/高空飞行器等众多领域，IGBT、SiC MOSFET、GaN 等功率半导体模块是上述行业的核心零部件。随着上述领域的快速发展，下游客户对公司产品的需求量迅速增加。

综上所述，从产业链整体来看，公司所处行业的上游供应相对充足，在下游客户的技术路线实现和迭代发展中起到至关重要的作用，在上下游产业链中具有重要地位。

八、公司主营业务具体情况

（一）公司主营业务、主营产品或服务

1、公司主营业务

公司主营业务是以 IGBT、SiC 为主的功率半导体芯片和模块的设计研发、生产及销售。公司总部位于浙江嘉兴，在上海、浙江、重庆和欧洲均设有子公司，并在国内和欧洲均设有研发中心。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），

公司所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业，行业代码为“C39”；根据国家统计局发布的《国民经济行业分类（2017年修订）》（GB/T4754-2017），公司所属行业为半导体分立器件制造，行业代码为“C3972”。

2、公司的主要产品

公司长期致力于为高能效、绿色化和智能化应用提供全面的半导体及系统解决方案，产品组合覆盖 IGBT、SiC MOSFET、GaN HEMT、快恢复二极管等功率半导体器件以及汽车级与工业级 MCU、栅极驱动 IC 芯片等，广泛应用于新能源、新能源汽车、工业控制与电源、白色家电、AI 服务器电源、数据中心、机器人及低空/高空飞行器等领域。

作为电力电子第三次革命的核心代表，IGBT、SiC 和 GaN 等功率半导体器件被誉为工业控制与自动化领域的“心脏”，承担对电压、电流、频率、相位等关键参数的高效调控。2024 年，公司正式成立 MCU 事业部，专注于高端工规与车规级主控 MCU 的研发。MCU 作为电子设备的“大脑”，负责信号处理、逻辑判断与系统控制，实现对功率半导体等执行单元的精准调度。而栅极驱动 IC 则扮演“神经枢纽”的关键角色，负责将 MCU 发出的控制信号进行放大与调理，以高效、可靠地驱动 IGBT、SiC、GaN 等功率器件，确保“大脑”指令的准确执行与系统的快速响应。

MCU、功率半导体与栅极驱动 IC 三者的协同，构建起智能化系统中至关重要的“脑-心-神经”协同架构。这一完整产品链弥补了当前国内产业链的关键短板，进一步增强了公司为客户提供系统级解决方案的能力，有助于为下游行业提供更高性能、更优成本、更快响应的一体化解决方案，尤其在新能源、新能源汽车、机器人、低空/高空经济、AI 服务器电源、数据中心等高速增长领域，形成显著的技术协同与竞争优势，为公司持续引领行业创新注入新动能。

（二）公司的业务模式

1、采购模式

公司的原材料主要包括 SiC MOSFET 芯片、IGBT 芯片、快恢复二极管芯片、GaN 芯片等功率半导体芯片以及 DBC、散热基板和其他材料。其中 IGBT 芯片和快恢复二极管芯片的采购主要通过自主研发设计并外协生产加工，部分通过自主生产线进行生产或向国内外厂商采购；SiC MOSFET 芯片主要通过自主生产或向国内外厂商采购两种方式；GaN 芯片、DBC、散热基板等原材料向国内外厂商采购。

为了确保产品质量，公司具有严格的供应商导入流程，新的供应商导入均需经过公司采购、技术和品质部门人员的共同审核。此外，公司对各种原材料均制订了具体的检验标准，原材料投入使用前需先经过检验。

2、生产模式

公司产品生产环节主要分为芯片和模块设计、芯片制造、模块生产三个阶段。

阶段一：芯片和模块设计。公司产品设计包含 IGBT、快恢复二极管、SiC MOSFET 等芯片的设计功率模块的设计。本阶段公司根据客户对芯片关键参数的需求，设计出符合客户性能要求的芯片；根据客户对电路拓扑及模块结构的要求，结合功率模块的电性能以及可靠性标准，设计出满足各行业性能要求的功率模块。

阶段二：芯片制造。公司芯片制造采取“Fabless+IDM 双轮驱动”的混合业务模式，通过与华虹半导体等全球头部代工厂深度合作，聚焦芯片设计能力与客户需求匹配效率，快速满足客户需求同时减小了投资风险，避免了 IDM 公司资产过重的特点。同时，通过自建 6 英寸 SiC MOSFET 芯片和 3,300V 以上高压 IGBT 芯片生产线，掌握关键工艺节点自主权，缩短产品开发周期，为新能源汽车、智能电网等场景提供定制化解决方案。

阶段三：模块生产。模块生产是应用模块原理，将单个或多个如 IGBT 芯片、快恢复二极管、SiC MOSFET、GaN HEMT 等功率芯片用先进的封装技术封装在一个绝缘外壳内的过程。由于模块外形尺寸和安装尺寸的标准化及芯片间的连接已在模块内部完成，因此和同容量的器件相比，具有体积小、重量轻、结构紧凑、可靠性高、外接线简单、互换性好等优点。本阶段公司根据不同产品需要通过芯片贴片、回流焊接、铝线键合、测试等生产环节，最终生产出符合公司标准的功率模块。公司主要产品 IGBT 模块集成度高，内部拓扑结构复杂，又需要在高电压、大电流、高温、高湿等恶劣环境中运行，对公司设计能力和生产工艺控制水平要求高。

3、营销模式

目前公司主要采取直销的方式进行销售，公司直销的主要业务流程为：客户开发——产品测试——小批量试用——大批量稳定销售。公司根据下游客户的分布情况，除嘉兴总部外在全国建立了多个销售联络处，并于瑞士设立了控股子公司斯达欧洲，负责国际市场业务开拓。同时公司亦参加相关行业的展会及相关行业组织的各种会议、活动等，以提高产品知名度，加强和客户的沟通，促进市场开发和产品销售。

因为海外市场地域分布较广，且海外代理商及客户相对成熟，因此，公司从 2014 年开始针对部分海外市场通过经销商销售给终端客户。经销模式主要通过经销商对外销售，公司根据经销商的订单发货给经销商，最后由其发货给终端客户。公司选择经销商时主要考评经销商的销售网络以及技术人员能力（主要协助完成客户支持及后期维护）。

报告期内，公司主营业务收入中直销和经销的金额及比例情况如下表所示：

单位：万元

项目	2025 年 1-6 月		2024 年度		2023 年度		2022 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
直销	163,058.95	84.29%	291,527.80	86.22%	307,247.21	84.44%	223,086.89	83.18%
经销	30,380.80	15.71%	46,602.25	13.78%	56,596.27	15.56%	45,123.51	16.82%
合计	193,439.75	100.00%	338,130.05	100.00%	363,843.49	100.00%	268,210.40	100.00%

4、研发模式

公司采用自主研发模式，在国内设有三个研发中心，2014 年和 2023 年分别在德国纽伦堡、瑞士苏黎世设有两个海外研发中心，负责前沿芯片设计、工艺以及模块封装技术的开发。公司坚定以“研发推动市场，市场反馈研发”的发展思路，形成研发与销售之间的闭环。

公司拥有多名具有国内外一流研发水平的技术人员，多人具备在国际著名功率半导体公司承担研发工作的经历，并培养了一批具备超过十五年工作经验的研发骨干。公司将不断补充高素质的专业技术团队，进一步加大对 IGBT、SiC、MCU、GaN 芯片以及先进的模块封装技术研发力度。

（三）生产、销售情况和主要客户

1、产能、产量及销售情况

报告期内，公司 IGBT 模块产能、产量、销量情况如下：

单位：万只

产品名称	时间	产能	产量	产能利用率	销量	产销率
IGBT 模块	2025 年 1-6 月	812	778	95.81%	745	95.76%
	2024 年	1,576	1,425	90.42%	1,415	99.30%
	2023 年	1,519	1,373	90.39%	1,274	92.79%
	2022 年	1,020	920	90.20%	980	106.52%

2、主要客户情况

报告期内，公司向前五名客户的销售情况如下：

单位：万元

2025 年 1-6 月				
序号	客户名称	主要销售内容	销售额	占营业收入的比例
1	第一名	IGBT 模块	21,696.67	11.21%
2	第二名	IGBT 模块	14,297.07	7.39%
3	第三名	SiC MOSFET 模块	13,170.99	6.80%
4	第四名	SiC MOSFET 模块、IGBT 模块	8,887.69	4.59%
5	第五名	IGBT 模块	8,557.82	4.42%
合计			66,610.24	34.41%
2024 年度				
序号	客户名称	主要销售内容	销售额	占营业收入的比例
1	第一名	IGBT 模块	39,203.93	11.56%
2	第二名	IGBT 模块	23,219.28	6.85%
3	第三名	IGBT 模块	18,881.54	5.57%
4	第四名	IGBT 模块	17,582.28	5.19%
5	第五名	IGBT 模块	14,596.58	4.30%
合计			113,483.61	33.47%
2023 年度				
序号	客户名称	主要销售内容	销售额	占营业收入的比例
1	第一名	IGBT 模块	42,066.31	11.48%
2	第二名	IGBT 模块	36,981.78	10.10%
3	第三名	IGBT 模块	20,527.79	5.60%
4	第四名	IGBT 模块	17,484.29	4.77%
5	第五名	IGBT 模块	15,731.75	4.29%
合计			132,791.92	36.25%
2022 年度				
序号	客户名称	主要销售内容	销售额	占营业收入的比例
1	第一名	IGBT 模块	34,181.84	12.63%
2	第二名	IGBT 模块	23,933.71	8.85%
3	第三名	IGBT 模块	21,736.87	8.03%

4	第四名	IGBT 模块	17,890.67	6.61%
5	第五名	IGBT 模块	17,545.91	6.49%
合计			115,289.00	42.61%

注：受同一实际控制人控制的客户已合并计算

报告期内，公司前五名客户销售收入占营业收入的比例分别为 42.61%、36.25%、33.47%和 34.41%。报告期内公司前五名客户销售收入占比较高主要是由于公司下游行业客户集中度较高。报告期内，公司不存在向单个客户销售占比超过 30%情形。

公司董事、监事、高级管理人员，主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东与前五名客户之间不存在关联关系。

（四）采购情况和主要供应商

公司的原材料主要包括 SiC MOSFET 芯片、IGBT 芯片、快恢复二极管芯片、GaN 芯片等功率半导体芯片以及 DBC、散热基板和其他材料。

报告期内，公司向前五名供应商采购情况如下：

单位：万元

2025 年 1-6 月				
序号	名称	采购内容	采购额	采购比例
1	第一名	芯片	37,281.08	25.07%
2	第二名	芯片	15,699.36	10.56%
3	第三名	芯片	14,612.31	9.83%
4	第四名	DBC	7,869.86	5.29%
5	第五名	散热基板	7,304.50	4.91%
合计			82,767.11	55.66%
2024 年度				
序号	名称	采购内容	采购额	采购比例
1	第一名	芯片	69,641.05	31.99%
2	第二名	芯片	26,043.97	11.96%
3	第三名	DBC	14,419.35	6.62%
4	第四名	散热基板	13,191.09	6.06%
5	第五名	芯片	9,005.12	4.14%
合计			132,300.57	60.77%
2023 年度				

序号	名称	采购内容	采购额	采购比例
1	第一名	芯片	96,063.71	33.84%
2	第二名	芯片	48,324.71	17.02%
3	第三名	芯片	8,936.39	3.15%
4	第四名	DBC	8,533.74	3.01%
5	第五名	衬底	7,585.99	2.67%
合计			169,444.55	59.69%
2022 年度				
序号	名称	采购内容	采购额	采购比例
1	第一名	芯片	57,511.11	29.82%
2	第二名	芯片	22,219.69	11.52%
3	第三名	DBC	8,337.01	4.32%
4	第四名	衬底	5,614.12	2.91%
5	第五名	铜材	4,985.75	2.59%
合计			98,667.68	51.16%

注：受同一实际控制人控制的供应商已合并计算。

报告期内，公司前五名供应商采购占采购总额的比例分别为 51.16%、59.69%、60.77% 和 55.66%，供应商比较集中，系行业特性。2023 年度和 2024 年度，公司第一大供应商采购额占比超过 30%，均系芯片采购。

公司董事、监事、高级管理人员，主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东与前五名供应商之间不存在关联关系。

（五）境外采购、销售情况及有关贸易政策的影响

报告期内，公司向境外采购的金额分别为 43,749.32 万元、57,716.60 万元、31,426.88 万元和 32,178.51 万元，占采购总额的比例分别为 22.63%、20.33%、14.44%和 22.68%。报告期内公司中国境内、境外采购情况如下表所示：

单位：万元

项目	境内采购		境外采购		合计
	金额	占比	金额	占比	
2025 年 1-6 月	116,519.12	78.36%	32,178.51	21.64%	148,697.62
2024 年度	186,274.47	85.56%	31,426.88	14.44%	217,701.36
2023 年度	226,149.60	79.67%	57,716.60	20.33%	283,866.20
2022 年度	149,112.02	77.32%	43,749.32	22.68%	192,861.34

注：境外采购金额系直接向境外供应商主体采购的金额。

公司存在部分原材料向境外采购的情况，包括芯片、衬底、DBC、外壳等。国际市场上相关产品的供应商数量较多，公司对单一相关供应商不存在依赖。根据相关国家法律法规要求，公司主要境外采购的元器件并非受限产品。

报告期内，发行人主营业务收入主要来源于中国境内，内销主营业务收入比重均超过 90%。公司境外销售占比较低，对经营业绩影响相对较小。

单位：万元

项目	2025 年 1-6 月	2024 年度	2023 年度	2022 年度
境外主营业务收入	17,256.86	26,328.64	30,948.72	11,931.63
主营业务收入	193,439.75	338,130.05	363,843.49	268,210.40
境外收入占主营业务收入比例	8.92%	7.79%	8.51%	4.45%

（六）现有业务发展安排及未来发展战略

1、现有业务发展安排

（1）持续发力新能源汽车及燃油汽车半导体器件市场

持续发力新能源汽车及燃油汽车半导体器件市场，在新能源汽车用驱动控制器领域为纯电动汽车、混动汽车、增程式汽车、燃料电池汽车等客户提供全功率段的车规级 IGBT 模块、车规级 SiC MOSFET 模块，完善辅助驱动和车用电源市场的产品布局，为客户提供完善的辅助驱动和车用电源市场的产品；在燃油车用汽车电子市场，开发更多的燃油车用车规级功率器件。

（2）继续深耕工业控制及电源行业

充分利用公司 650V/750V、1200V、1700V 自主芯片产品的性能优势、成本优势、交付优势，在变频器、电焊机、电梯控制器、伺服器、电源等领域持续发力，提高现有客户的采购份额，加大海外市场的开拓力度，突破海外头部客户，提高市场占有率。同时，继续坚持以技术为核心，加强和客户技术合作，不断研发出具有市场竞争力的产品。

（3）加速开拓新能源市场

在“碳中和”目标和清洁能源转型的双重背景下，公司将抓住光伏发电、风力发电以及储能市场快速发展的历史机遇，把握核心半导体器件国产化加速的市场机会，不断提高市场份额。

(4) 加大对变频白色家电市场的投入

持续加大对变频白色家电行业投入力度，充分利用美垦半导体技术团队在白色家电行业超过 10 年的技术积累，与公司第七代 IGBT 芯片、SiC MOSFET 芯片技术一起，给客户id提供从芯片-模块的一站式系统解决方案。

(5) 加速公司下一代 IGBT 芯片的研发和产业化

持续加大芯片研发力度，结合市场需求，进一步丰富基于第七代微沟槽 Trench FieldStop 技术的 IGBT 芯片以及和相匹配的快恢复二极管芯片的产品系列。

(6) 持续加大宽禁带功率半导体器件的研发力度

持续加大研发投入，开发出更多符合市场需求的车规级 SiC 功率模块。同时，公司加大 SiC 功率芯片的研发力度，在公司现有自主 SiC MOSFET 芯片的基础上，持续开展新一代 SiC MOSFET 芯片的研发，不断推出具有市场竞争力的 SiC 芯片和模块产品。开展车规级 GaN 器件的研发和产业化。

(7) 加大对 3300V-6500V 高压 IGBT 产品的研发和推广力度

持续加大公司自主的 3300V-6500V 高压 IGBT 产品在轨道交通、高压直流柔性输电等行业的推广力度，紧抓核心零部件国产化的机会。

2、未来发展战略

公司将继续坚持以市场为导向，以创新为驱动，以成为全球领先的为高能效、绿色化和智能化应用提供全面的半导体及系统解决方案提供商为目标，为客户创造更大价值，致力于成为世界顶尖的半导体制造企业。

首先，公司将始终坚持自主创新，加大研发投入，继续加大新一代 IGBT 芯片、快恢复二极管芯片、SiC MOSFET 芯片以及 MCU、栅极驱动 IC 等芯片的研发力度，攻克新一批关键技术。

其次，公司将紧跟国家政策指引，加大新兴行业布局，重点针对新能源汽车、新能源发电、储能、变频白色家电等行业推出在制造工艺、电性能、功耗、可靠性等方面具有国际领先水平，在价格、品质、技术支持等方面具备较强国际竞争力的产品，进一步扩大公司产品的市场覆盖面，满足更多客户的市场需求。

最后，公司将继续完善产业布局，深化 MCU、功率半导体与栅极驱动 IC 三者的协

同，构建起智能化系统中至关重要的“脑-心-神经”协同架构，持续增强公司为客户提供系统级解决方案的能力，为新能源、新能源汽车、机器人、低空/高空经济、AI 服务器电源、数据中心等下游行业提供更高性能、更优成本、更快响应的一体化解决方案。

九、公司的核心技术及研发情况

（一）研发投入情况

报告期内，公司的研发投入及占营业收入比例情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 1-6 月	2024 年度	2023 年度	2022 年度
研发投入	22,967.91	35,429.93	28,741.58	18,888.09
研发投入占营业收入的比重（%）	11.87	10.45	7.85	6.98

报告期各期，公司研发费用分别为 18,888.09 万元、28,741.58 万元、35,429.93 万元和 22,967.91 万元，占各期营业收入的比例分别为 6.98%、7.85%、10.45%和 11.87%。公司自成立以来一直以技术发展和产品质量为公司之根本，并以开发新产品、新技术为公司的主要工作，持续大幅度地增加研发投入，培养、组建了一支高素质的国际型研发队伍，涵盖了 IGBT 芯片、快恢复二极管芯片、SiC MOSFET 芯片以及 MCU、栅极驱动 IC 等芯片和 IGBT、SiC、GaN 等功率模块的设计、工艺开发、产品测试、产品应用等，在半导体技术、电力电子、控制、材料、力学、热学、结构等多学科具备了深厚的技术积累。

（二）研发人员情况

报告期内，公司的研发人员情况如下：

单位：人

项目	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
研发人员数量	699	572	483	357
总员工数量	3,125	2,471	2,002	1,413
研发人员数量占比	22.37%	23.15%	24.13%	25.27%

（三）公司核心技术及其应用情况

公司的核心技术均为自主研发创新，主要涵盖 IGBT 芯片、快恢复二极管芯片、SiC MOSFET 芯片等功率半导体芯片的设计、工艺和测试及功率半导体模块的设计、制造和测试。

IGBT 芯片包括 IGBT 微沟槽结构设计和工艺，芯片多层场终止设计和工艺、IGBT 芯片高压终端环设计、平面化有源区和终端环工艺，IGBT 温度传感器及电流传感器设计和工艺，超薄片工艺、IGBT 双面可焊接金属工艺，大功率半导体器件的串并联技术及动静态均流均压技术。

快恢复二极管芯片技术包括局部和全局少子寿命控制技术的协调设计，场终止层的优化设计，高压终端区域和阳极设计相匹配的离子注入和扩散工艺以及高可靠性的钝化层淀积工艺以及双面可焊接金属工艺。

SiC MOSFET 芯片包括精细化元胞设计、高可靠终端设计、自对准工艺技术、高性能栅极氧化层生长技术、高温离子注入及无损激活技术、双面可焊金属技术、芯片缺陷筛选技术。

IGBT 模块制造技术包括 IGBT 模块的结构-热-电路设计技术、模块的电磁场、温度场及应力场仿真优化技术、IGBT 模块的焊接、烧结、键合及注塑等核心工艺技术、功率半导体器件的静态、动态电参数及热参数测试技术、IGBT、SiC 及 GaN 等器件的可靠性试验及寿命评估技术等。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司已成功申请了 410 项中国境内专利，其中包括 75 项发明专利。公司主要核心技术、技术来源及成熟程度情况详见下表：

核心技术	技术来源	成熟程度
IGBT 芯片及快恢复二极管芯片相关技术	自主研发	已实现大批量生产
SiC MOSFET 芯片相关技术	自主研发	已实现大批量生产
IGBT 功率模块：多芯片并联技术及动静态均流技术，电磁场及温度场仿真优化技术、大面积真空焊接及功率端子信号端子超声焊接技术、基板预弯补偿技术。	自主研发	已实现大批量生产
IPM 功率模块：IGBT 驱动设计技术、集成模块注塑工艺技术、IPM 测试技术。	自主研发	已实现大批量生产
SiC 功率模块：SiC 模块银浆烧结技术、SiC 模块铜线键合技术、SiC 多芯片并联技术、SiC 缺陷筛选及可靠性技术、SiC 测试技术。	自主研发	已实现大批量生产
嵌入式功率模块：嵌入式封装多芯片并联设计技术、驱动一体化集成技术、嵌入式可靠性试验技术、嵌入式传热性能优化技术	自主研发	已实现小批量生产
氮化镓功率模块：氮化镓芯片铝带键合技术、氮化镓器件测试技术、氮化镓器件多芯片并联技术、氮化镓器件驱动技术、氮化镓器件可靠性技术	自主研发	已实现小批量生产

1、IGBT 芯片及快恢复二极管芯片相关技术

公司作为国内 IGBT 模块的龙头企业，是国内首个实现沟槽栅场终止型 IGBT 大规模量产的公司。近年来，公司持续进行技术的投入和更新换代，已经陆续开发出并且投入量产的平台包括：第二代平面栅 NPT 型 650V、1200V、1700V 全系列 IGBT 芯片；第四代沟槽栅场终止 650V、750V、1200V 及 1700V 全系列 IGBT 芯片；第七代微沟槽场终止 650V~1700V 全系列 IGBT 芯片；第七代 Plus 微沟槽场终止 650V~1700V 全系列 IGBT 芯片。其中第七代和第七代 Plus IGBT 芯片平台参数水平对标国际目前的最新技术水平。2025 年，公司还成功研发出第八代超微沟槽场终止技术，并已在 1400V 平台上面投入量产，预计会在 2026 年拓展到其他电压等级。开发过程中，公司掌握了 8 英寸/12 英寸晶圆减薄技术、微沟槽技术及相应的芯片应力控制，多晶硅和氧化硅的 CMP，平面化的终端工艺，背面高能离子注入技术、背面激光退火激活技术以及芯片内置传感器和双面可焊接金属等关键工艺技术。

公司已成功研发出了适合于大功率工业级和车规级模块的快恢复二极管芯片，投入量产的产品包括 650V、750V、1200V 和 1700V 全系列快恢复二极管芯片。并且，公司研发并量产了适配新一代 IGBT 芯片的具有更低导通压降、更好反向恢复特性的全电压系列 650V~1700V 新一代快恢复二极管芯片。开发过程中，公司掌握了薄片背面光刻和高能离子注入工艺，成功解决了局部和全局少子寿命控制技术的协调设计、场终止层的优化设计、高压终端区域和阳极设计相匹配的离子注入和扩散工艺以及高可靠性的钝化层淀积工艺等核心工艺技术。

2、SiC MOSFET 芯片相关技术

公司的 SiC MOSFET 芯片已在公司自有芯片工厂实现大规模量产，其性能、可靠性以及生产和测试良率都处在国际领先水平，已在新能源汽车主电机控制器领域实现大规模应用。2025 年上半年，公司自主研发的车规级第二代 SiC MOSFET 芯片开始批量出货，平台电压覆盖 750V、1200V、1400V、1500V 等多个电压等级，产品性能对标国际最新的第四代产品，将对应配套 400V、800V、1000V 等电压平台主电驱项目。公司掌握的 SiC MOSFET 芯片相关的核心技术有精细化元胞设计、高可靠性终端设计、自对准工艺技术、高性能栅极氧化层生长技术、高温离子注入及无损激活技术、双面可焊金属技术和芯片缺陷筛选技术等关键技术。

3、IGBT 功率模块相关技术

IGBT 功率模块的核心技术包括：

大功率半导体器件的串并联技术及动静态均流、均压技术：大功率的 IGBT 模块要并联多个芯片，需要通过设计保证所有并联的芯片在静态和动态条件下的分流均匀；对于应用于高压环境中的串联模块，需要保证静态和动态条件下模块间分压均匀。公司已经掌握上述技术，并在生产中得到良好应用，产品可靠性和稳定性高，已经受到市场的普遍认可。

多 DBC 并联技术：在大功率模块中，通常需要并联多个 DBC 板，公司通过优化 IGBT 模块中的 DBC 布局，最大可实现 6 个 DBC 板的并联，且能保证 DBC 板之间的一致性，从而提高了整个模块的可靠性，使产品适合于风力发电、光伏发电、轨道交通等大功率领域。

IGBT 模块的电磁场分布仿真及结构设计技术：根据应用的要求对模块内部的电磁场分布进行优化，对模块内部电路结构和外壳结构进行设计，实现了非常高的爬电和电气距离，使之能适应极为恶劣的工业环境，提高了模块的可靠性。

金属端子外壳插接和注塑技术：使用铝线或者铝带键合连接端子和 DBC，减少了端子焊接环节，提高了自动化程度，降低了生产成本。

4、IPM 功率模块相关技术

IPM 功率模块的核心技术包括：

IGBT 驱动设计技术：IPM 模块内部集成驱动和保护功能，需要开发匹配的驱动电路并根据工控调试短路、过载和过温保护功能。

集成模块注塑工艺技术：采用匹配的环氧材料进行一体化注塑成型，确保在温度冲击和功率循环等极端工况下内部注塑的高可靠性能，注塑材料在满足模块机械强度要求的同时，对模块的管脚进行固定。

IPM 测试技术：IPM 为集成功率模块，其测试相较于传统模块更为复杂，除了对功率半导体部分进行测试外还需要对与驱动相关的驱动及保护功能进行完整测试，设计测试程序及测试条件，确保模块满足终端客户的应用要求。

5、SiC 功率模块相关技术

SiC 功率模块的核心技术包括：

银浆烧结技术：采用银浆烧结后连接层熔点可达到 900 度以上，为锡焊工艺连接层熔点的 4 倍，适合于工作温度在 200 度以上的应用领域；银浆烧结层的电导、热导分别是锡焊连接层的 5 倍和 4 倍；密度和热膨胀系数两者基本相当，剪切强度为锡焊的 2 倍；故与传统焊接工艺相比，银浆烧结工艺优势较为明显。从热阻和可靠性的角度考虑，因为传统锡焊的焊料层厚度一般在 80 微米左右，而银浆烧结层的厚度仅为 15 微米左右，因银浆烧结工艺具有低的连接层厚度和高的热导率，故在降低芯片热阻的同时，可提高芯片的抗功率循环能力 2 倍以上。

铜线键合技术：铜线相较于铝线，其熔点从 660℃ 提高到 1,083℃，可大幅度提高过电流能力。同时其热导率、电阻率以及杨氏模量均大幅优于铝线，并且其热膨胀系数从铝线的 23.6 降为 16.5，可大幅降低芯片工作时升降温的连接层应力，提高芯片的抗功率循环能力。从热阻和可靠性的角度考虑，因为铜的热导率远高于铝，结合芯片表面的铜金属化工艺，可大幅提高芯片的表面热容，降低芯片结温波动，提高芯片的功率循环能力，预期抗功率循环能力可提高 10 倍以上。

碳化硅缺陷筛选及可靠性技术：碳化硅衬底和外延存在一定的缺陷，需要通过晶圆级和模块级的各种加严测试筛选，剔除早期失效，提升器件的可靠性水平，满足各种高可靠性应用的要求。

6、嵌入式功率模块相关技术

嵌入式功率模块的核心技术包括：

嵌入式封装多芯片并联设计技术：嵌入式模块将功率半导体芯片直接嵌入 PCB 板中，内部的芯片之间连接通过敷厚铜及铜通孔实现互连，不再使用传统铝线键合工艺，可以大幅度降低模块的寄生电感，提升模块的出流能力，通过优化 PCB 内部的布局及嵌入结构设计，实现多芯片的并联均流。

驱动一体化集成技术：嵌入式模块可以直接在 PCB 的顶层实现驱动电路的一体化集成，这样可以大幅度降低驱动电路与功率芯片之间的互连寄生效应，有利于提升驱动电路的性能，驱动一体化集成技术需要重点攻克热耦合和电磁耦合优化问题。

嵌入式可靠性试验技术：嵌入式模块为一种新型的封装技术，相较于传统模块引入了新的材料和新的封装工艺技术，其可靠性考核项目和考核条件及寿命评估目前没有行业标准，需要根据终端客户的综合工况信息进行可靠性设计和可靠性验证，需要从嵌入式模块的设计、工艺、材料及应用等多维度综合提升模块的可靠性水平。

7、氮化镓功率模块相关技术

氮化镓功率模块的核心技术包括：

GaN 芯片铝带键合技术：氮化镓芯片与传统 IGBT 或 SiC MOSFET 器件不同，所有电极分布与芯片表面，传统的铝线或铜线键合技术不适用于大功率 GaN 器件，需要开发专门的铝带键合技术以提升 GaN 器件的过流能力，降低电感和提升功率循环寿命，需要优化铝带的键合弧度和截面积以满足高可靠性应用要求；

GaN 器件多芯片并联技术：氮化镓器件开关速度快，难以进行多芯片并联，需要优化功率回路和控制回路以严格控制寄生电感，优化模块内部吸收电路设计，以实现多芯片动态均流及波形优化；

GaN 器件可靠性技术：氮化镓器件需要开展专门的可靠性试验进行可靠性及寿命评估，根据客户应用工控评估器件的使用寿命。

（四）核心技术的技术来源及其对公司的影响

公司长期以来重视研发投入，实现了产品与工艺的突破升级。公司核心技术主要来源于自主研发，在相关领域积累了一系列核心技术，并形成了大量的专利。截至 2025 年 6 月 30 日，公司拥有中国境内专利共 410 项，其中：75 项发明专利、275 项实用新型、60 项外观设计。

（五）公司在研项目情况

截至 2025 年 6 月末，公司主要在研项目情况如下：

序号	项目名称	拟达到目标	进展或阶段性成果
1	大电压、高功率密度、高可靠性 IGBT 功率模块的研发与产业化	（1）针对电动汽车用高功率密度 IGBT 模块进行技术攻关，研发高功率、低损耗、高可靠性的车规级 IGBT 模块，并推进产业化； （2）针对新能源发电行业 IGBT 模块进行技术攻关，研发高功率、低损耗、高可靠性的 IGBT 模块，并推进产业化； （3）针对 3300V 及以上高电压大功率模块进行技术	部分已批量交付

序号	项目名称	拟达到目标	进展或阶段性成果
		攻关，研发高电压、大功率、低损耗、高可靠性的 IGBT 模块，并推进产业化	
2	高集成、低损耗、高可靠性 IPM 功率模块	针对 IPM 功率模块进行技术攻关，研发高集成、低损耗、高可靠性、低成本的多合一 IPM 功率模块产品，并推进产业化	部分已批量交付
3	低电感、高电流密度、高功率密度、高可靠性碳化硅功率模块的研发与产业化	(1) 针对新能源汽车用 SiC MOSFET 模块进行技术攻关，研发低电感、高电流密度、高功率、低损耗、高可靠性的模块产品，并推进产业化； (2) 针对光储使用的 SiC 混合模块的研发和产业化	部分已批量交付
4	高功率密度、高可靠性、低损耗的嵌入式功率模块	采用创新的高压 PCB 嵌入式封装技术，研发低损耗、高集成度、高可靠性的嵌入式模块，并推进产业化	项目处于小批量交付
5	高功率密度、高可靠性、低损耗、超低电感氮化镓功率模块	针对氮化镓模块进行技术攻关，研发高功率密度、高可靠性、低损耗、超低电感的氮化镓模块，并推进产业化	项目处于小批量交付
6	高集成高可靠性车规级 MCU 芯片项目	基于车规 CMOS eFlash 工艺节点，通过优化总线系统设计、IP 等实现 SOC 主频和性能在成熟工艺节点上的提升，推出满足车规 ISO26262 ASIL-D 车规功能安全和国密信息安全的高性能车规动力驱动主控芯片，并推进产业化	项目处于开发阶段

十、公司的主要固定资产及无形资产

(一) 主要固定资产情况

公司固定资产主要包括房屋及建筑物、机器设备、运输工具等，均与公司日常经营活动直接相关。截至本募集说明书签署日，公司合法拥有上述固定资产，相关资产不存在纠纷或潜在纠纷，目前使用状况良好。

截至 2025 年 6 月末，公司固定资产账面原值、累计折旧、减值准备及成新率情况如下：

单位：万元

类别	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	成新率
房屋及建筑物	60,935.74	9,236.33	-	51,699.41	84.84%
机器设备	339,954.16	51,735.39	-	288,218.77	84.78%
运输工具	1,021.38	554.56	-	466.82	45.70%
其他	72,541.29	13,144.97	-	59,396.32	81.88%
合计	474,452.57	74,671.25	-	399,781.31	84.26%

注：成新率=固定资产账面价值/固定资产账面原值

截至 2025 年 6 月末，公司固定资产的综合成新率为 84.26%，其中机器设备成新率

为 84.78%，公司固定资产整体状态较好，为未来业务规模的持续扩大奠定了基础。整体来看公司固定资产综合成新率和运转情况良好，不存在长期闲置的固定资产。

（二）主要无形资产

1、专利

截至 2025 年 6 月 30 日，公司拥有中国境内专利共 410 项，其中：75 项发明专利、275 项实用新型、60 项外观设计，均处于专利权维持状态，具体情况参见本募集说明书“附件一：发行人及其控股子公司专利情况”。

2、商标

截至 2025 年 6 月 30 日，公司拥有 12 项注册商标，具体情况参见本募集说明书“附件二：发行人及其控股子公司商标情况”。

（三）不动产情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司及控股子公司拥有 12 项不动产，具体情况参见本募集说明书“附件三：发行人持有的不动产情况”。

（四）物业租赁

截至 2025 年 6 月 30 日，公司及控股子公司签署并正在履行的用于办公等用途的主要租赁合同情况如下：

序号	承租人	出租人	位置	租赁面积 (m ²)	租赁期限	用途
1	发行人	叶桂宏	南宁市青秀区凤凰岭路 1 号荣和大地第二组团 1 栋 A 单元 5C 号	89	2025.01.24-2027.01.23	办公
2	发行人	孙叶菲	保定市莲池区紫金山小区 5-2-1103 室房屋及附属车位 C482 号	/	2023.02.05-2026.02.04	办公
3	重庆安达	重庆金凤科技产业发展有限公司	重庆高新区科学谷 B1 号楼第 3 层部分	567.5	2025.04.01-2025.07.31	办公
4	浙江谷蓝电子科技有限公司南京分公司	尹争	江苏省南京市江宁区秣陵街道天元西路 158 号亚都天元居 01 幢 534 室	68.45	2023.10.15-2025.10.14	办公
5	斯达上海	深圳市新创空间科技有限公司	深圳市宝安区新湖路 4008 号衡芳科技办公大厦 A 座-1701B	/	2024.07.22-2025.07.31	办公
6	斯达上海	北京亦宸企业管理有限公司	北京市经济技术开发区经海三路 109 号楼天骥智谷 13 号楼 2 层 205 单元	85	2025.05.15-2026.05.14	办公
7	斯达上海	山东华赢地产集团有限公司	济南市历下区华润置地广场 7 号楼 7 层 712C	/	2024.08.01-2025.07.31	办公

序号	承租人	出租人	位置	租赁面积 (m ²)	租赁期限	用途
8	斯达上海	青岛百千地商务服务有限公司	山东省青岛市崂山区海尔路182号3号楼15层1505-B01室	/	2024.11.01-2025.10.31	办公
9	斯达上海	武汉创客星孵化器有限公司	武汉市洪山区创意天地高层9-11号楼3层345室	39.34	2025.03.13-2026.03.12	办公
10	斯达上海	黄采宇	成都市锦江区锦华路一段160号中港广场1栋1单元44楼4413号	49.87	2024.04.22-2025.10.21	办公
11	斯达上海	广州鑫想产业运营管理有限公司	广州市番禺区新造镇智港北街12号204室自编K02	5	2025.06.25-2026.06.24	办公
12	上海道之	上海思锐置业有限公司	上海市浦东新区祥科路268号3层308室、309室	709.18	2025.01.03-2028.01.02	办公
13	上海道之	中国人民财产保险股份有限公司苏州市分公司	苏州市虎丘区狮山路16号写字楼第16层01、02-1号	476.13	2025.05.01-2028.09.15	办公
14	上海道之	上海奋青科技服务有限公司	上海市徐汇区宜山路717号（游族大厦）317室	/	2024.02.01-2026.01.31	办公
15	上海道之	上海求实经济发展中心	上海市普陀区真北路915号上海绿洲中环中心7层815室	138.23	2023.08.01-2025.07.31	办公
16	上海道之	宜昌策源商办置业有限公司	武汉市东湖新技术开发区玲喻路889附1号融众国际写字楼31层3102室	121	2024.01.03-2025.06.30	办公
17	上海道之	天津天保瑞泰物业服务有限公司	天津市空港经济区华睿广场天保瑞泰商务中心202室	118	2024.11.22-2027.11.21	办公
18	美垦半导体	重庆美的制冷设备有限公司	重庆市南岸茶园新区南涪路美的工业园1#厂房一楼原IPM车间	4000	2025.01.01-2025.12.31	办公
19	美垦半导体	美的集团股份有限公司	佛山市顺德区北滘镇北滘社区居民委员会工业大道美的全球创新中心主楼4楼	375.2	2025.01.16-2025.12.31	办公
20	斯达欧洲	Tarchini Real Estate SA	CMC, Mapp. 540 a Cadenazzo, al primo piano, Swiss	201	2024.07.01-2025.06.30	办公
21	斯达欧洲	Akara Tower	Brown Boveri Platz 4, Baden	234	2024.05.01-2034.04.30	办公
22	斯达欧洲	MIP Immobilien-Verwaltungs GmbH & Co. KG	Steinstrasse 19-21/Wiesentalstrasse 32-40 in 90419 Nürnberg, Germany	240	2020.07.15-2025.07.14	办公及实验室

注：上表中第16项租赁到期后不再续租，第20项租赁已于到期后续租

上述房产均未办理房屋租赁备案手续。根据《中华人民共和国民法典》有关规定，租赁合同未办理租赁备案登记手续不会影响租赁合同的效力，租赁合同对合同双方均具有约束力，合法、有效。发行人及子公司租赁房屋未办理备案手续及部分房产未取得权属证明等情况均不会构成本次发行的实质性法律障碍。

十一、业务经营许可情况

（一）发行人拥有的主要生产经营资质

截至 2025 年 6 月 30 日，公司拥有的与主营业务相关的主要资质如下：

序号	公司名称	资质/证书名称	发证机关	编号	发证时间	到期时间
1	斯达半导	固定污染源排污登记回执	/	913304007731328302001W	2025 年 2 月 24 日	2030 年 2 月 23 日
		辐射安全许可证	浙江省生态环境厅	浙环辐证[F2266]	2023 年 6 月 9 日	2028 年 6 月 8 日
		进出口货物收发货人	/	330494000P	/	2099 年 12 月 31 日
2	浙江谷蓝	固定污染源排污登记回执	/	91330481307391982N001Y	2025 年 4 月 14 日	2030 年 4 月 13 日
		辐射安全许可证	嘉兴市生态环境局	浙环辐证[F8098]	2024 年 9 月 26 日	2029 年 9 月 25 日
		进出口货物收发货人	/	33139609YN	/	2099 年 12 月 31 日
3	斯达微电子	固定污染源排污登记回执	/	91330402MA2JG80587001Z	2024 年 12 月 30 日	2029 年 12 月 29 日
1		进出口货物收发货人	/	3304960BFH	/	2099 年 12 月 31 日
4	上海道之	排污登记凭证	/	91310114059383050W001W	2024 年 4 月 24 日	2029 年 4 月 23 日
		辐射安全许可证	上海市嘉定区生态环境局	沪环辐证[65288]	2024 年 4 月 24 日	2029 年 4 月 23 日
		城镇污水排入排水管网许可证	上海市嘉定区水务局	嘉水务排证字第 004130177 号	2021 年 12 月 2 日	2026 年 12 月 1 日
		进出口货物收发货人	/	3114965962	/	2099 年 12 月 31 日
5	美垦半导体	固定污染源排污登记回执	/	91500108MA61C6Q30C001Z	2023 年 3 月 9 日	2028 年 3 月 8 日
		辐射安全许可证	重庆市南岸区生态环境局	渝环辐证[14028]	2025 年 5 月 26 日	2030 年 5 月 25 日
		进出口货物收发货人	/	50082609BL	/	2099 年 12 月 31 日

（二）发行人拥有的相关认证证书情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司拥有的主要企业认证情况如下：

序号	持证主体	文件名称	发证单位	证书编号	发证时间	到期时间
1	斯达半导	能源管理体系认证证书	北京中大华远认证中心有限公司	02024En0078R0M	2024 年 7 月 22 日	2027 年 7 月 21 日
		质量管理体系认证证书	上海恩可埃认证有限公司	T10415/0510517	2024 年 4 月 10 日	2027 年 4 月 9 日
		环境管理体系认证证书	北京中大华远认证中心有限公司	02024E0352R4M	2024 年 3 月 18 日	2027 年 3 月 17 日

序号	持证主体	文件名称	发证单位	证书编号	发证时间	到期时间
		质量管理体系认证证书	北京中大华远认证中心有限公司	02023Q1166R5M	2023年6月4日	2026年4月8日
		职业健康安全管理体系认证证书	北京中大华远认证中心有限公司	02023S0720R1M	2023年6月4日	2026年6月3日
2	浙江谷蓝	质量管理体系认证证书	上海恩可埃认证有限公司	T183512/0479356	2025年6月24日	2026年7月23日
		安全生产标准化三级企业（机械）	嘉兴市应急管理局	嘉 AQBXXIII202400017	2024年2月4日	2027年2月1日
3	上海道之	质量管理体系认证证书	上海恩可埃认证有限公司	T81362/0540193	2024年8月24日	2027年8月23日
		环境管理体系认证证书	北京中大华远认证中心有限公司	02023E0941R0M	2023年7月6日	2026年7月5日
		安全生产标准化三级企业（机械）	上海市嘉定区应急管理局	/	2023年4月	2026年4月
4	美垦半导体	质量管理体系认证证书	中国质量认证中心有限公司	00124Q38658R1M/5000	2024年10月9日	2027年11月7日

截至 2025 年 6 月 30 日，公司在生产经营方面不存在商业特许经营项目及特许经营权的情况。

（三）高新技术企业证书情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司拥有的高新技术企业证书情况如下：

序号	持证主体	发证单位	证书编号	发证时间	有效期
1	斯达半导	浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局	GR202333013056	2023 年 12 月 8 日	三年
2	浙江谷蓝	浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局	GR202333012809	2023 年 12 月 8 日	三年
3	斯达微电子	浙江省经济和信息化厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局	GR202433005906	2024 年 12 月 6 日	三年
4	上海道之	上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局	GR202331002827	2023 年 11 月 15 日	三年
5	美垦半导体	重庆市科学技术局、重庆市财政局、国家税务总局重庆市税务局	GR202351100902	2023 年 10 月 16 日	三年

十二、安全生产和环境保护

（一）安全生产

发行人高度重视安全生产工作，建立了相关管理制度。报告期内，发行人未发生过重大安全事故或因安全生产事宜遭受当地主管部门处罚的情形。

（二）环境保护

公司制造的产品均为功率半导体模块，在生产过程中产生的污染物较少。报告期内公司及子公司遵守国家及当地环境保护法律、法规，未因环境问题受到环保行政处罚。

十三、公司上市以来重大资产重组情况

自 2020 年 2 月在上海证券交易所主板上市以来，发行人未实施过《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

十四、公司境外经营情况

发行人境外生产经营的主体包含斯达欧洲、斯达香港及其下属企业。

十五、报告期内的分红情况

（一）公司利润分配政策

为规范公司利润分配行为，推动公司建立科学、持续、稳定的利润分配机制，保护中小投资者合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告〔2025〕5 号）等法律法规的要求，公司现行有效《公司章程》中规定的利润分配政策如下：

1、公司利润分配政策

（1）公司可以采取现金、股票或者现金加股票相结合的方式分配利润，具备现金分红条件的，应当优先采用现金分红进行利润分配；公司原则上每年进行一次利润分配，公司董事会可以根据公司情况提议在中期进行现金分红。

（2）现金分红的具体条件和比例：

1）公司当年实现盈利，且弥补以前年度亏损和依法提取公积金后，累计未分配利润为正值，且审计机构对公司的该年度财务报告出具无保留意见的审计报告，公司应当

采取现金方式分配利润。公司无重大资金支出等事项发生（募集资金投资项目除外），公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%，但公司存在以前年度未弥补亏损的，以现金方式分配的利润不少于弥补亏损后的可供分配利润的 10%。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。在公司具有成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素的条件下，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。

重大资金支出指：①公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且超过 5,000 万元人民币；②公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的 30%。

2) 公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

(3) 公司主要采取现金分红的利润分配政策，若公司营业收入增长快速，并且董事会认为公司股票价格与股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金利润分配条件下，提出并实施股票股利分配预案。

(4) 存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

(5) 公司发行证券、重大资产重组、合并分立或者因收购导致控制权发生变更的，公司应当在募集说明书或发行预案、重大资产重组报告书、权益变动报告书或者收购报

告书中详细披露募集或发行、重组或者控制权发生变更后公司的现金分红政策及相应的安排、董事会对上述情况的说明等信息。

(6) 公司的利润分配应符合相关法律、法规的规定，且需要保持利润分配政策的连续性、稳定性。

2、公司利润分配的决策程序和机制

(1) 公司董事会根据公司盈利情况、资金需求和股东回报规划，结合独立董事、监事及中小股东的意见和诉求提出合理的分红建议和预案，公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见，经董事会审议通过后报公司股东大会批准后实施。如需调整利润分配方案，应重新履行上述程序。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红方案并直接提交董事会审议。公司至少每三年重新审议一次股东分红回报规划；若公司经营情况没有发生较大变化，可以参照最近一次制定或修订的分红回报规划执行，不另行制定三年分红回报规划。

(2) 公司应当严格执行本章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。确有必要对本章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足本章程规定的条件，根据股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过；独立董事应对调整或变更的理由的真实性、充分性、合理性、审议程序的真实性和有效性以及是否符合本章程规定的条件等事项发表明确意见，且公司应在股东大会召开前与中小股东充分沟通交流，并及时答复中小股东关心的问题，必要时，可通过网络投票系统征集股东意见。

(3) 公司调整现金分红政策的具体条件：

1) 公司发生亏损或者已发布预亏提示性公告的；

2) 自利润分配的股东大会召开日后的两个月内，公司除募集资金、政府专项财政资金等专款专用或专户管理资金以外的现金（含银行存款、高流动性的债券等）余额均不足以支付现金股利；

3) 按照既定分红政策执行将导致公司股东大会或董事会批准的重大投资项目、重大交易无法按既定交易方案实施的；

4) 董事会有合理理由相信按照既定分红政策执行将对公司持续经营或保持盈利能力构成实质性不利影响的。

(4) 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。

3、现金分红的监督约束机制

(1) 监事会应对董事会和管理层执行公司分红政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。

(2) 公司董事会、股东大会在对利润分配政策进行决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和中小股东的意见。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应通过多种渠道（包括但不限于开通专线电话、董秘信箱及邀请中小投资者参会等）主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

(3) 在公司有能力进行现金分红的情况下，公司董事会未做出现金分红预案的，应当说明未现金分红的原因、相关原因与实际情况是否相符合、未用于分红的资金留存公司的用途及收益情况，独立董事应当对此发表明确的独立意见。股东大会审议上述议案时，应为中小股东参与决策提供便利。

(4) 在公司盈利的情况下，公司董事会未做出现金利润分配预案或现金分红低于上述利润分配政策规定比例的，应当在定期报告中披露未分红或少分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。

(5) 公司应当在定期报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，说明是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分维护等。对现金分红政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。

（二）公司最近三年现金分红及未分配利润使用情况

1、最近三年现金分红情况

最近三年，公司利润分配情况如下表：

单位：万元

项目	2024 年	2023 年	2022 年
现金分红金额（含税）	15,230.27	27,315.87	24,529.27
归属于母公司所有者的净利润	50,766.63	91,052.60	81,764.29
占归属于母公司所有者的净利润的比率	30.00%	30.00%	30.00%
最近三年累计现金分红金额	67,075.41		
最近三年年均归属于母公司所有者的净利润	74,527.84		
最近三年累计现金分红金额/最近三年年均归属于母公司所有者的净利润	90.00%		

公司最近三年现金分红情况符合法律法规和《公司章程》的相关规定。为保持公司的可持续发展，公司历年滚存的未分配利润作为公司业务发展资金的一部分，继续投入公司生产经营，以支持公司长期可持续发展，提高公司的市场竞争力和盈利能力。

2、最近三年未分配利润使用情况

为保持公司的可持续发展，公司最近三年实现的归属于上市公司股东的净利润在提取法定盈余公积金及向股东分红后，当年剩余的未分配利润结转至下一年度，作为公司业务发展资金的一部分，主要用于日常经营、对外投资、项目开拓等方面，以支持公司长期可持续发展，提高公司的市场竞争力和盈利能力。公司未分配利润的使用安排符合公司的实际情况和公司全体股东利益。

（三）公司未来股东回报规划

为了完善和健全斯达半导体股份有限公司（以下简称“公司”）的分红决策和监督机制，增强公司利润分配的透明度，持续、稳定、科学地回报投资者，切实保护公众投资者的合法权益，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2025年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的相关要求以及《公司章程》的相关规定，公司在充分考虑公司实际经营情况及未来发展需要的基础上，制定了《斯达半导体股份有限公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》（以下简称“本规划”），具体内容如下：

1、制定本规划考虑的因素

本规划着眼于公司长远和可持续的发展，综合考虑公司所处行业特点、公司实际经营情况及未来发展规划、盈利水平、公司财务及现金流状况、外部融资环境及股东回报

等因素，建立对投资者科学、持续、稳定的股东回报规划和机制，以保证公司利润分配政策的持续性和稳定性。

2、本规划的制定原则

本规划的制定以符合相关法律法规及《公司章程》关于利润分配的规定为原则，兼顾公司持续发展需要和投资者合理回报需求，实行持续、稳定的利润分配政策。

3、未来三年（2025 年—2027 年）股东回报规划具体内容

（1）利润分配的形式

公司可以采取现金、股票或者现金加股票相结合的方式分配利润，具备现金分红条件的，应当优先采用现金分红进行利润分配。

（2）分配期间间隔

公司原则上每年进行一次利润分配，公司董事会可以根据公司情况提议在中期进行现金分红。

（3）现金分红条件和比例

1) 公司当年实现盈利，且弥补以前年度亏损和依法提取公积金后，累计未分配利润为正值，且审计机构对公司的该年度财务报告出具无保留意见的审计报告，公司应当采取现金方式分配利润。公司无重大资金支出等事项发生（募集资金投资项目除外），公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%，但公司存在以前年度未弥补亏损的，以现金方式分配的利润不少于弥补亏损后的可供分配利润的 10%。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。在公司具有成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素的情况下，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。

重大资金支出指：1) 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且超过 5,000 万元人民币；2) 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的 30%。

2) 公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，

提出差异化的现金分红政策：

①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

（4）股票股利发放条件

公司主要采取现金分红的利润分配政策，若公司营业收入增长快速，并且董事会认为公司股票价格与股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金利润分配条件下，提出并实施股票股利分配预案。

4、公司利润分配的决策程序和机制

（1）公司董事会根据公司盈利情况、资金需求和股东回报规划，结合独立董事、监事及中小股东的意见和诉求提出合理的分红建议和预案，公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见，经董事会审议通过后报公司股东大会批准后实施。如需调整利润分配方案，应重新履行上述程序。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红方案并直接提交董事会审议。公司至少每三年重新审议一次股东分红回报规划；若公司经营情况没有发生较大变化，可以参照最近一次制定或修订的分红回报规划执行，不另行制定三年分红回报规划。

（2）公司应当严格执行《公司章程》确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。确有必要对《公司章程》确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足《公司章程》规定的条件，根据股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过；独立董事应对调整或变更的理由的真实性、充分性、合理性、审议程序的真实性和有效性以及是否符合《公司章程》规定的条件等事项发表明确意见，且

公司应在股东大会召开前与中小股东充分沟通交流，并及时答复中小股东关心的问题，必要时，可通过网络投票系统征集股东意见。

(3) 公司调整现金分红政策的具体条件：

1) 公司发生亏损或者已发布预亏提示性公告的；

2) 自利润分配的股东大会召开日后的两个月内，公司除募集资金、政府专项财政资金等专款专用或专户管理资金以外的现金（含银行存款、高流动性的债券等）余额均不足以支付现金股利；

3) 按照既定分红政策执行将导致公司股东大会或董事会批准的重大投资项目、重大交易无法按既定交易方案实施的；

4) 董事会有合理理由相信按照既定分红政策执行将对公司持续经营或保持盈利能力构成实质性不利影响的。

(4) 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。

5、现金分红的监督约束机制

(1) 监事会应对董事会和管理层执行公司分红政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。

(2) 公司董事会、股东大会在对利润分配政策进行决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和中小股东的意见。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应通过多种渠道（包括但不限于开通专线电话、董秘信箱及邀请中小投资者参会等）主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

(3) 在公司有能力进行现金分红的情况下，公司董事会未做出现金分红预案的，应当说明未现金分红的原因、相关原因与实际情况是否相符合、未用于分红的资金留存公司的用途及收益情况，独立董事应当对此发表明确的独立意见。股东大会审议上述议案时，应为中小股东参与决策提供便利。

(4) 在公司盈利的情况下，公司董事会未做出现金利润分配预案或现金分红低于上述利润分配政策规定比例的，应当在定期报告中披露未分红或少分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。

(5) 公司应当在定期报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况, 说明是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求, 分红标准和比例是否明确和清晰, 相关的决策程序和机制是否完备, 独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用, 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会, 中小股东的合法权益是否得到充分维护等。对现金分红政策进行调整或变更的, 还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。

十六、公司最近三年发行的债券情况和其他债务情况

(一) 最近三年公司债券发行情况

最近三年, 公司未发行过任何形式的公司债券。截至本募集说明书签署日, 公司不存在任何形式的公司债券。

(二) 最近三年的债务偿付情况

最近三年, 公司不存在债务违约或者延迟支付本息的情形。

(三) 公司最近三年平均可分配利润支付公司债券利息的能力测算

2022 年度、2023 年度、2024 年度, 公司归属于母公司所有者的净利润(以扣除非经常性损益前后孰低者计)分别为 76,235.69 万元、88,622.47 万元和 48,736.56 万元, 最近三年平均可分配利润为 71,198.24 万元。本次向不特定对象发行可转债按募集资金 150,000.00 万元计算, 参考近期可转换公司债券市场的发行利率水平并经合理估计, 公司最近三年平均可分配利润足以支付可转换公司债券一年的利息。

(四) 本次发行规模对公司资产负债结构的影响

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 150,000.00 万元(含 150,000.00 万元)。本次发行完成后, 公司累计债券余额不超过 150,000.00 万元, 占截至 2025 年 6 月末公司合并口径净资产 689,947.88 万元的比例不超过 50%, 符合《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见-证券期货法律适用意见第 18 号》的相关要求。

本次发行完成后, 公司总资产和净资产规模将有所增加, 资金实力将得到强化, 整体财务状况得到进一步改善。本次发行有利于增强公司抵御财务风险的能力, 优化资产结构, 降低公司的财务风险。

第五节 财务会计信息与管理层分析

本节引用的财务会计信息，非经特别说明，均引自公司 2022 年度、2023 年度和 2024 年度经审计的财务报告以及公司披露的 2025 年半年度财务报告，财务指标以上述财务报表为基础编制。投资者欲对公司的财务状况、经营成果及会计政策进行更详细的了解，请阅读财务报告及审计报告全文。

一、会计师事务所的审计意见类型及重要性水平

（一）审计意见类型

公司 2022 年、2023 年和 2024 年财务报告经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并分别出具了信会师报字[2023]第 ZA10942 号、信会师报字[2024]第 ZA10608 号及信会师报字[2025]第 ZA11737 号标准无保留意见的审计报告。公司 2025 年 1-6 月财务报告未经审计。

非经特别说明，本募集说明书均以 2022 年、2023 年、2024 年及 2025 年 1-6 月合并财务报表口径数据为基础。

以下财务数据若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

（二）与财务会计信息相关的重要性水平的判断标准

公司根据自身业务特点和所处行业，从项目性质及金额两方面判断与财务会计信息相关的重大事项或重要性水平。在判断项目性质重要性时，公司主要考虑该项目的性质是否显著影响公司财务状况、经营成果和现金流量，是否会引起特别的风险。在判断项目金额大小的重要性时，综合考虑该项目金额占总资产、净资产、营业收入、净利润等项目金额比重情况。

二、最近三年及一期财务报表

（一）资产负债表

单位：万元

项目	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：				

项目	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
货币资金	118,945.31	118,988.91	191,129.04	286,811.40
交易性金融资产	-	-	2,712.56	70,272.88
应收账款	92,625.37	91,267.23	69,086.99	54,105.12
应收款项融资	30,821.84	40,802.80	41,251.61	22,569.29
预付款项	2,934.89	827.60	3,687.93	1,034.12
其他应收款	192.11	167.96	553.73	89.19
存货	157,423.30	128,012.95	126,059.13	70,172.90
其他流动资产	8,265.53	3,225.10	2,131.23	10,820.19
流动资产合计	411,208.35	383,292.53	436,612.23	515,875.07
非流动资产：				
其他权益工具投资	57.20	57.20	-	-
固定资产	399,781.31	250,147.60	150,609.46	66,775.79
在建工程	188,494.08	305,948.97	166,764.02	95,774.21
使用权资产	711.91	436.14	53.04	31.33
无形资产	12,808.70	10,792.21	10,470.53	8,952.62
商誉	5,159.70	-	-	-
递延所得税资产	2,667.82	2,639.88	2,233.23	361.39
其他非流动资产	18,227.21	11,253.12	81,610.14	25,005.35
非流动资产合计	627,907.94	581,275.11	411,740.42	196,900.69
资产总计	1,039,116.29	964,567.65	848,352.65	712,775.77
流动负债：				
短期借款	1,115.17	1,115.17	-	-
应付账款	101,787.43	79,792.71	56,756.18	47,905.56
合同负债	4,375.75	6,194.72	1,692.00	2,775.73
应付职工薪酬	3,855.75	5,711.93	5,391.97	3,833.16
应交税费	3,165.14	4,258.56	2,551.81	1,562.33
其他应付款	8,620.57	1,516.54	2,109.06	1,234.65
一年内到期的非流动负债	926.70	764.97	498.34	367.90
其他流动负债	152.88	742.48	141.01	225.69
流动负债合计	123,999.38	100,097.08	69,140.38	57,905.03
非流动负债：				
长期借款	183,804.83	160,669.41	104,211.67	66,367.39

项目	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
租赁负债	555.50	340.98	15.24	1.45
预计负债	1,120.36	-	-	-
递延收益	33,649.24	23,049.48	22,033.56	14,327.79
递延所得税负债	6,039.09	6,042.87	3,474.56	60.42
非流动负债合计	225,169.02	190,102.74	129,735.03	80,757.05
负债合计	349,168.40	290,199.82	198,875.41	138,662.08
所有者权益：				
实收资本（或股本）	23,947.35	23,946.90	17,095.53	17,078.43
资本公积	396,433.60	396,392.51	401,938.28	398,887.26
其他综合收益	345.01	8.64	106.88	-50.97
盈余公积	10,008.78	10,008.78	8,547.76	8,539.21
未分配利润	250,152.56	237,837.87	215,848.12	149,333.34
归属于母公司所有者权益合计	680,887.28	668,194.71	643,536.58	573,787.28
少数股东权益	9,060.60	6,173.12	5,940.66	326.41
所有者权益合计	689,947.88	674,367.83	649,477.24	574,113.69
负债和所有者权益总计	1,039,116.29	964,567.65	848,352.65	712,775.77

（二）利润表

单位：万元

项目	2025 年 1-6 月	2024 年	2023 年	2022 年
一、营业收入	193,561.04	339,062.07	366,296.54	270,549.84
减：营业成本	135,998.05	232,071.73	228,907.06	161,509.72
税金及附加	1,086.07	1,836.56	1,192.44	1,132.35
销售费用	1,558.05	3,450.39	3,791.29	3,086.09
管理费用	6,249.21	9,966.16	8,073.82	7,137.99
研发费用	22,967.91	35,429.93	28,741.58	18,888.09
财务费用	-2,414.92	-610.34	-6,961.72	-10,184.49
其中：利息费用	124.65	290.31	178.77	240.59
利息收入	281.91	2,005.60	7,491.73	9,587.07
加：其他收益	3,278.48	7,797.84	3,720.39	2,927.25
投资收益（损失以“—”号填列）	203.35	438.00	240.24	1,159.97
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	-	-	432.70	779.22

项目	2025 年 1-6 月	2024 年	2023 年	2022 年
信用减值损失（损失以“-”号填列）	19.50	-1,210.02	-1,198.42	-1,058.77
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-507.91	-3,290.19	-57.22	-57.55
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-10.27	-13.68	2.59	1.20
二、营业利润	31,099.83	60,639.58	105,692.34	92,731.43
加：营业外收入	7.40	10.75	15.06	17.75
减：营业外支出	1.50	10.10	1,306.39	36.50
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31,105.73	60,640.23	104,401.00	92,712.68
减：所得税	3,194.67	9,301.56	12,331.10	10,638.04
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	27,911.07	51,338.67	92,069.91	82,074.64
（一）按经营持续性分类				
持续经营净利润	27,911.07	51,338.67	92,069.91	82,074.64
（二）按所有权归属分类				
归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	27,544.96	50,766.63	91,052.60	81,764.29
少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	366.11	572.04	1,017.31	310.35
五、其他综合收益的税后净额	480.52	-144.75	225.50	1.64
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	336.37	-98.24	157.85	1.15
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	144.16	-46.52	67.65	0.49
六、综合收益总额	28,391.59	51,193.92	92,295.41	82,076.28
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	27,881.32	50,668.39	91,210.45	81,765.44
（二）归属于少数股东的综合收益总额	510.27	525.53	1,084.96	310.85

（三）现金流量表

单位：万元

项目	2025 年 1-6 月	2024 年	2023 年	2022 年
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	168,611.00	285,718.15	337,853.49	257,639.11
收到的税费返还	2,926.77	27,143.47	21,889.15	6.03
收到其他与经营活动有关的现金	20,194.88	11,498.58	22,463.60	16,445.94
经营活动现金流入小计	191,732.65	324,360.20	382,206.23	274,091.08
购买商品、接受劳务支付的现金	111,197.28	160,610.23	293,107.77	161,515.26

项目	2025 年 1-6 月	2024 年	2023 年	2022 年
支付给职工以及为职工支付的现金	25,435.65	35,813.60	26,691.28	18,261.78
支付的各项税费	9,501.65	12,168.64	11,265.66	21,650.23
支付其他与经营活动有关的现金	9,162.76	19,503.66	12,872.96	5,828.53
经营活动现金流出小计	155,297.34	228,096.14	343,937.66	207,255.79
经营活动产生的现金流量净额	36,435.31	96,264.06	38,268.57	66,835.29
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	282,500.00	467,700.00	125,000.00	300,000.00
取得投资收益收到的现金	480.97	821.45	1,907.64	2,728.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3.25	14.99	5.81	3.89
投资活动现金流入小计	282,984.22	468,536.43	126,913.45	302,732.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,402.02	200,304.48	220,292.67	130,193.21
投资支付的现金	282,500.00	465,000.00	57,700.00	295,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	9,444.29	-	-	-
投资活动现金流出小计	330,346.30	665,304.48	277,992.67	425,193.21
投资活动产生的现金流量净额	-47,362.09	-196,768.04	-151,079.21	-122,460.80
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	41.53	1,239.44	6,755.27	2,381.55
取得借款收到的现金	60,867.97	75,468.65	38,095.72	56,115.95
筹资活动现金流入小计	60,909.50	76,708.08	44,850.99	58,497.50
偿还债务支付的现金	37,732.55	17,900.00	327.47	58.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,919.16	33,645.91	27,515.07	13,081.90
支付其他与筹资活动有关的现金	121.90	112.29	38.01	110.86
筹资活动现金流出小计	49,773.61	51,658.19	27,880.55	13,251.65
筹资活动产生的现金流量净额	11,135.89	25,049.89	16,970.43	45,245.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,091.85	-1,028.85	156.02	67.93
五、现金及现金等价物净增加额	2,300.97	-76,482.93	-95,684.18	-10,311.73
加：期初现金及现金等价物余额	114,605.87	191,088.80	286,772.99	297,084.71
六、期末现金及现金等价物余额	116,906.83	114,605.87	191,088.80	286,772.99

三、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及其变化情况

（一）财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则基本准则》和具体会计准则，以及颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

（二）合并范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括公司及公司的子公司（指被公司控制的主体，包括企业、被投资单位中可分割部分、以及企业所控制的结构化主体等）。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

（三）合并报表范围及其变化情况

1、报告期末合并报表范围

截至 2025 年 6 月 30 日，公司合并报表范围内子公司如下：

序号	公司名称	成立时间	持股比例	注册资本(万元 ¹)	取得方式
1	上海道之科技有限公司	2013 年 1 月 4 日	99.50%	21,030.00	新设
2	斯达半导体欧洲股份公司 (StarPower Europe AG)	2014 年 5 月 14 日	70.00%	60.00	新设
3	浙江谷蓝电子科技有限公司	2014 年 6 月 20 日	100.00%	1,250.00	原非同一控制下企业合并形成的浙江道之科技有限公司分立
4	嘉兴斯达电子科技有限公司	2015 年 9 月 10 日	100.00%	1,000.00	新设
5	嘉兴斯达微电子有限公司	2021 年 2 月 26 日	100.00%	210,933.16	新设
6	嘉兴斯达集成电路有限公司	2021 年 3 月 31 日	100.00%	5,000.00	新设
7	重庆安达半导体有限公司	2023 年 6 月 19 日	70.00%	15,000.00	新设
8	斯达半导体（上海）有限公司	2023 年 11 月 9 日	100.00%	5,000.00	新设

¹ 斯达半导体欧洲股份公司（StarPower Europe AG）注册资本为 60.00 万瑞士法郎，斯达半导体（香港）有限公司注册资本为 10.00 万美元，斯达半导体（香港）有限公司子公司 A 注册资本为 3,000 新加坡元，斯达半导体（香港）有限公司孙公司 A 注册资本为 250.00 万马来西亚林吉特，其余公司注册资本单位为人民币万元

序号	公司名称	成立时间	持股比例	注册资本(万元 ¹)	取得方式
9	斯达半导体（香港）有限公司	2024 年 11 月 20 日	100.00%	10.00	新设
10	美垦半导体技术有限公司	2021 年 1 月 26 日	80.00%	20,000.00	非同一控制下企业合并
11	斯达半导体（香港）有限公司子公司 A	2025 年 1 月 8 日	100.00%	0.30	新设
12	斯达半导体（香港）有限公司孙公司 A	2025 年 2 月 12 日	100.00%	250.00	新设
13	斯达半导体（重庆）有限公司	2025 年 6 月 16 日	100.00%	5,000.00	新设

2、合并报表范围变化情况

（1）2025 年 1-6 月

2025 年 1-6 月，公司合并报表范围新增 4 家主体，具体如下：

1) 收购美垦半导体技术有限公司 80%股权

根据公司与美的集团股份有限公司、美的投资有限公司、佛山市美的空调工业投资有限公司签订的《关于美垦半导体技术有限公司之股权转让协议》，公司受让美的集团股份有限公司、美的投资有限公司、佛山市美的空调工业投资有限公司原持有的美垦半导体技术有限公司 80%的股权，该股权转让事宜已于 2025 年 1 月 23 日完成工商变更登记。

2) 设立斯达半导体（香港）有限公司子公司 A

公司于 2025 年 1 月设立斯达半导体(香港)有限公司子公司 A,持股比例为 100%。截至 2025 年 6 月 30 日，公司尚未实缴出资。

3) 设立斯达半导体（香港）有限公司孙公司 A

公司于 2025 年 2 月设立斯达半导体(香港)有限公司孙公司 A,持股比例为 100%。截至 2025 年 6 月 30 日，公司尚未实缴出资。

4) 设立斯达半导体（重庆）有限公司

公司于 2025 年 6 月，公司设立子公司斯达半导体（重庆）有限公司，注册资本为 5,000.00 万元，持股比例为 100%。截至 2025 年 6 月 30 日，公司尚未实缴出资。

（2）2024 年

2024 年，公司合并范围新增一家主体，具体如下：

2024 年 11 月，公司设立子公司斯达半导体（香港）有限公司，斯达香港成立时注册资本为 100,000.00 美元，公司认缴出资 100,000.00 美元，占注册资本的 100.00%。截至 2024 年 12 月 31 日，公司尚未实际出资。

（3）2023 年

2023 年，公司合并范围新增两家主体，具体如下：

1）设立重庆安达半导体有限公司

2023 年 6 月，公司设立子公司重庆安达半导体有限公司，重庆安达成立时注册资本为人民币 15,000.00 万元，公司认缴出资 10,500.00 万元，占注册资本的 70.00%。截至 2024 年 12 月 31 日，重庆安达注册资本 15,000.00 万元，实缴出资 15,000.00 万元，公司认缴出资 10,500.00 万元，实际出资 10,500.00 万元，持股比例 70.00%。

2）设立斯达半导体（上海）有限公司

2023 年 11 月，公司设立子公司斯达半导体（上海）有限公司，斯达上海成立时注册资本为人民币 5,000.00 万元，公司认缴出资 5,000.00 万元，占注册资本的 100.00%。截至 2024 年 12 月 31 日，公司尚未实际出资。

（4）2022 年

2022 年，公司合并范围未发生变动。

四、最近三年及一期主要财务指标及非经常性损益明细表

（一）主要财务指标

指标	2025 年 1-6 月/ 2025 年 6 月 30 日	2024 年度/ 2024 年 12 月 31 日	2023 年度/ 2023 年 12 月 31 日	2022 年度/ 2022 年 12 月 31 日
流动比率（倍）	3.32	3.83	6.31	8.91
速动比率（倍）	2.05	2.55	4.49	7.70
资产负债率（母公司）	20.45%	16.37%	7.98%	10.11%
资产负债率（合并）	33.60%	30.09%	23.44%	19.45%
应收账款周转率（次/	2.11	4.23	5.95	6.14

指标	2025 年 1-6 月/ 2025 年 6 月 30 日	2024 年度/ 2024 年 12 月 31 日	2023 年度/ 2023 年 12 月 31 日	2022 年度/ 2022 年 12 月 31 日
年)				
存货周转率（次/年）	0.95	1.83	2.33	2.94
每股经营活动现金流 量（元/股）	1.52	4.02	2.24	3.91
每股净现金流量（元/ 股）	0.10	-3.19	-5.60	-0.60

注：上述指标中除母公司资产负债率外，其他均依据合并报表口径计算。除另有说明，上述各指标的具体计算方法如下：

- 1、流动比率=流动资产/流动负债
- 2、速动比率=速动资产/流动负债（速动资产=流动资产-存货）
- 3、资产负债率=总负债/总资产
- 4、应收账款周转率=营业收入/[(期初应收账款+期末应收账款)/2]
- 5、存货周转率=营业成本/[(期初存货+期末存货)/2]
- 6、每股经营活动产生的现金流量=全年经营活动产生的现金流量净额/期末总股本
- 7、每股净现金流量=全年现金及现金等价物净增加额/期末总股本
- 8、研发费用占营业收入的比例=研发费用/营业收入×100%
- 9、2025 年 1-6 月的应收账款周转率和存货周转率未进行年化处理

（二）净资产收益率和每股收益

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》的要求，公司最近三年及一期的净资产收益率和每股收益如下：

项目	期间	净资产收益率 (加权平均)	每股收益（元/股）	
			基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2025 年 1-6 月	4.05%	1.15	1.15
	2024 年	7.80%	2.12	2.12
	2023 年	15.07%	3.81	3.80
	2022 年	15.30%	3.42	3.42
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	2025 年 1-6 月	3.84%	1.09	1.09
	2024 年	7.49%	2.04	2.04
	2023 年	14.67%	3.71	3.70
	2022 年	14.26%	3.19	3.19

注：上述指标的计算公式如下：

①基本每股收益= $P0 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk)$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

②稀释每股收益= $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换公司}$

债券等增加的普通股加权平均数)

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

③加权平均净资产收益率= $P0 / (E0 + NP \div 2 + Ei \times Mi \div M0 - Ej \times Mj \div M0 \pm Ek \times Mk \div M0)$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E0 为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0 为报告期月份数；Mi 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；Ek 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；Mk 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

为保持报告期内的相关数据可比性，将 2022 年和 2023 年的每股收益按 2023 年年度权益分派实施后的股本数重新计算

（三）非经常性损益明细表

单位：万元

项目	2025 年 1-6 月	2024 年度	2023 年度	2022 年度
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-10.27	-13.68	2.59	1.20
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	1,201.65	1,331.31	2,600.36	2,915.61
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	453.74	763.10	1,554.10	2,732.41
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	24.49	-	-
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	-	-	2.47
债务重组损益	-	19.13	-	-
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响	-	-	-	858.03
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5.90	0.65	-1,291.33	-18.75
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	49.51	22.05	15.73
减：所得税影响额	186.79	105.47	448.23	966.75
少数股东权益影响额（税后）	26.09	38.97	9.41	11.35
合计	1,438.14	2,030.07	2,430.13	5,528.60

五、会计政策、会计估计及重大会计差错更正

（一）会计政策变更

报告期内，公司重要会计政策变更情况如下：

变更年度	会计政策变更的内容和原因	会计政策变更对公司的影响
2024 年度	财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号），“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”自 2024 年 1 月 1 日起施行	执行该规定未对公司财务状况和经营成果产生重大影响
	财政部于 2023 年 8 月 1 日发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11 号），该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行，企业应当采用未来适用法，该规定施行前已经费用化计入损益的数据资源相关支出不再调整	执行该规定未对公司财务状况和经营成果产生重大影响
	财政部于 2024 年 12 月 6 日发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号），公司自 2024 年度起执行“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”	执行该规定未对公司财务状况和经营成果产生重大影响
2023 年度	财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号），“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定自 2023 年 1 月 1 日起施行	执行该规定未对公司财务状况和经营成果产生重大影响
2022 年度	财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号），“关于试运行销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”自 2022 年 1 月 1 日起施行	执行该规定未对公司财务状况和经营成果产生重大影响
	财政部于 2022 年 5 月 19 日发布了财会〔2022〕13 号	公司对适用范围调整前符合条件的租赁合同已全部选择采用简化方法进行会计处理，对适用范围调整后符合条件的类似租赁合同也全部采用简化方法进行会计处理，并对通知发布前已采用租赁变更进行会计处理的相关租赁合同进行追溯调整，但不调整前期比较财务报表数据；对 2022 年 1 月 1 日至该通知施行日之间发生的未按照该通知规定进行会计处理的相关租金减让，根据该通知进行调整
	财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）：（1）“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”自公布之日起施行，相关应付股利发生在 2022 年 1 月 1 日至施行日之间的，按照该规定进行调整；发生在 2022 年 1 月 1 日之前且相关金融工具在 2022 年 1 月 1 日尚未终止确认的，应当进行追溯调整；（2）“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”自公布之日起施行，2022 年 1 月 1 日	执行该规定未对公司财务状况和经营成果产生重大影响

变更年度	会计政策变更的内容和原因	会计政策变更对公司的影响
	至施行日新增的有关交易，按照该规定进行调整；2022年1月1日之前发生的有关交易未按照该规定进行处理的，应当进行追溯调整，将累计影响数调整2022年1月1日留存收益及其他相关项目，不调整前期比较财务报表数据	

（二）会计估计变更

报告期内，公司无会计估计变更事项。

（三）会计差错更正

报告期内，公司无重大的会计差错更正事项。

六、财务状况分析

（一）资产结构分析

报告期内，公司资产构成情况如下表所示：

单位：万元

项目	2025年6月30日		2024年12月31日		2023年12月31日		2022年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动资产：								
货币资金	118,945.31	11.45%	118,988.91	12.34%	191,129.04	22.53%	286,811.40	40.24%
交易性金融资产	-	-	-	-	2,712.56	0.32%	70,272.88	9.86%
应收账款	92,625.37	8.91%	91,267.23	9.46%	69,086.99	8.14%	54,105.12	7.59%
应收款项融资	30,821.84	2.97%	40,802.80	4.23%	41,251.61	4.86%	22,569.29	3.17%
预付款项	2,934.89	0.28%	827.60	0.09%	3,687.93	0.43%	1,034.12	0.15%
其他应收款	192.11	0.02%	167.96	0.02%	553.73	0.07%	89.19	0.01%
存货	157,423.30	15.15%	128,012.95	13.27%	126,059.13	14.86%	70,172.90	9.85%
其他流动资产	8,265.53	0.80%	3,225.10	0.33%	2,131.23	0.25%	10,820.19	1.52%
流动资产合计	411,208.35	39.57%	383,292.53	39.74%	436,612.23	51.47%	515,875.07	72.38%
非流动资产：								
其他权益工具投资	57.20	0.01%	57.20	0.01%	-	-	-	-
固定资产	399,781.31	38.47%	250,147.60	25.93%	150,609.46	17.75%	66,775.79	9.37%

项目	2025 年 6 月 30 日		2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日		2022 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
在建工程	188,494.08	18.14%	305,948.97	31.72%	166,764.02	19.66%	95,774.21	13.44%
使用权资产	711.91	0.07%	436.14	0.05%	53.04	0.01%	31.33	0.00%
无形资产	12,808.70	1.23%	10,792.21	1.12%	10,470.53	1.23%	8,952.62	1.26%
商誉	5,159.70	0.50%	-	-	-	-	-	-
递延所得税资产	2,667.82	0.26%	2,639.88	0.27%	2,233.23	0.26%	361.39	0.05%
其他非流动资产	18,227.21	1.75%	11,253.12	1.17%	81,610.14	9.62%	25,005.35	3.51%
非流动资产合计	627,907.94	60.43%	581,275.11	60.26%	411,740.42	48.53%	196,900.69	27.62%
资产总计	1,039,116.29	100.00%	964,567.65	100.00%	848,352.65	100.00%	712,775.77	100.00%

报告期各期末，公司总资产分别为 712,775.77 万元、848,352.65 万元、964,567.65 万元及 1,039,116.29 万元，整体呈现上升趋势。

报告期各期末，公司流动资产分别为 515,875.07 万元、436,612.23 万元、383,292.53 万元及 411,208.35 万元，占资产总额的比例分别为 72.38%、51.47%、39.74%及 39.57%。公司流动资产以货币资金、交易性金融资产、应收账款和存货为主。

报告期各期末，公司非流动资产分别为 196,900.69 万元、411,740.42 万元、581,275.11 万元及 627,907.94 万元，占资产总额的比例分别为 27.62%、48.53%、60.26%及 60.43%。公司非流动资产以固定资产、在建工程、无形资产和其他非流动资产为主。

1、主要流动资产分析

(1) 货币资金

报告期各期末，公司货币资金构成情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 6 月 30 日		2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日		2022 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
现金	6.04	0.01%	3.48	0.00%	5.26	0.00%	3.21	0.00%
银行存款	118,871.92	99.94%	116,774.25	98.14%	191,083.54	99.98%	286,769.77	99.99%
其他货币资金	67.35	0.06%	2,211.17	1.86%	40.24	0.02%	38.41	0.01%
合计	118,945.31	100.00%	118,988.91	100.00%	191,129.04	100.00%	286,811.40	100.00%

报告期各期末，公司货币资金余额分别为 286,811.40 万元、191,129.04 万元、118,988.91 万元和 118,945.31 万元，占流动资产的比例分别为 55.60%、43.78%、31.04% 和 28.93%。报告期内，公司货币资金逐年减少，主要系公司结合业务发展购买原材料及投资固定资产所致。

2024 年末，公司其他货币资金余额较大，主要系信用证保证金。

（2）交易性金融资产

报告期各期末，公司交易性金融资产情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	2,712.56	70,272.88
合计	-	-	2,712.56	70,272.88

报告期各期末，公司交易性金融资产余额分别为 70,272.88 万元、2,712.56 万元、0 万元和 0 万元，均为公司购买的理财产品及结构性存款。

（3）应收账款

1) 应收账款变动分析

报告期各期末，公司应收账款情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
应收账款余额	97,717.39	96,269.01	73,415.82	57,224.94
坏账准备	5,092.02	5,001.78	4,328.83	3,119.82
应收账款账面价值	92,625.37	91,267.23	69,086.99	54,105.12

报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为 54,105.12 万元、69,086.99 万元、91,267.23 万元和 92,625.37 万元，占流动资产的比例分别为 10.49%、15.82%、23.81% 和 22.53%。

报告期内，随着公司经营规模的增长，应收账款账面余额相应增加。

2) 应收账款账龄分析

报告期各期末，公司应收账款的账龄情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 6 月 30 日		2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日		2022 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
1 年以内	97,272.86	99.55%	96,016.57	99.74%	72,585.55	98.87%	56,877.39	99.39%
1 至 2 年	235.78	0.24%	64.88	0.07%	526.55	0.72%	60.80	0.11%
2 至 3 年	22.36	0.02%	11.62	0.01%	46.34	0.06%	20.49	0.04%
3 年以上	186.40	0.19%	175.93	0.18%	257.38	0.35%	266.26	0.47%
合计	97,717.39	100.00%	96,269.01	100.00%	73,415.82	100.00%	57,224.94	100.00%

报告期各期末，公司应收账款账龄集中在 1 年以内，账龄超过 1 年的应收账款余额比重较低，应收账款总体质量良好。

3) 应收账款计提坏账准备分析

报告期各期末，公司应收账款坏账准备计提情况如下：

单位：万元

2025 年 6 月 30 日					
项目	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	29.48	0.03%	29.48	100.00%	-
按组合计提坏账准备的应收账款	97,687.91	99.97%	5,062.54	5.18%	92,625.37
合计	97,717.39	100.00%	5,092.02	-	92,625.37
2024 年 12 月 31 日					
项目	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	29.48	0.03%	29.48	100.00%	-
按组合计提坏账准备的应收账款	96,239.53	99.97%	4,972.30	5.17%	91,267.23
合计	96,269.01	100.00%	5,001.78	-	91,267.23
2023 年 12 月 31 日					
项目	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	523.78	0.71%	523.78	100.00%	-
按组合计提坏账准备的应收账款	72,892.04	99.29%	3,805.05	5.22%	69,086.99
合计	73,415.82	100.00%	4,328.83	-	69,086.99
2022 年 12 月 31 日					

项目	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	109.98	0.19%	109.98	100.00%	-
按组合计提坏账准备的应收账款	57,114.95	99.81%	3,009.84	5.27%	54,105.12
合计	57,224.94	100.00%	3,119.82	-	54,105.12

报告期内，公司所采用的坏账计提政策与其客户结构、业务模式、实际经营情况相符，能够合理覆盖应收账款的坏账风险，公司应收账款坏账准备计提充分。

（4）应收款项融资

报告期各期末，公司应收款项融资分别为 22,569.29 万元、41,251.61 万元、40,802.80 万元和 30,821.84 万元，占流动资产的比例分别为 4.37%、9.45%、10.65%和 7.50%，主要为公司销售产品收到的银行承兑汇票，整体回收风险较小。

（5）存货

1) 存货构成情况分析

报告期各期末，公司存货构成情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 6 月 30 日		2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日		2022 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
原材料	88,785.43	54.77%	74,968.33	57.00%	84,054.75	66.53%	52,766.86	74.90%
在产品	14,371.38	8.87%	12,315.73	9.36%	5,965.41	4.72%	5,261.68	7.47%
库存商品	45,145.98	27.85%	33,966.24	25.82%	29,148.77	23.07%	7,042.84	10.00%
周转材料	8,308.20	5.13%	5,670.69	4.31%	2,761.60	2.19%	1,673.80	2.38%
委托加工物资	4,883.59	3.01%	3,839.71	2.92%	3,920.43	3.10%	3,397.09	4.82%
发出商品	610.07	0.38%	767.90	0.58%	489.14	0.39%	305.13	0.43%
账面余额合计	162,104.66	100.00%	131,528.59	100.00%	126,340.11	100.00%	70,447.40	100.00%
存货跌价准备	4,681.36	2.89%	3,515.64	2.67%	280.97	0.22%	274.50	0.39%
账面价值	157,423.30	-	128,012.95	-	126,059.13	-	70,172.90	-

公司存货由原材料、在产品、库存商品、周转材料、委托加工物资和发出商品构成。其中，原材料、在产品、库存商品为存货的主要构成部分，报告期各期末合计余额占存货账面余额的比重分别为 92.37%、94.32%、92.19%和 91.49%。

①原材料

报告期各期末，公司原材料账面余额分别为 52,766.86 万元、84,054.75 万元、74,968.33 万元和 88,785.43 万元。2023 年，公司原材料增加较多，主要系公司为了满足营业收入增长及健康运转库存需求，策略性增加库存水平。

②在产品

报告期各期末，公司在产品账面余额分别为 5,261.68 万元、5,965.41 万元、12,315.73 万元和 14,371.38 万元。报告期内，公司在产品逐年增加，主要系业务规模增长所致。

③库存商品

报告期各期末，公司库存商品账面余额分别为 7,042.84 万元、29,148.77 万元、33,966.24 万元和 45,145.98 万元。2023 年，公司库存商品增加较多，主要系公司为了更好的满足客户需求，对 IGBT 模块进行了合理的备货。

2) 存货跌价准备分析

报告期各期末，公司存货跌价准备情况如下：

单位：万元

2025 年 6 月 30 日				
项目	账面余额	存货跌价准备	账面价值	账面价值占比
原材料	88,785.43	625.59	88,159.85	56.00%
在产品	14,371.38	-	14,371.38	9.13%
库存商品	45,145.98	4,055.77	41,090.21	26.10%
周转材料	8,308.20	-	8,308.20	5.28%
委托加工物资	4,883.59	-	4,883.59	3.10%
发出商品	610.07	-	610.07	0.39%
合计	162,104.66	4,681.36	157,423.30	100.00%
2024 年 12 月 31 日				
项目	账面余额	存货跌价准备	账面价值	账面价值占比
原材料	74,968.33	-	74,968.33	58.56%

在产品	12,315.73	-	12,315.73	9.62%
库存商品	33,966.24	3,515.64	30,450.60	23.79%
周转材料	5,670.69	-	5,670.69	4.43%
委托加工物资	3,839.71	-	3,839.71	3.00%
发出商品	767.9	-	767.9	0.60%
合计	131,528.59	3,515.64	128,012.95	100.00%
2023 年 12 月 31 日				
项目	账面余额	存货跌价准备	账面价值	账面价值占比
原材料	84,054.75	-	84,054.75	66.68%
在产品	5,965.41	-	5,965.41	4.73%
库存商品	29,148.77	280.97	28,867.79	22.90%
周转材料	2,761.60	-	2,761.60	2.19%
委托加工物资	3,920.43	-	3,920.43	3.11%
发出商品	489.14	-	489.14	0.39%
合计	126,340.11	280.97	126,059.13	100.00%
2022 年 12 月 31 日				
项目	账面余额	存货跌价准备	账面价值	账面价值占比
原材料	52,766.86	-	52,766.86	75.20%
在产品	5,261.68	-	5,261.68	7.50%
库存商品	7,042.84	274.50	6,768.35	9.65%
周转材料	1,673.80	-	1,673.80	2.39%
委托加工物资	3,397.09	-	3,397.09	4.84%
发出商品	305.13	-	305.13	0.43%
合计	70,447.40	274.5	70,172.90	100.00%

公司根据《企业会计准则》规定，对预计可变现净值低于账面价值的存货计提了存货跌价准备。报告期各期末，公司存货跌价准备分别为 274.50 万元、280.97 万元、3,515.64 万元和 4,681.36 万元。

（6）其他流动资产

报告期各期末，公司其他流动资产构成情况如下：

单位：万元

项目	2025年6月30日		2024年12月31日		2023年12月31日		2022年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
增值税待抵税额	5,148.10	62.28%	1,746.94	54.17%	1,600.98	75.12%	10,820.19	100.00%
预缴企业所得税	2,397.55	29.01%	1,478.16	45.83%	530.25	24.88%	-	-
应收退货成本	719.88	8.71%	-	-	-	-	-	-
合计	8,265.53	100.00%	3,225.10	100.00%	2,131.23	100.00%	10,820.19	100.00%

报告期各期末，公司其他流动资产金额分别为 10,820.19 万元、2,131.23 万元、3,225.10 万元和 8,265.53 万元，占流动资产的比例分别为 2.10%、0.49%、0.84%和 2.01%，主要为增值税待抵税额、预缴企业所得税等。

2、主要非流动资产分析

（1）固定资产

报告期各期末，公司固定资产构成情况如下：

单位：万元

项目	2025年6月30日		2024年12月31日		2023年12月31日		2022年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
房屋及建筑物	51,699.41	12.93%	50,239.61	20.08%	25,016.89	16.61%	9,546.15	14.30%
机器设备	288,218.77	72.09%	164,667.06	65.83%	100,513.37	66.74%	50,976.73	76.34%
运输工具	466.82	0.12%	361.05	0.14%	282.83	0.19%	301.36	0.45%
其他	59,396.32	14.86%	34,879.88	13.94%	24,796.39	16.46%	5,951.56	8.91%
合计	399,781.31	100.00%	250,147.60	100.00%	150,609.46	100.00%	66,775.79	100.00%

公司固定资产主要是机器设备和房屋及建筑物，报告期各期末合计账面价值占固定资产的比例分别为 90.64%、83.35%、85.91%和 85.03%。报告期内，公司固定资产逐年增加，主要系与公司经营规模扩大需求相匹配的生产、研发设备增加以及公司前次募投项目建设所致。

报告期各期末，公司固定资产原值、累计折旧、减值准备、账面价值情况如下：

单位：万元

项目	2025年6月30日	2024年12月31日	2023年12月31日	2022年12月31日
账面原值合计	474,452.57	306,807.13	186,519.17	92,470.07
房屋及建筑物	60,935.74	58,078.12	30,785.24	14,243.01

项目	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
机器设备	339,954.16	203,413.78	124,721.74	68,122.96
运输工具	1,021.38	836.01	747.23	694.86
其他	72,541.29	44,479.22	30,264.96	9,409.24
累计折旧合计	74,671.25	56,659.54	35,909.71	25,694.28
房屋及建筑物	9,236.33	7,838.51	5,768.35	4,696.86
机器设备	51,735.39	38,746.72	24,208.37	17,146.24
运输工具	554.56	474.97	464.40	393.50
其他	13,144.97	9,599.34	5,468.58	3,457.69
减值准备合计	-	-	-	-
房屋及建筑物	-	-	-	-
机器设备	-	-	-	-
运输工具	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
账面价值合计	399,781.31	250,147.60	150,609.46	66,775.79
房屋及建筑物	51,699.41	50,239.61	25,016.89	9,546.15
机器设备	288,218.77	164,667.06	100,513.37	50,976.73
运输工具	466.82	361.05	282.83	301.36
其他	59,396.32	34,879.88	24,796.39	5,951.56

报告期内，公司固定资产构成为房屋及建筑物、机器设备、运输工具和其他（其他主要为公司生产经营所需的厂务设施和固定资产装修等）。报告期内，公司固定资产状况良好，不存在已毁损以致不再有使用价值和转让价值，或者由于技术进步等原因已不可使用或其他实质上已经不能再给公司带来经济效益等情况的固定资产，故未计提固定资产减值准备。

（2）在建工程

报告期各期末，公司在建工程构成情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 6 月 30 日		2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日		2022 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
待安装设备	162,818.61	86.38%	282,657.38	92.39%	121,736.57	73.00%	48,171.31	50.30%
厂房建设及装修工程	25,675.47	13.62%	23,291.59	7.61%	45,027.45	27.00%	47,602.90	49.70%

项目	2025 年 6 月 30 日		2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日		2022 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
合计	188,494.08	100.00%	305,948.97	100.00%	166,764.02	100.00%	95,774.21	100.00%

报告期各期末，公司在建工程分别为 95,774.21 万元、166,764.02 万元、305,948.97 万元和 188,494.08 万元。报告期内，公司在建工程逐年增加，主要系公司前次募投项目建设及公司根据生产经营需要持续进行厂房建设和装修所致。

（3）无形资产

报告期各期末，公司各类无形资产账面价值构成及变动情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 6 月 30 日		2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日		2022 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
土地使用权	9,312.56	72.70%	9,420.78	87.29%	9,615.33	91.83%	7,664.32	85.61%
其他	3,496.14	27.30%	1,371.43	12.71%	855.20	8.17%	1,288.29	14.39%
合计	12,808.70	100.00%	10,792.21	100.00%	10,470.53	100.00%	8,952.62	100.00%

报告期各期末，公司无形资产账面价值分别为 8,952.62 万元、10,470.53 万元、10,792.21 万元和 12,808.70 万元，占非流动资产的比例分别为 4.55%、2.54%、1.86%和 2.04%。报告期内，公司无形资产主要为土地使用权，报告期各期末占无形资产账面价值的比例分别为 85.61%、91.83%、87.29%和 72.70%。

报告期内，公司无形资产不存在减值迹象，未计提减值准备。

（4）商誉

报告期各期末，公司商誉账面价值分别为 0.00 万元、0.00 万元、0.00 万元和 5,159.70 万元，占非流动资产的比例分别为 0.00%、0.00%、0.00%和 0.82%。公司商誉系收购美垦半导体技术有限公司形成，不存在减值迹象，未计提减值准备。

（5）其他非流动资产

报告期各期末，公司其他非流动资产余额分别为 25,005.35 万元、81,610.14 万元、11,253.12 万元和 18,227.21 万元，占非流动资产的比例分别为 12.70%、19.82%、1.94%和 2.90%，主要为预付长期资产款。2022 年末和 2023 年末，公司其他非流动资产余额较高，主要为预付前次募投项目等建设工程所需设备款。

（二）负债结构分析

报告期各期末，公司负债构成情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 6 月 30 日		2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日		2022 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动负债：								
短期借款	1,115.17	0.32%	1,115.17	0.38%	-	-	-	-
应付账款	101,787.43	29.15%	79,792.71	27.50%	56,756.18	28.54%	47,905.56	34.55%
合同负债	4,375.75	1.25%	6,194.72	2.13%	1,692.00	0.85%	2,775.73	2.00%
应付职工薪酬	3,855.75	1.10%	5,711.93	1.97%	5,391.97	2.71%	3,833.16	2.76%
应交税费	3,165.14	0.91%	4,258.56	1.47%	2,551.81	1.28%	1,562.33	1.13%
其他应付款	8,620.57	2.47%	1,516.54	0.52%	2,109.06	1.06%	1,234.65	0.89%
一年内到期的非流动负债	926.70	0.27%	764.97	0.26%	498.34	0.25%	367.90	0.27%
其他流动负债	152.88	0.04%	742.48	0.26%	141.01	0.07%	225.69	0.16%
流动负债合计	123,999.38	35.51%	100,097.08	34.49%	69,140.38	34.77%	57,905.03	41.76%
非流动负债：								
长期借款	183,804.83	52.63%	160,669.41	55.37%	104,211.67	52.40%	66,367.39	47.86%
租赁负债	555.50	0.16%	340.98	0.12%	15.24	0.01%	1.45	0.00%
预计负债	1,120.36	0.32%						
递延收益	33,649.24	9.64%	23,049.48	7.94%	22,033.56	11.08%	14,327.79	10.33%
递延所得税负债	6,039.09	1.73%	6,042.87	2.08%	3,474.56	1.75%	60.42	0.04%

项目	2025 年 6 月 30 日		2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日		2022 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
债								
非流动负债合计	225,169.02	64.49%	190,102.74	65.51%	129,735.03	65.23%	80,757.05	58.24%
负债合计	349,168.40	100.00%	290,199.82	100.00%	198,875.41	100.00%	138,662.08	100.00%

报告期各期末，公司负债总额分别为 138,662.08 万元、198,875.41 万元、290,199.82 万元及 349,168.40 万元。公司负债以非流动负债为主，主要为长期借款和递延收益等，非流动负债占负债总额的比例分别为 58.24%、65.23%、65.51%及 64.49%。报告期各期，公司流动负债占负债总额的比例分别为 41.76%、34.77%、34.49%及 35.51%，主要为应付账款、应付职工薪酬、其他应付款等。

1、主要流动负债分析

（1）应付账款

报告期各期末，公司应付账款构成情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 6 月 30 日		2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日		2022 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
1 年以内	100,014.11	98.26%	76,844.86	96.31%	55,721.50	98.18%	47,402.29	98.95%
1 年以上	1,773.32	1.74%	2,947.85	3.69%	1,034.69	1.82%	503.27	1.05%
合计	101,787.43	100.00%	79,792.71	100.00%	56,756.18	100.00%	47,905.56	100.00%

报告期各期末，公司应付账款余额分别为 47,905.56 万元、56,756.18 万元、79,792.71 万元和 101,787.43 万元，占流动负债的比例分别为 82.73%、82.09%、79.72%和 82.09%。

随着报告期内公司业务规模扩大及前次募投项目建设，公司应付账款相应有所增加。

（2）合同负债

报告期各期末，公司合同负债分别为 2,775.73 万元、1,692.00 万元、6,194.72 万元和 4,375.75 万元，占流动负债的比例分别为 4.79%、2.45%、6.19%和 3.53%，均为预收客户支付的货款，随当期销售情况和客户结构存在一定波动。

（3）应付职工薪酬

报告期各期末，公司应付职工薪酬构成情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 6 月 30 日		2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日		2022 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
短期薪酬	3,608.27	93.58%	5,511.65	96.49%	5,142.61	95.38%	3,737.43	97.50%
离职后福利-设定提存计划	247.48	6.42%	200.28	3.51%	249.37	4.62%	95.73	2.50%
合计	3,855.75	100.00%	5,711.93	100.00%	5,391.97	100.00%	3,833.16	100.00%

报告期各期末，公司应付职工薪酬分别为 3,833.16 万元、5,391.97 万元、5,711.93 万元和 3,855.75 万元，占流动负债的比例分别为 6.62%、7.80%、5.71%和 3.11%，主要为短期薪酬。报告期内，公司应付职工薪酬余额逐年增加，主要系公司业务规模扩大所致。

（4）应交税费

报告期各期末，公司应交税费构成情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 6 月 30 日		2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日		2022 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
增值税	441.74	13.96%	383.14	9.00%	2.46	0.10%	148.96	9.53%
企业所得税	1,916.36	60.55%	2,978.56	69.94%	1,917.12	75.13%	1,045.60	66.93%
个人所得税	184.22	5.82%	120.39	2.83%	80.75	3.16%	81.26	5.20%
城市维护建设税	28.13	0.89%	22.76	0.53%	13.69	0.54%	23.73	1.52%
房产税	240.50	7.60%	353.13	8.29%	120.90	4.74%	33.90	2.17%
教育费附加	28.13	0.89%	22.76	0.53%	13.69	0.54%	23.73	1.52%
土地使用税	107.27	3.39%	211.90	4.98%	214.28	8.40%	153.50	9.83%
其他税费	218.79	6.91%	165.92	3.90%	188.91	7.40%	51.66	3.31%
合计	3,165.14	100.00%	4,258.56	100.00%	2,551.81	100.00%	1,562.33	100.00%

报告期各期末，公司应交税费余额分别为 1,562.33 万元、2,551.81 万元、4,258.56 万元和 3,165.14 万元，占流动负债的比重分别为 2.70%、3.69%、4.25%和 2.55%，主要为应交增值税、企业所得税、房产税和土地使用税等。

（5）其他应付款

报告期各期末，公司其他应付款分别为 1,234.65 万元、2,109.06 万元、1,516.54 万元和 8,620.57 万元，占流动负债的比重分别为 2.13%、3.05%、1.52%和 6.95%。2025 年 6 月末，公司其他应付款余额较高，主要系包含 6,738.36 万元应付股利款。

2、主要非流动负债分析

（1）长期借款

报告期各期末，公司长期借款余额分别 66,367.39 万元、104,211.67 万元、160,669.41 万元和 183,804.83 万元，占非流动负债的比例分别为 82.18%、80.33%、84.52%和 81.63%，均为保证借款。

（2）递延收益

报告期各期末，公司递延收益余额分别为 14,327.79 万元、22,033.56 万元、23,049.48 万元和 33,649.24 万元，占非流动负债的比例分别为 17.74%、16.98%、12.12%和 14.94%，均为尚未满足项目结转条件的政府补助。

（3）递延所得税负债

报告期各期末，公司递延所得税负债余额分别为 60.42 万元、3,474.56 万元、6,042.87 万元和 6,039.09 万元，占非流动负债的比例分别为 0.07%、2.68%、3.18%和 2.68%。2023 年末、2024 年末、2025 年 6 月末，公司递延所得税余额较高，主要系公司固定资产全额抵扣影响使得应纳税暂时性差异增加所致。

（三）偿债能力分析

报告期内，公司的主要偿债指标如下表所示：

财务指标	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动比率（倍）	3.32	3.83	6.31	8.91
速动比率（倍）	2.05	2.55	4.49	7.70
资产负债率	33.60%	30.09%	23.44%	19.45%

注：上述指标均依据合并报表口径计算，各指标的具体计算方法如下：

- 1、流动比率=流动资产/流动负债
- 2、速动比率=速动资产/流动负债（速动资产=流动资产-存货）
- 3、资产负债率=总负债/总资产

报告期各期末，公司流动比率分别为 8.91、6.31、3.83 及 3.32，速动比率分别为 7.70、

4.49、2.55 及 2.05。由于公司 2021 年度非公开发行股票募集资金到账，货币资金和流动资产出现较大规模增长，公司短期偿债能力大幅提高，因此 2022 年流动比率及速动比率较高。报告期内，随着公司前次募投项目建设的推进，公司流动比率和速动比率逐渐回落到非公开发行前水平，但整体依然维持在较高水平，具有较强的偿债能力。

报告期各期末，公司合并口径的资产负债率分别为 19.45%、23.44%、30.09%及 33.60%，公司资产负债率整体处于较低水平，偿债能力较强。由于公司 2021 年度非公开发行股票募集资金到账，货币资金出现较大规模增长，公司流动资金相对充足，因此 2022 年末资产负债率较低。

报告期内，除对控股子公司担保外，公司不存在对外担保事项，未发生逾期偿还贷款的现象。公司与商业银行等金融机构建立了良好的银企合作关系，具备有效的防范债务风险能力。

（四）资产周转能力分析

报告期内，公司的主要资产运营能力指标如下表所示：

财务指标	2025 年 1-6 月	2024 年度	2023 年度	2022 年度
应收账款周转率（次/年）	2.11	4.23	5.95	6.14
存货周转率（次/年）	0.95	1.83	2.33	2.94

注：上述指标均依据合并报表口径计算，各指标的具体计算方法如下：

- 1、应收账款周转率=营业收入/[（期初应收账款账面价值+期末应收账款账面价值）/2]
- 2、存货周转率=营业成本/[（期初存货净额+期末存货净额）/2]
- 3、2025 年 1-6 月的应收账款周转率和存货周转率未进行年化处理

报告期各期，公司应收账款周转率分别为 6.14 次/年、5.95 次/年、4.23 次/年及 2.11 次/半年，虽然逐年下降但公司应收账款整体周转较好。

报告期各期，公司与同行业可比公司的应收账款周转率如下：

公司简称	2025 年 1-6 月	2024 年	2023 年	2022 年
士兰微	2.12	4.34	4.28	4.38
扬杰科技	1.78	3.56	3.97	4.85
宏微科技	1.44	2.87	4.00	3.81
华微电子	1.81	3.71	3.61	4.35
平均值	1.79	3.62	3.97	4.35
公司	2.11	4.23	5.95	6.14

注：2025 年 1-6 月应收账款周转率未进行年化处理

报告期各期，公司应收账款周转率分别为 6.14 次/年、5.95 次/年、4.23 次/年和 2.11 次/半年，应收账款周转率整体呈下降趋势，与行业变化趋势一致，但仍然优于行业平均水平。

报告期各期，公司存货周转率分别为 2.94 次/年、2.33 次/年、1.83 次/年及 0.95 次/半年，逐年下降，主要系公司为了满足营业收入增长及公司健康运转库存需求，策略性增加库存水平。

报告期各期，公司与同行业可比公司的存货周转率如下：

公司简称	2025 年 1-6 月	2024 年	2023 年	2022 年
士兰微	1.31	2.38	2.14	2.34
扬杰科技	1.82	3.40	3.20	3.12
宏微科技	1.45	2.60	3.39	3.94
华微电子	2.26	4.52	4.38	6.28
平均值	1.71	3.23	3.27	3.92
公司	0.95	1.83	2.33	2.94

注：2025 年 1-6 月应收账款周转和存货周转率未进行年化处理

报告期各期，公司存货周转率分别为 2.94 次/年、2.33 次/年、1.83 次/年和 0.95 次/半年，存货周转速度整体呈下降趋势，与行业变动趋势一致。公司与各家可比公司在产品类型、生产管理模式等方面均有所不同，为了更好地满足客户及时供货的需求，公司库存商品中通常会维持一定数量的库存作为储备，因此存货周转率较低。

（五）财务性投资情况

1、财务性投资的认定依据

根据《上市公司证券发行注册管理办法》第九条，“除金融类企业外，最近一期末不存在金额较大的财务性投资。”

根据中国证监会《证券期货法律适用意见第 18 号》第一条等相关规定，“财务性投资包括不限于：投资类金融业务；非金融企业投资金融业务（不包括投资前后持股比例未增加的对集团财务公司的投资）；与公司主营业务无关的股权投资或产业基金、并购基金；拆借资金；委托贷款；购买收益波动大且风险较高的金融产品等。围绕产业链上下游以获取技术、原料或渠道为目的的产业投资，以收购或整合为目的的并购投资，以拓展客户、渠道为目的的委托贷款，如符合公司主营业务及战略发展方向，不界定为

财务性投资。金额较大指的是，公司已持有和拟持有的财务性投资金额超过公司合并报表归属于母公司净资产的 30%（不包括对合并报表范围内的类金融业务的投资金额）。本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资金额应从本次募集资金总额中扣除。”

根据中国证监会《监管规则适用指引-发行类第 7 号》的规定，“除人民银行、银保监会、证监会批准从事金融业务的持牌机构为金融机构外，其他从事金融活动的机构均为类金融机构。类金融业务包括但不限于：融资租赁、融资担保、商业保理、典当及小额贷款等业务。与公司主营业务发展密切相关，符合业态所需、行业发展惯例及产业政策的融资租赁、商业保理及供应链金融，暂不纳入类金融业务计算口径。”

2、最近一期末是否存在持有金额较大、期限较长的交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人款项、委托理财等财务性投资的情形

截至 2025 年 6 月末，公司可能涉及财务性投资（包括类金融业务）的相关报表项目情况如下：

单位：万元

序号	项目	2025年6月末账面价值	财务性投资金额
1	其他应收款	192.11	-
2	其他流动资产	8,265.53	-
3	其他权益工具投资	57.20	-
4	其他非流动资产	18,227.21	-
合计			-

截至 2025 年 6 月末，公司相关科目均不涉及财务性投资，具体情况如下：

（1）其他应收款

截至 2025 年 6 月末，公司其他应收款账面价值为 192.11 万元，主要为押金、保证金及员工备用金等，不属于财务性投资。

（2）其他流动资产

截至 2025 年 6 月末，公司其他流动资产账面价值为 8,265.53 万元，其中增值税待抵税额及预缴企业所得税合计 7,545.65 万元，其余为应收退货成本，不属于财务性投资。

（3）其他权益工具投资

截至 2025 年 6 月末，公司其他权益工具投资账面价值为 57.20 万元，系公司原客户宁波央腾汽车电子有限公司处于破产重整阶段，公司以债权增资获取了部分股权，该等投资与公司主营业务相关，不属于财务性投资。

（4）其他非流动资产

截至 2025 年 6 月末，公司其他非流动资产账面价值为 18,227.21 万元，主要为预付公司生产经营相关的长期资产款，不属于财务性投资。

综上所述，公司最近一期末不存在持有金额较大的财务性投资（包括类金融业务）的情形。

七、经营成果分析

（一）营业收入结构及趋势分析

1、营业收入构成

报告期内，公司营业收入构成及变动情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 1-6 月		2024 年度		2023 年度		2022 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
主营业务收入	193,439.75	99.94%	338,130.05	99.73%	363,843.49	99.33%	268,210.40	99.14%
其他业务收入	121.29	0.06%	932.01	0.27%	2,453.05	0.67%	2,339.44	0.86%
合计	193,561.04	100.00%	339,062.07	100.00%	366,296.54	100.00%	270,549.84	100.00%

报告期各期，公司主营业务收入分别为 268,210.40 万元、363,843.49 万元、338,130.05 万元和 193,439.75 万元，占营业收入的比例分别为 99.14%、99.33%、99.73%和 99.94%，公司主营业务突出。

2、主营业务收入产品构成及分析

报告期内，公司主营业务收入按产品构成情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 1-6 月		2024 年度		2023 年度		2022 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
IGBT 模块	161,082.76	83.27%	311,372.09	92.09%	333,110.77	91.55%	222,469.24	82.95%
其他产品	32,356.99	16.73%	26,757.96	7.91%	30,732.72	8.45%	45,741.17	17.05%
合计	193,439.75	100.00%	338,130.05	100.00%	363,843.49	100.00%	268,210.40	100.00%

报告期内，公司主营业务收入主要源于 IGBT 模块。报告期各期，公司 IGBT 模块主营业务收入占主营业务收入的比例分别为 82.95%、91.55%、92.09%和 83.27%。

3、主营业务收入区域构成及分析

报告期内，公司主营业务收入按销售区域构成情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 1-6 月		2024 年度		2023 年度		2022 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
境内	176,182.89	91.08%	311,801.42	92.21%	332,894.77	91.49%	256,278.77	95.55%
境外	17,256.86	8.92%	26,328.64	7.79%	30,948.72	8.51%	11,931.63	4.45%
合计	193,439.75	100.00%	338,130.05	100.00%	363,843.49	100.00%	268,210.40	100.00%

报告期内，公司主营业务收入主要源于境内销售。报告期各期，公司境内主营业务收入占主营业务收入的比例分别为 95.55%、91.49%、92.21%和 91.08%。

4、主营业务收入按销售模式分类

报告期内，公司主营业务收入按销售模式分类情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 1-6 月		2024 年度		2023 年度		2022 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
直销	163,058.95	84.29%	291,527.80	86.22%	307,247.21	84.44%	223,086.89	83.18%
经销	30,380.80	15.71%	46,602.25	13.78%	56,596.27	15.56%	45,123.51	16.82%
合计	193,439.75	100.00%	338,130.05	100.00%	363,843.49	100.00%	268,210.40	100.00%

报告期各期，公司直销收入占主营业务收入的比例分别为 83.18%、84.44%、86.22%和 84.29%。公司选择了以直销为主、经销为辅的销售模式，可迅速了解客户需求，同时通过经销迅速拓张市场份额，提高市场声誉。此外，公司可以根据客户性质，灵活地选择直销和经销的维护方式，更好地服务客户。

5、主营业务收入季节性分析

报告期内，公司主营业务收入按季度分类情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 1-6 月		2024 年度		2023 年度		2022 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
第 一 季度	91,903.09	47.51%	80,420.97	23.78%	77,996.96	21.44%	54,244.43	20.22%
第 二 季度	101,536.67	52.49%	72,764.39	21.52%	90,756.97	24.94%	61,068.83	22.77%
第 三 季度	-	-	87,420.64	25.85%	92,974.07	25.55%	71,967.01	26.83%
第 四 季度	-	-	97,524.06	28.84%	102,115.50	28.07%	80,930.13	30.17%
合计	193,439.75	100.00%	338,130.05	100.00%	363,843.49	100.00%	268,210.40	100.00%

报告期内，除春节为销售淡季外，公司的产品销售不存在明显的季节性。IGBT 模块在下游有着广泛的用途，涉及新能源、新能源汽车、工业控制与电源、白色家电、AI 服务器电源、数据中心、机器人及低空/高空飞行器等多种行业，除春节为一般共同的销售淡季之外，各类不同的下游应用行业各自的季节性特征在公司处叠加，因此公司除春节外不存在明显的季节性特征。

（二）营业成本构成及趋势分析

1、营业成本构成

报告期内，公司营业成本构成及变动情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 1-6 月		2024 年度		2023 年度		2022 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
主 营 业 务 成本	135,997.42	100.00%	232,070.01	100.00%	227,285.91	99.29%	160,017.94	99.08%
其 他 业 务 成本	0.63	0.00%	1.72	0.00%	1,621.15	0.71%	1,491.78	0.92%
合计	135,998.05	100.00%	232,071.73	100.00%	228,907.06	100.00%	161,509.72	100.00%

报告期各期，发行人主营业务成本分别为 160,017.94 万元、227,285.91 万元、232,070.01 万元以及 135,997.42 万元，占营业成本的比例分别为 99.08%、99.29%、约 100.00%以及约 100.00%，占比较高，与当期主营业务收入占营业收入的比例匹配。

2、主营业务成本构成分析

报告期内，发行人主营业务成本按产品分类情况如下：

单位：万元；%

项目	2025 年 1-6 月		2024 年度		2023 年度		2022 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
IGBT 模块	111,050.76	81.66%	212,627.80	91.62%	207,451.81	91.27%	134,252.32	83.90%
其他产品	24,946.66	18.34%	19,442.21	8.38%	19,834.09	8.73%	25,765.61	16.10%
合计	135,997.42	100.00%	232,070.01	100.00%	227,285.91	100.00%	160,017.94	100.00%

报告期内，公司主营业务成本主要来自于 IGBT 模块。报告期各期，公司 IGBT 模块成本分别为 134,252.32 万元、207,451.81 万元、212,627.80 万元、111,050.76 万元，占主营业务成本的比例分别为 83.90%、91.27%、91.62%、81.66%。报告期内，公司的主营业务成本与主营业务收入构成一致，与主营业务收入的变动趋势匹配。

（三）毛利及毛利率分析

1、毛利构成及变动分析

报告期内，公司毛利整体情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 1-6 月		2024 年度		2023 年度		2022 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
主营业务毛利	57,442.33	99.79%	106,060.04	99.13%	136,557.58	99.39%	108,192.46	99.22%
其他业务毛利	120.66	0.21%	930.29	0.87%	831.90	0.61%	847.66	0.78%
合计	57,562.99	100.00%	106,990.33	100.00%	137,389.48	100.00%	109,040.13	100.00%

报告期各期，公司主营业务毛利分别为 108,192.46 万元、136,557.58 万元、106,060.04 万元和 57,442.33 万元，占公司营业毛利的比例分别为 99.22%、99.39%、99.13%和 99.79%，占毛利总额的比重均在 99%以上，是公司的主要利润来源。其他业务毛利相对较低，对公司经营业绩不构成重大影响。

2、主营业务毛利产品构成分析

报告期内，发行人主营业务毛利按产品分类情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 1-6 月		2024 年度		2023 年度		2022 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
IGBT 模块	50,032.00	87.10%	98,744.29	93.10%	125,658.96	92.02%	88,216.91	81.54%
其他产品	7,410.33	12.90%	7,315.75	6.90%	10,898.62	7.98%	19,975.55	18.46%
合计	57,442.33	100.00%	106,060.04	100.00%	136,557.58	100.00%	108,192.46	100.00%

报告期内，公司毛利主要源于 IGBT 模块。报告期各期，公司 IGBT 模块毛利分别为 88,216.91 万元、125,658.96 万元、98,744.29 万元和 50,032.00 万元，占公司主营业务毛利的比例分别为 81.54%、92.02%、93.10%和 87.10%。

3、主营业务毛利率情况分析

报告期内，公司主营业务毛利率及毛利占比情况如下：

项目	2025 年 1-6 月		2024 年度		2023 年度		2022 年度	
	毛利率	毛利占比	毛利率	毛利占比	毛利率	毛利占比	毛利率	毛利占比
IGBT 模块	31.06%	87.10%	31.71%	93.10%	37.72%	92.02%	39.65%	81.54%
其他产品	22.90%	12.90%	27.34%	6.90%	35.46%	7.98%	43.67%	18.46%
合计	29.70%	100.00%	31.37%	100.00%	37.53%	100.00%	40.34%	100.00%

报告期各期，公司主营业务毛利率分别为 40.34%、37.53%、31.37%和 29.70%，IGBT 模块毛利率分别为 39.65%、37.72%、31.71%和 31.06%，其他产品毛利率分别为 43.67%、35.46%、27.34%和 22.90%。

报告期内，公司下游行业中，工业控制领域受宏观经济影响需求疲软，新能源汽车在市场渗透率提升以及性能升级的双重驱动下持续保持快速增长，光伏行业部分产品出现阶段性库存调整导致短期需求收缩。因此，受下游行业影响，公司所在行业竞争加剧。公司积极应对市场变化，综合考虑市场供需情况和公司成本控制等因素，下调了部分产品价格，从而导致毛利率有所下降。

（四）期间费用分析

报告期内，公司期间费用构成及占营业收入比例情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 1-6 月		2024 年度		2023 年度		2022 年度	
	金额	占营业收入比例	金额	占营业收入比例	金额	占营业收入比例	金额	占营业收入比例
销售费用	1,558.05	0.80%	3,450.39	1.02%	3,791.29	1.04%	3,086.09	1.14%
管理费用	6,249.21	3.23%	9,966.16	2.94%	8,073.82	2.20%	7,137.99	2.64%
研发费用	22,967.91	11.87%	35,429.93	10.45%	28,741.58	7.85%	18,888.09	6.98%
财务费用	-2,414.92	-1.25%	-610.34	-0.18%	-6,961.72	-1.90%	-10,184.49	-3.76%
合计	28,360.25	14.65%	48,236.15	14.23%	33,644.98	9.19%	18,927.67	7.00%

报告期各期，公司期间费用合计分别为 18,927.67 万元、33,644.98 万元、48,236.15 万元和 28,360.25 万元，占营业收入的比例分别为 7.00%、9.19%、14.23%和 14.65%。报告期内，公司期间费用结构稳定，主要为研发费用。报告期内，公司期间费用率逐年上升，主要系公司根据市场和产品的判断不断加大研发投入。

1、销售费用

报告期内，公司销售费用构成情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 1-6 月		2024 年度		2023 年度		2022 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
职工薪酬	1,178.99	75.67%	2,580.79	74.80%	2,959.43	78.06%	2,807.08	90.96%
差旅费	54.57	3.50%	228.94	6.64%	178.54	4.71%	90.40	2.93%
租赁费	25.84	1.66%	37.47	1.09%	35.76	0.94%	33.93	1.10%
其他费用	298.65	19.17%	603.20	17.48%	617.56	16.29%	154.67	5.01%
合计	1,558.05	100.00%	3,450.39	100.00%	3,791.29	100.00%	3,086.09	100.00%

报告期各期，公司销售费用分别为 3,086.09 万元、3,791.29 万元、3,450.39 万元和 1,558.05 万元，占各期营业收入的比例分别为 1.14%、1.04%、1.02%和 0.80%，占比较低且各期稳定在 1%左右。报告期内，公司销售费用主要为职工薪酬，报告期各期占销售费用的比例分别为 90.96%、78.06%、74.80%和 75.67%。

报告期各期，公司与可比公司销售费用率情况如下：

单位：%

公司名称	2025 年 1-6 月	2024 年	2023 年	2022 年
士兰微	1.36	1.59	1.79	1.73

公司名称	2025 年 1-6 月	2024 年	2023 年	2022 年
扬杰科技	4.14	3.72	3.85	3.16
宏微科技	1.89	2.04	1.49	2.43
华微电子	2.12	2.33	2.29	1.91
平均值	2.38	2.14	2.09	2.08
公司	0.80	1.02	1.04	1.14

公司自上市以来销售费用率低于可比公司，主要系公司客户结构相对稳定，核心客户与公司建立了长期稳定的业务合作关系，随着销售规模的扩大，销售费用率逐渐下降。

2、管理费用

报告期内，公司管理费用构成情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 1-6 月		2024 年度		2023 年度		2022 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
职工薪酬	2,624.27	41.99%	3,801.27	38.14%	3,186.61	39.47%	2,515.17	35.24%
折旧摊销费	1,442.82	23.09%	1,895.62	19.02%	1,091.96	13.52%	962.4	13.48%
股份支付	-	-	80.68	0.81%	816.66	10.11%	1,634.66	22.90%
咨询服务费	347.57	5.56%	829.88	8.33%	731.36	9.06%	422.36	5.92%
办公费	194.31	3.11%	619.14	6.21%	416.32	5.16%	264.49	3.71%
差旅费	108.97	1.74%	243.65	2.44%	307.9	3.81%	123.56	1.73%
其他费用	1,531.27	24.50%	2,495.93	25.04%	1,523.02	18.86%	1,215.34	17.03%
合计	6,249.21	100.00%	9,966.16	100.00%	8,073.82	100.00%	7,137.99	100.00%

报告期各期，公司管理费用分别为 7,137.99 万元、8,073.82 万元、9,966.16 万元和 6,249.21 万元，占各期营业收入的比例分别为 2.64%、2.20%、2.94%和 3.23%，主要由职工薪酬、折旧摊销费、咨询服务费和办公费等构成。报告期内，公司管理费用呈逐年上升趋势，主要系报告期内公司规模扩大、人员增加，相应的管理运营成本增加。

报告期各期，公司与可比公司管理费用率情况如下：

单位：%

公司名称	2025 年 1-6 月	2024 年	2023 年	2022 年
士兰微	3.64	4.11	4.05	4.55
扬杰科技	4.85	5.95	6.16	5.02
宏微科技	4.54	4.39	4.11	3.40

公司名称	2025 年 1-6 月	2024 年	2023 年	2022 年
华微科技	5.25	6.22	7.49	6.13
平均值	4.57	4.72	4.80	4.35
斯达半导	3.23	2.94	2.20	2.64

公司运营管理效率维持在较高水平，管理费用率较低，自上市以来一直低于可比公司。

3、研发费用

报告期内，公司研发费用构成情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 1-6 月		2024 年度		2023 年度		2022 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
物料消耗	8,550.40	37.23%	12,786.89	36.09%	14,711.94	51.19%	9,627.93	50.97%
职工薪酬	9,560.04	41.62%	14,192.84	40.06%	9,204.07	32.02%	5,981.52	31.67%
折旧摊销费	2,654.36	11.56%	4,287.15	12.10%	2,518.10	8.76%	1,797.72	9.52%
其他费用	2,203.11	9.59%	4,163.06	11.75%	2,307.48	8.03%	1,480.92	7.84%
合计	22,967.91	100.00%	35,429.93	100.00%	28,741.58	100.00%	18,888.09	100.00%

报告期各期，公司研发费用分别为 18,888.09 万元、28,741.58 万元、35,429.93 万元和 22,967.91 万元，占各期营业收入的比例分别为 6.98%、7.85%、10.45%和 11.87%。

报告期各期，公司与可比公司研发费用率情况如下：

单位：%

公司名称	2025 年 1-6 月	2024 年	2023 年	2022 年
士兰微	7.55	9.22	9.25	8.59
扬杰科技	6.38	7.02	6.58	5.42
宏微科技	8.61	8.24	7.18	6.94
华微科技	6.07	6.07	6.09	5.39
平均值	7.15	7.64	7.28	6.58
斯达半导	11.87	10.45	7.85	6.98

公司自成立以来一直以技术发展和产品质量为公司之根本，并以开发新产品、新技术为公司的主要工作，持续大幅度地增加研发投入，培养、组建了一支高素质的国际型研发队伍，涵盖了 IGBT 芯片、快恢复二极管芯片、SiC MOSFET 芯片以及 MCU、栅极驱动 IC 等芯片和 IGBT、SiC、GaN 等功率模块的设计、工艺开发、产品测试、产品

应用等，在半导体技术、电力电子、控制、材料、力学、热学、结构等多学科具备了深厚的技术积累。因此，公司报告期各期研发费用率持续上升并高于可比公司平均值。

4、财务费用

报告期内，公司财务费用构成情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 1-6 月	2024 年度	2023 年度	2022 年度
利息费用	124.65	290.31	178.77	240.59
其中：租赁负债利息费用	8.39	3.34	1.05	1.25
减：利息收入	281.91	2,005.60	7,491.73	9,587.07
汇兑损益	-2,276.77	1,022.17	267.08	-861.37
其他	19.12	82.79	84.16	23.35
合计	-2,414.92	-610.34	-6,961.72	-10,184.49

报告期各期，公司财务费用分别为-10,184.49 万元、-6,961.72 万元、-610.34 万元和-2,414.92 万元，占各期营业收入的比例分别为-3.76%、-1.90%、-0.18%和-1.25%。2024 年和 2025 年 1-6 月，公司利息收入减少，主要系前期对闲置募集资金进行现金管理，随着募集项目逐渐结项，购买定期存款等资金量减少。2025 年 1-6 月，公司财务费用受汇兑损益影响较大。

（五）其他主要项目分析

1、其他收益

报告期内，公司其他收益构成情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 1-6 月	2024 年度	2023 年度	2022 年度
政府补助	2,362.40	3,063.35	3,440.81	2,915.61
进项税加计抵减	870.09	4,684.99	257.53	-
代扣个人所得税手续费	45.99	49.51	22.05	11.64
合计	3,278.48	7,797.84	3,720.39	2,927.25

报告期各期，公司其他收益分别为 2,927.25 万元、3,720.39 万元、7,797.84 万元和 3,278.48 万元。其中，政府补助和进项税加计抵减系其他收益的主要组成部分。

2、投资收益

报告期内，公司投资收益构成情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 1-6 月	2024 年度	2023 年度	2022 年度
债务重组收益	-	19.13	-	-
金融资产处置损益	203.35	418.87	240.24	1,159.97
合计	203.35	438.00	240.24	1,159.97

报告期各期，公司投资收益分别为 1,159.97 万元、240.24 万元、438.00 万元和 203.35 万元，主要为金融资产处置损益。

3、信用减值损失

报告期各期，公司信用减值损失分别为-1,058.77 万元、-1,198.42 万元、-1,210.02 万元和 19.50 万元，主要为以预期信用损失为基础计提的应收账款坏账准备，报告期随应收账款余额变动而变动。

4、资产减值损失

报告期各期，公司资产减值损失分别为-57.55 万元、-57.22 万元、-3,290.19 万元和 -507.91 万元，主要系公司根据《企业会计准则》规定，对预计可变现净值低于账面价值的存货计提了存货跌价准备。

5、营业外收入

报告期各期，公司营业外收入分别为 17.75 万元、15.06 万元、10.75 万元和 7.40 万元，与公司营业收入相比金额较低，对公司利润影响较小。

6、营业外支出

报告期各期，公司营业外支出分别为 36.50 万元、1,306.39 万元、10.10 万元和 1.50 万元，与公司营业成本相比金额较低，对公司利润影响较小。

（六）非经常性损益

报告期内，发行人的非经常性损益项目及其金额如下：

单位：万元

项目	2025 年 1-6 月	2024 年度	2023 年度	2022 年度
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值	-10.27	-13.68	2.59	1.20

项目	2025 年 1-6 月	2024 年度	2023 年度	2022 年度
准备的冲销部分				
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	1,201.65	1,331.31	2,600.36	2,915.61
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	453.74	763.10	1,554.10	2,732.41
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	24.49	-	-
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	-	-	2.47
债务重组损益	-	19.13	-	-
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响	-	-	-	858.03
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5.90	0.65	-1,291.33	-18.75
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	49.51	22.05	15.73
减：所得税影响额	186.79	105.47	448.23	966.75
少数股东权益影响额（税后）	26.09	38.97	9.41	11.35
合计	1,438.14	2,030.07	2,430.13	5,528.60

报告期各期，公司非经常性损益分别为 5,528.60 万元、2,430.13 万元、2,030.07 万元和 1,438.14 万元，主要为计入当期损益的政府补助、持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益等。

八、现金流量分析

（一）经营活动产生的现金流量分析

报告期内，公司经营活动现金流量情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 1-6 月	2024 年	2023 年	2022 年
销售商品、提供劳务收到的现金	168,611.00	285,718.15	337,853.49	257,639.11
收到的税费返还	2,926.77	27,143.47	21,889.15	6.03
收到其他与经营活动有关的现金	20,194.88	11,498.58	22,463.60	16,445.94
经营活动现金流入小计	191,732.65	324,360.20	382,206.23	274,091.08
购买商品、接受劳务支付的现金	111,197.28	160,610.23	293,107.77	161,515.26
支付给职工以及为职工支付的现金	25,435.65	35,813.60	26,691.28	18,261.78
支付的各项税费	9,501.65	12,168.64	11,265.66	21,650.23

项目	2025 年 1-6 月	2024 年	2023 年	2022 年
支付其他与经营活动有关的现金	9,162.76	19,503.66	12,872.96	5,828.53
经营活动现金流出小计	155,297.34	228,096.14	343,937.66	207,255.79
经营活动产生的现金流量净额	36,435.31	96,264.06	38,268.57	66,835.29

报告期各期，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 66,835.29 万元、38,268.57 万元、96,264.06 万元和 36,435.31 万元。公司经营活动现金流入主要为销售商品、提供劳务收到的现金，流出主要为购买商品、接受劳务支付的现金，与实际业务的发生相符。

采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量净额情况如下：

项目	2025 年 1-6 月	2024 年	2023 年	2022 年
净利润	27,911.07	51,338.67	92,069.91	82,074.64
加：资产减值准备	507.91	3,290.19	57.22	57.55
信用减值损失	-19.50	1,210.02	1,198.42	1,058.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	17,953.54	20,954.51	10,194.21	5,440.19
使用权资产摊销	107.36	95.38	42.55	42.98
无形资产摊销	650.55	822.35	677.44	650.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）	10.27	13.68	-2.59	-1.20
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	-	-	-432.70	-779.22
财务费用（收益以“—”号填列）	961.89	6,229.00	3,849.76	1,307.77
投资损失（收益以“—”号填列）	-203.35	-457.13	-240.24	-1,159.97
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-57.46	-999.59	-1,871.42	78.40
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	164.54	3,159.43	3,431.67	972.96
存货的减少（增加以“—”号填列）	-28,995.68	-5,291.22	-55,942.47	-30,597.20
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-7,802.66	-25,633.04	-31,156.57	-28,700.50
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	25,246.85	41,451.14	15,576.72	34,755.23
其他	-	80.68	816.66	1,634.66
经营活动产生的现金流量净额	36,435.31	96,264.06	38,268.57	66,835.29

（二）投资活动产生的现金流量分析

报告期内，公司投资活动现金流量情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 1-6 月	2024 年	2023 年	2022 年
收回投资收到的现金	282,500.00	467,700.00	125,000.00	300,000.00

项目	2025 年 1-6 月	2024 年	2023 年	2022 年
取得投资收益收到的现金	480.97	821.45	1,907.64	2,728.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3.25	14.99	5.81	3.89
投资活动现金流入小计	282,984.22	468,536.43	126,913.45	302,732.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,402.02	200,304.48	220,292.67	130,193.21
投资支付的现金	282,500.00	465,000.00	57,700.00	295,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	9,444.29	-	-	-
投资活动现金流出小计	330,346.30	665,304.48	277,992.67	425,193.21
投资活动产生的现金流量净额	-47,362.09	-196,768.04	-151,079.21	-122,460.80

报告期各期，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-122,460.80 万元、-151,079.21 万元、-196,768.04 万元和-47,362.09 万元。报告期内，公司的投资活动现金流入和流出主要为公司购买交易性金融资产以及购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金。

（三）筹资活动产生的现金流量分析

报告期内，公司投资活动现金流量情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 1-6 月	2024 年	2023 年	2022 年
吸收投资收到的现金	41.53	1,239.44	6,755.27	2,381.55
取得借款收到的现金	60,867.97	75,468.65	38,095.72	56,115.95
筹资活动现金流入小计	60,909.50	76,708.08	44,850.99	58,497.50
偿还债务支付的现金	37,732.55	17,900.00	327.47	58.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,919.16	33,645.91	27,515.07	13,081.90
支付其他与筹资活动有关的现金	121.90	112.29	38.01	110.86
筹资活动现金流出小计	49,773.61	51,658.19	27,880.55	13,251.65
筹资活动产生的现金流量净额	11,135.89	25,049.89	16,970.43	45,245.85

报告期各期，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为 45,245.85 万元、16,970.43 万元、25,049.89 万元和 11,135.89 万元。报告期内，公司筹资活动的现金流入主要为向银行借款，流出主要为偿还债务和股利分配支付的现金。

综上，报告期内，公司现金流量整体保持稳定，变动情况与公司的经营状况基本相符，公司上市后坚持利润分配，较好地实现了对投资者的合理、稳定回报。

九、资本性支出分析

（一）报告期内重大资本性支出

报告期内，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金分别为130,193.21万元、220,292.67万元、200,304.48万元和38,402.02万元，公司的资本性支出主要用于高压特色工艺功率芯片研发及产业化项目、SiC芯片研发及产业化项目和功率半导体模块生产线自动化改造项目等，均围绕主营业务进行。

（二）未来可预见的重大资本性支出计划及需要资金量

公司未来可预见的资本性支出项目主要为本次募集资金计划投资的项目，具体内容参见本募集说明书“第七节 本次募集资金运用”。

十、技术创新分析

（一）技术先进性及具体表现

公司自成立以来一直以技术发展和产品质量为公司之根本，并以开发新产品、新技术为公司的主要工作，持续大幅度地增加研发投入，培养、组建了一支高素质的国际型研发队伍，涵盖了IGBT芯片、快恢复二极管芯片、SiC MOSFET芯片以及MCU、栅极驱动IC等芯片和IGBT、SiC、GaN等功率模块的设计、工艺开发、产品测试、产品应用等，在半导体技术、电力电子、控制、材料、力学、热学、结构等多学科具备了深厚的技术积累。

公司技术先进性及具体表现参见本募集说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、公司的核心技术及研发情况”之“（三）公司核心技术及其应用情况”。

（二）正在从事的研发项目及进展情况

公司正在从事的研发项目及进展情况参见本募集说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、公司的核心技术及研发情况”之“（五）公司在研项目情况”。

（三）保持持续技术创新的机制和安排

公司采用自主研发模式，在国内设有三个研发中心，2014年和2023年分别在德国纽伦堡、瑞士苏黎世设有两个海外研发中心，负责前沿芯片设计、工艺以及模块封装技术的开发。公司坚定以“研发推动市场，市场反馈研发”的发展思路，形成研发与销售

之间的闭环。

公司拥有多名具有国内外一流研发水平的技术人员，多人具备在国际著名功率半导体公司承担研发工作的经历，并培养了一批具备超过十五年工作经验的研发骨干。公司将不断补充高素质的专业技术团队，进一步加大对 IGBT、SiC、GaN、MCU 芯片以及先进的模块封装技术研发力度。

十一、重大担保、仲裁、诉讼、其他或有事项和重大期后事项

（一）重大担保事项

截至本募集说明书签署日，公司不存在重大对外担保事项。

（二）重大仲裁、诉讼事项

截至本募集说明书签署日，公司不存在法院/仲裁机构已受理相关案件但尚未作出生效判决/裁定/当事人未达成调解或和解协议的重大诉讼、仲裁事项。

（三）其他或有事项

截至本募集说明书签署日，公司或有事项如下：

1、已背书或贴现未到期的应收票据

截至 2025 年 6 月 30 日止，公司已背书或贴现未到期的应收票据金额为 127,892.87 万元。

2、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

公司于日常业务过程中会涉及一些与客户、供应商之间的纠纷、诉讼或索偿。经咨询相关法律顾问，截至财务报表报出日，案件均在审理过程中，尚无法可靠估计诉讼可能的结果和影响。

（四）重大期后事项

截至本募集说明书签署日，公司不存在需要披露的重大期后事项。

十二、本次发行的影响

（一）本次发行完成后，公司业务及资产的变动或整合计划

本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金在扣除发行费用后，拟全部用于

车规级 SiC MOSFET 模块制造项目、IPM 模块制造项目、车规级 GaN 模块产业化项目和补充流动资金。本次募投项目符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益，有利于促进公司长期稳定可持续发展。随着本次发行可转债的完成及募集资金投资项目的实施，公司的核心竞争能力及抗风险能力将进一步增强，符合公司长远发展。

本次发行完成后，公司的主营业务保持不变，不涉及对公司现有资产的整合，不存在因本次发行而导致的业务与资产整合计划。

（二）本次发行完成后，上市公司控制权结构的变化情况

本次发行不会导致上市公司控制权发生变化。

第六节 合规经营与独立性

一、公司报告期内受到的行政处罚

报告期内，发行人及其子公司不存在行政处罚记录。

二、公司及董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人报告期内被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况

报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人均不存在被证监会行政处罚或采取监管措施及整改情况、被证券交易所公开谴责的情况，以及因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被证监会立案调查的情况。

三、关联方资金占用情况

报告期内，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或其他方式占用的情形，不存在为控股股东及其控制的其他企业进行违规担保的情形。

四、同业竞争情况

（一）控股股东、实际控制人与公司之间的同业竞争情况

1、发行人与控股股东及其控制的其他企业不存在同业竞争

公司控股股东香港斯达除持有公司股份外，还持有港禾逸蓝 100%的股权。

港禾逸蓝成立于 2023 年 10 月，截至本募集说明书签署日，港禾逸蓝未实际开展业务，不存在与发行人同业竞争的情况。

除持有公司及港禾逸蓝股权外，公司控股股东香港斯达未开展其他经营业务，不存在与发行人同业竞争的情况。

2、发行人与实际控制人及其近亲属控制的其他企业不存在同业竞争

公司实际控制人为沈华、胡畏夫妇，除通过斯达控股间接持有香港斯达 100%的股份，从而实际支配了香港斯达所持公司 41.66%的股份之外，还通过香港斯达间接控制了港禾逸蓝，除上述公司外，公司实际控制人及其近亲属未控制其他公司，不存在与发行人同业竞争的情况。

综上，截至本募集说明书签署日，公司与控股股东和实际控制人及其控制的企业之间不存在同业竞争。

（二）有关避免同业竞争的承诺

发行人上市时，为避免将来可能与发行人发生的同业竞争，维护公司全体股东的利益和保证公司的长期稳定发展，公司控股股东香港斯达、公司实际控制人沈华、胡畏分别出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，具体内容如下：

1、控股股东的承诺

“1、除发行人及其控股子公司从事的业务外，本企业及本企业控制的其他企业未直接或间接从事与发行人及其控股子公司主营业务构成同业竞争的业务或活动。

2、本企业及本企业控制的其他企业将不以任何方式（包括但不限于投资、并购、联营、合资、合作、合伙、承包或租赁经营）直接或间接从事或介入，以及不以任何方式支持他人从事与发行人及其控股子公司现有或将来实际从事的主营业务构成或可能构成竞争的业务或活动，也不生产任何与发行人产品相同或相似或可以取代发行人的产品。

3、如本企业及本企业控制的其他企业从任何第三者获得的任何商业机会与发行人及其下属公司主营业务构成或可能构成实质性竞争的，本企业将立即通知发行人，并尽力将该等商业机会让与发行人，以避免与发行人及下属公司形成同业竞争或潜在同业竞争。

4、如发行人及其子公司业务扩张导致本企业及本企业控制的其他企业的业务与发行人及其子公司的主营业务构成同业竞争，则本企业及本企业控制的其他企业将采取包括但不限于停止竞争性业务、将竞争性业务注入发行人或其子公司、向无关联关系的第三方转让竞争性业务或其他合法方式避免同业竞争；如本企业及本企业控制的其他企业转让竞争性业务，则发行人或其子公司享有优先购买权。

5、本企业及本企业控制的其他企业承诺将不向其业务与发行人主营业务构成或可能构成竞争的企业或个人提供技术信息、工艺流程、销售渠道等商业秘密。

6、上述承诺在本企业作为发行人的股东期间持续有效，除经发行人同意外不可变更或撤销。如因违反上述承诺给发行人造成损失的，本企业将赔偿发行人由此遭受的一

切直接和间接损失。”

2、实际控制人的承诺

“1、除发行人及其控股子公司从事的业务外，本人及本人控制的其他企业未直接或间接从事与发行人及其控股子公司主营业务构成同业竞争的业务或活动。

2、本人及本人控制的其他企业将不以任何方式（包括但不限于投资、并购、联营、合资、合作、合伙、承包或租赁经营）直接或间接从事或介入，以及不以任何方式支持他人从事与发行人及其控股子公司现有或将来实际从事的主营业务构成或可能构成竞争的业务或活动，也不生产任何与发行人产品相同或相似或可以取代发行人的产品。

3、如本人及本人控制的其他企业从任何第三者获得的任何商业机会与发行人及其下属公司主营业务构成或可能构成实质性竞争的，本人将立即通知发行人，并尽力将该等商业机会让与发行人，以避免与发行人及下属公司形成同业竞争或潜在同业竞争。

4、如发行人及其子公司业务扩张导致本人及本人控制的其他企业的业务与发行人及其子公司的主营业务构成同业竞争，则本人及本人控制的其他企业将采取包括但不限于停止竞争性业务、将竞争性业务注入发行人或其子公司、向无关联关系的第三方转让竞争性业务或其他合法方式避免同业竞争；如本人及本人控制的其他企业转让竞争性业务，则发行人或其子公司享有优先购买权。

5、本人及本人控制的其他企业承诺将不向其业务与发行人主营业务构成或可能构成竞争的企业或个人提供技术信息、工艺流程、销售渠道等商业秘密。

6、上述承诺在本人作为发行人的股东期间持续有效，除经发行人同意外不可变更或撤销。如因违反上述承诺给发行人造成损失的，本人将赔偿发行人由此遭受的损失。”

五、关联方和关联交易情况

（一）关联方及关联关系

根据《公司法》《企业会计准则第 36 号——关联方披露》《上市公司信息披露管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 226 号）《上海证券交易所股票上市规则》及相关规范性文件的规定，报告期内公司的主要关联方及关联方关系如下：

1、发行人控股股东、实际控制人及其一致行动人

序号	关联方名称/姓名	关联关系
1	香港斯达	系发行人的控股股东
2	沈华	系发行人的实际控制人
3	胡畏	系发行人的实际控制人

上述关联方的相关情况详见本募集说明书之“第四节 发行人基本情况”之“三、控股股东和实际控制人的基本情况及上市以来的变化情况”。

2、持有发行人 5%以上股份的其他股东

截至 2025 年 6 月 30 日，控股股东香港斯达外，其他持有公司 5%以上股份的股东为浙江兴得利。

截至 2025 年 6 月 30 日，浙江兴得利持有公司 29,493,471 股，占公司股份总额的 12.32%。该公司基本情况如下：

项目	基本情况
公司名称	浙江兴得利纺织有限公司
成立时间	1998 年 4 月 28 日
注册资本	3,000 万元
实缴资本	3,000 万元
法定代表人	陈幼兴
注册地址	浙江省海宁市斜桥镇祝场祝兴路 47 号
公司类型	有限责任公司（自然人独资）
主营业务	主要从事棉纺、化纤、氨纶等产品生产及销售
经营范围	一般项目：面料纺织加工；产业用纺织制成品制造；家用纺织制成品制造；针织或钩针编织物及其制品制造；棉花加工；棉花收购；纺织专用设备制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；技术进出口；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

3、发行人的子公司

（1）发行人控股子公司

截至 2025 年 6 月 30 日，公司控股子公司情况参见本募集说明书之“第五节 财务会计信息与管理层分析”之“三、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及其变化情况”之“（三）合并报表范围及其变化情况”之“1、报告期末合并报表范围”。

（2）发行人参股子公司

截至报告期期末，发行人拥有 1 家参股公司，即宁波央腾汽车电子有限公司，主要情况如下：

企业名称	关联关系	经营范围
宁波央腾汽车电子有限公司	发行人持有其 1.1215% 的股权	汽车、电动汽车、叉车、摩托车控制器及其他汽车零部件、电机、充电器、电线电缆制造、加工。

4、发行人其他董事、监事、高级管理人员

发行人董事、监事、高级管理人员均系发行人的关联方，除实际控制人沈华、胡畏外，其他董事、监事、高级管理人员情况如下：

序号	关联方姓名	关联关系
1	陈幼兴	副董事长
2	龚央娜	董事
3	沈小军	独立董事
4	崔晓钟	独立董事
5	吴兰鹰	独立董事
6	刘志红	监事会主席
7	胡少华	职工代表监事
8	毛国锋	监事
9	汤艺	副总经理
10	李云超	副总经理
11	戴志展	副总经理
12	张哲	副总经理、董事会秘书、财务总监

上述关联方的相关情况详见本募集说明书之“第四节 发行人基本情况”之“五、公司董事、监事、高级管理人员”之“（一）董事、监事、高级管理人员基本情况”。

5、发行人其他关联自然人

与发行人实际控制人及其一致行动人、董事、监事及高级管理人员关系密切的家庭成员，包括其配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满十八周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母，均系发行人的关联方。

6、发行人控股股东、实际控制人及其一致行动人控制或对外投资（包含曾经对外投资）或担任董事、高级管理人员的其他企业

（1）控股股东控制的其他企业

截至本募集说明书签署日，发行人控股股东香港斯达持有港禾逸蓝 100%的股权，同时胡畏担任港禾逸蓝执行董事、龚央娜任经理。

（2）实际控制人控制或对外投资（包含曾经对外投资）或担任董事、高级管理人员的其他企业

截至本募集说明书签署日，除发行人、控股股东、港禾逸蓝外，发行人实际控制人控制不存在其他对外投资（包含曾经对外投资）或担任董事、高级管理人员的情形。

7、发行人其他持股 5%以上股东直接或间接控制的企业

截至本募集说明书签署日，发行人其他持股 5%以上股东直接或间接控制的企业如下：

序号	关联方名称	主要关联关系
1	浙江湾河纺织有限公司	浙江兴得利纺织有限公司持股 100%，董事陈幼兴担任经理、董事
2	浙江艾美泰克电子科技有限公司	浙江兴得利纺织有限公司持股 50%，董事陈幼兴担任总经理、执行董事

8、发行人其他关联自然人控制或者担任董事、高级管理人员的其他企业

截至本募集说明书签署日，发行人其他关联自然人控制或担任董事、高级管理人员的其他企业如下：

序号	关联方名称	主要关联关系
1	福州兴得利投资有限公司	董事陈幼兴担任经理、执行董事，持股 70%
2	浙江湾谷纺织有限公司	董事陈幼兴直接持有 20%的股权，并通过福州兴得利投资有限公司间接持有 56%的股权，担任经理、执行董事
3	浙江湾河纺织有限公司	董事陈幼兴控制的浙江兴得利纺织有限公司持股 100%，担任经理、董事
4	浙江艾美泰克电子科技有限公司	董事陈幼兴控制的浙江兴得利纺织有限公司持股 50%，且担任总经理、执行董事
5	海宁华维新材料有限公司	董事陈幼兴的女儿陈洁直接持有 80%的股权，担任执行董事兼总经理
6	海宁蓝岛科技有限公司	董事陈幼兴的女儿陈洁控制的海宁华维新材料有限公司持股 100%，担任董事、总经理
7	福州禾源投资合伙企业（有限合伙）	董事陈幼兴的女儿陈红为执行事务合伙人

序号	关联方名称	主要关联关系
8	东莞市禾源项目管理咨询中心(有限合伙)	董事陈幼兴的女儿陈洁为执行事务合伙人
9	嘉兴富瑞德投资合伙企业(有限合伙)	董事龚央娜担任执行事务合伙人, 持有斯达半导3.12%股份
10	嘉兴盛隆拉链制造有限公司	高级管理人员李云超担任董事
11	南宁富特莱科技有限公司	高级管理人员汤艺配偶陈乃硕担任董事, 持股19.67%
12	厦门高门商务咨询有限公司	高级管理人员汤艺关系密切的家庭成员陈懋照担任董事长
13	厦门荟金房地产代理有限公司	高级管理人员汤艺关系密切的家庭成员陈懋照担任法定代表人, 董事长兼总经理, 高级管理人员汤艺关系密切的家庭成员陈乃薇担任董事
14	防城港市高门荟金房地产开发有限公司	高级管理人员汤艺关系密切的家庭成员陈懋照担任法定代表人、执行董事兼总经理

与发行人实际控制人、持股 5%以上自然人股东、董事、监事和高级管理人员关系密切的家庭成员直接或者间接控制的, 或者担任董事、高级管理人员的法人或其他组织, 均系发行人的关联方。

9、发行人在报告期内的曾经主要关联方

发行人在报告期内的曾经主要关联方如下:

序号	关联方名称	关联关系
1	徐攀	报告期内曾任公司独立董事, 已于2023年10月11日卸任
2	黄苏融	报告期内曾任公司独立董事, 已于2023年10月11日卸任
3	郭清	报告期内曾任公司独立董事, 已于2023年10月11日卸任
4	许浩平	报告期内曾任公司副总经理, 已于2023年10月11日卸任
5	李君月	报告期内曾任公司监事, 已于2022年4月30日卸任。截至报告期末, 李君月任公司证券事务代表。
6	广西新熙艾健康管理 有限公司	高级管理人员汤艺关系密切的家庭成员陈乃薇担任执行董事, 经理, 财务负责人, 持股56%。2024年8月15日注销。
7	南宁群彩商务服务有限公司	高级管理人员汤艺关系密切的家庭成员陈乃薇担任执行董事兼总经理, 高级管理人员汤艺配偶陈乃硕担任财务负责人。2025年1月7日注销。

在过去 12 个月内或者根据相关协议安排在未来 12 个月内, 或在交易发生之日前 12 个月内, 或相关交易协议生效或安排实施后 12 个月内, 存在上述情形之一的法人、其他组织或自然人, 均系公司的关联方。

除上述关联方外, 发行人其他关联企业、关联自然人还包括其他根据《股票上市规则》《企业会计准则第 36 号-关联方披露》等相关规定认定的关联方。

（二）报告期内主要关联交易情况

1、关联交易汇总

报告期内，公司关联交易汇总情况如下表所示：

单位：万元

关联方	类别	关联交易内容	交易金额			
			2025 年 1-6 月/2025 年 6 月 30 日	2024 年度 /2024 年 12 月 31 日	2023 年度 /2023 年 12 月 31 日	2022 年度 /2022 年 12 月 31 日
关键管理人员	经常性关联交易	关键管理人员薪酬	347.49	706.31	762.70	740.46
关键管理人员	关联方应收应付款-其他应付款	个人报销款	-	0.56	-	-

注：报告期内发行人不存在重大关联交易情形。

2、经常性关联交易

报告期内，除关键管理人员薪酬外，公司不存在其他经常性关联交易。

报告期内，公司董事、监事及高级管理人员的薪酬如下：

单位：万元

项目	2025 年 1-6 月	2024 年度	2023 年度	2022 年度
关键管理人员薪酬	347.49	706.31	762.70	740.46
合计	347.49	706.31	762.70	740.46

3、偶发性关联交易

报告期内，公司不存在偶发性关联交易。

（三）关联交易应收应付账款余额

公司报告期内关联方应收应付款情况如下：

单位：万元

项目名称	款项性质	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
其他应付款	个人报销款	-	0.56	-	-

（四）独立董事对关联交易的意见

报告期内，公司已召开相应股东大会及董事会、监事会对已经发生的关联交易情况和当年预计发生的关联交易情况进行审议，独立董事就经审议关联交易事项发表了同意的独立意见，认为报告期内公司发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司

章程》的规定，定价公允，不存在损害公司和所有股东利益的行为；预计发生的关联交易为公司正常经营发展所必要，不存在损害公司和股东利益的情形。

（五）关联交易的决策程序

公司已依据有关法律、法规和规范性文件的规定，在《公司章程》《关联交易管理制度》《董事会议事规则》及《股东大会议事规则》中明确规定了关联交易的决策权限、程序，建立了相对完善的决策机制和监督体系。

公司已在《公司章程》及其他内部规定中明确了关联交易决策的相关程序，该等规定符合有关法律、法规和规范性文件的规定，该等制度的有效实施能够防止损害公司及其他非关联股东利益的情况。公司董事会和股东大会对有关关联交易事项进行表决时，依照有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定履行了相应的批准程序；公司与关联方之间发生的关联交易不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

（六）公司为规范和减少关联交易而采取的措施

公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力，以减少对关联方的依赖。

对于不可避免的关联交易，公司将严格执行公司章程制定的关联交易决策程序、回避表决制度和信息披露制度，并进一步完善独立董事制度，加强独立董事对关联交易的监督，并进一步健全公司治理结构，保证关联交易的公平、公正、公允，避免关联交易损害公司及股东利益。

第七节 本次募集资金运用

一、本次募集资金使用计划

（一）本次募集资金使用计划概况

本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币 150,000.00 万元（含本数），募集资金总额扣除发行费用后用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金
1	车规级 SiC MOSFET 模块制造项目	100,245.26	60,000.00
2	IPM 模块制造项目	30,080.35	27,000.00
3	车规级 GaN 模块产业化项目	30,107.68	20,000.00
4	补充流动资金项目	43,000.00	43,000.00
合计		203,433.29	150,000.00

在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将以自有资金或自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

（二）本次募集资金投资项目与公司现有业务及发展战略的关系

公司本次募集资金投资项目包括车规级 SiC MOSFET 模块制造项目、IPM 模块制造项目、车规级 GaN 模块产业化项目及补充流动资金项目。

1、车规级 SiC MOSFET 模块制造项目

公司自成立以来一直专注于以 IGBT 和 SiC 为主的功率半导体芯片和模块的设计研发、生产及销售，多年来持续加大技术创新和产品优化力度，相关产品深受国内外市场的认可和信赖。在 SiC 领域，公司自 2020 年起陆续获得了国内外多个 SiC MOSFET 主电机控制器项目定点，并于 2022 年实现国内首个 800V 高压 SiC 主电机控制器平台批量装车。目前，公司车规级 SiC MOSFET 芯片和模块已经在国内外主流整车厂多车型

大批量装车，产品销量持续快速增长。

随着车规级 SiC MOSFET 模块在新能源汽车主电机控制器渗透率的不断扩大及公司多个 SiC MOSFET 主电机控制器定点项目相关车型陆续上市，公司亟需迅速扩充车规级 SiC MOSFET 模块产能以满足下游客户日益增长的需求。因此，公司拟通过本项目的建设，新建厂房、洁净车间及相关配套基础设施，购置先进制造设备，建设车规级 SiC MOSFET 模块生产线，进一步扩大公司车规级 SiC MOSFET 模块的产能。

2、IPM 模块制造项目

根据 ICV、产业在线、家电消费网数据，2026 年全球和中国变频白色家电 IPM 模块市场规模将稳健增长至 210.49 亿元人民币和 103.85 亿元人民币，2022 年至 2026 年复合增速分别为 7.41%和 7.68%，具备广阔的市场空间。目前，公司 IPM 模块已在工业变频器、伺服器、车用空调等领域广泛应用，产品技术成熟、质量稳定，得到了客户的高度认可。白色家电行业是公司重点布局行业之一，公司在该领域获取了稳定的客户群体，与美的、格力、海信、海尔等国内主流家电行业客户形成了密切的合作关系，为进一步提升公司在白色家电领域的市场份额，匹配下游客户市场需求，公司亟需增加 IPM 模块产能，扩大公司业务规模。

3、车规级 GaN 模块产业化项目

GaN 具有高电子迁移率、高饱和漂移速度、高热稳定性和高耐辐照性等优点，在高频、高效率及高温环境的应用场景下表现优异，已成为继 SiC 之后最受关注的第三代半导体材料。基于上述特性，GaN 模块在新能源汽车主电机控制器、新能源汽车充电桩、车载充电机（OBC）等应用场景具有较强的竞争力。目前，公司车规级 GaN 模块已获得了主电机控制器平台定点，2026 年将进入装车应用阶段，预计后续将取得更多的平台定点。本项目的实施将进一步增强公司车规级功率模块的技术积累，有助于公司抢占市场先机、保持技术领先地位。

4、补充流动资金项目

“补充流动资金项目”实施后，公司营运资金需求将得到有效满足，资产结构更加稳健，可进一步提升公司的整体抗风险能力，保障公司持续稳定发展。

综上，本次募投项目与公司现有业务及发展战略紧密相关。通过上述募投项目的实施，将进一步提升公司影响力和市场价值，全方位实现公司健康、均衡、持续的发展。

（三）资金缺口的解决方式

本次募集资金投资项目总投资额为 203,433.29 万元，拟投入募集资金 150,000.00 万元，其余所需资金公司将通过自有资金或自筹方式解决。

二、本次募集资金投资项目的具体情况

（一）车规级 SiC MOSFET 模块制造项目

1、项目基本情况

本项目拟投资 100,245.26 万元，拟使用本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 60,000.00 万元，其余部分由公司自筹解决。本项目拟于浙江省嘉兴市南湖区新建厂房、洁净车间及相关配套基础设施，购置先进制造设备，建设车规级 SiC MOSFET 模块生产线。

2、项目实施的必要性

（1）把握行业发展机遇，保持公司的行业领先地位

SiC 具有禁带宽度大、击穿场强高、饱和漂移速率高、热导率高等优点，可以承受更高的电压和具有更高的热导率。相比传统的硅基 IGBT 方案，SiC MOSFET 因其低导通电阻和低开关损耗，大幅降低了电机控制系统的损耗，提升了行驶里程，符合新能源汽车的应用需求。随着 SiC 衬底以及制造工艺的不断成熟及制造成本的逐步下降，SiC 方案将成为新能源汽车主电机控制器的主要解决方案之一。据 CASA Research 统计，2023 年全球近 35 家车企共推出了 50 余款支持 800V 高压平台的车型，“800V+SiC”已基本成为高端纯电新能源汽车标配。随着在材料、设计、制造等相关环节技术的不断突破，SiC MOSFET 模块制造成本不断降低，逐步向经济型纯电新能源汽车及增程/混动车型渗透，未来市场空间广阔。

公司作为国内新能源汽车车规级功率半导体模块的主要供应商，项目建设有助于公司充分把握 SiC MOSFET 在新能源汽车行业迅速渗透的机遇，保持公司在国内新能源汽车行业的领先地位，提升公司品牌的全球影响力。

（2）扩大车规级 SiC MOSFET 模块产能，满足客户需求

公司自成立以来一直专注于以 IGBT 和 SiC 为主的功率半导体芯片和模块的设计研发、生产及销售，多年来持续加大技术创新和产品优化力度，相关产品深受国内外市场

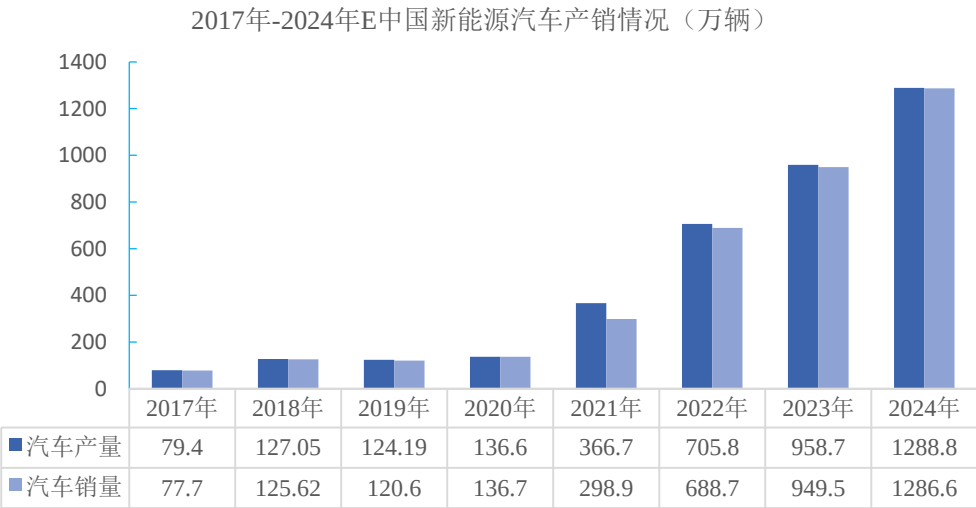
的认可和信赖。在 SiC 领域，公司自 2020 年起陆续获得了国内外多个 SiC MOSFET 主电机控制器项目定点，并于 2022 年实现国内首个 800V 高压 SiC 主电机控制器平台批量装车。目前，公司车规级 SiC MOSFET 芯片和模块已经在国内外主流整车厂多车型大批量装车，产品销量持续快速增长。

随着车规级 SiC MOSFET 模块在新能源主驱渗透率的不断扩大及公司多个 SiC MOSFET 主电机控制器定点项目相关车型陆续上市，公司亟需迅速扩充车规级 SiC MOSFET 模块产能以满足下游客户日益增长的需求。因此，公司拟通过本项目的建设，新建厂房、洁净车间及相关配套基础设施，购置先进制造设备，建设车规级 SiC MOSFET 模块生产线，进一步扩大公司车规级 SiC MOSFET 模块的产能。

3、项目实施的可行性

（1）新能源汽车产业的快速发展为项目实施提供了广阔的市场空间

根据中国汽车工业协会数据，2024 年，中国新能源汽车产销累计完成 1,288.8 万辆和 1,286.6 万辆，同比分别增长 34.4%和 35.5%，中国新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的 40.9%；根据中国科学技术协会的数据，2024 年，全球新能源汽车产销累计完成 1,770.7 万辆，同比增长了 24%，全球新能源汽车销量达到汽车总销量的 19.3%，新能源汽车行业的蓬勃发展为本项目的实施提供了广阔的市场空间。



数据来源：中国汽车工业协会

（2）公司优秀的品牌形象与深厚的客户资源积淀为项目实施奠定了坚实基础

公司坚持以市场为导向，以技术为支撑，通过不断的研发创新，开发出满足客户需

求的具有市场竞争力的功率半导体器件，在行业中树立了优秀的品牌形象，赢得了市场的高度认可与下游客户的持久信赖，已获得“国家级专精特新‘小巨人’企业”“浙江省科技领军企业”“浙江省电子信息百家重点企业”“浙江省半导体行业标杆企业”“浙江省科学技术进步奖一等奖”“中国智能电动汽车核心零部件百强”等多项荣誉或奖项。

经过多年的市场布局，公司在功率半导体诸多细分应用领域均已构建了较为稳定的客户体系，具备广泛的客户基础。特别是在新能源汽车领域，公司是国内车规级 IGBT/SiC MOSFET 模块的主要供应商，与新能源汽车整车厂及 Tier1 厂商保持了紧密的合作关系，为本项目的实施提供了坚实的合作基础。

公司优秀的品牌形象和深厚的客户资源积淀，为项目实施奠定了坚实基础，将为项目的高效推进与成功落地提供强有力的支撑。

4、项目投资概算及建设周期

本项目建设共需资金 100,245.26 万元，拟使用本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 60,000.00 万元，其余部分由公司自筹解决，如果募集资金不够，将由公司通过自有资金补充方式解决。

本项目建设周期为 3 年，整体进度安排如下：

项目名称	建设期第 1 年				建设期第 2 年				建设期第 3 年			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
工程前期工作	▲	▲										
工程建设	▲	▲	▲	▲	▲	▲						
设备购置及安装调试			▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲		
系统运行							▲	▲	▲	▲	▲	▲
竣工验收											▲	▲

5、效益预测的假设条件及主要计算过程

募投项目效益预测系公司基于当前市场情况对募投项目效益的合理预期，其实现取决于国家宏观经济政策、市场状况变化等多种因素。

根据测算，本项目建成后，项目内部收益率为 18.45%（所得税后），预计投资回收期（所得税后）为 7.88 年（含建设期 3 年）。

（1）营业收入预计

本项目营业收入的测算系以公司同类型产品平均销售单价为基础，结合市场情况，并根据各年预计销量情况测算得出。项目建成后，达产年的预计销售收入为 180,000.00 万元。

（2）营业成本及费用测算

本项目主营业务成本根据公司 2022-2024 年现有同类产品成本结构，同时结合募投项目相较历史新增产品类型预计情况综合预估，项目相关产品主营业务成本由原材料、人工成本、其他制造费及折旧摊销组成。销售费用、管理费用及研发费用按照营业收入的一定比例测算。

（3）税金及附加

本项目产品增值税税率 13%；城建税及教育费附加（含地方教育费附加）各按实交流转税的 7%和 5%征收；实施主体所得税率 15%。

6、项目建设用地及项目备案、环评情况

（1）项目备案及环评批复情况

本项目已获得《浙江省外商投资项目备案（赋码）信息表》（项目代码：2510-330402-89-02-576924），环评手续正在办理中。

（2）土地情况

本项目的实施主体为斯达半导体和斯达微电子，拟在斯达微电子现有土地上实施（土地权证号：浙（2021）嘉南不动产权第 0060715 号），不涉及新增土地，相关用地已取得土地使用权证。

（二）IPM 模块制造项目

1、项目基本情况

本项目拟投资 30,080.35 万元，拟使用本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 27,000.00 万元。本项目拟于重庆市高新区购买土地、新建厂房、洁净车间及相关配套基础设施，购置先进制造设备，建设 IPM 模块生产线，进一步扩大公司 IPM 模块的生产规模，满足下游快速增长的市场需求。

2、项目实施的必要性

（1）响应国家“双碳”战略，满足下游变频白色家电客户的市场需求

自 2020 年 9 月我国正式提出“双碳”战略以来，各行各业致力于实现节能降碳目标、加强节能降碳管理。家电行业作为国民经济的重要支柱产业，在大众践行低碳生活理念与低碳生活方式中承担着重要角色。变频白色家电凭借其节能、低噪音的优势，备受消费者青睐，在驱动行业绿色升级、优化居民生活体验方面扮演着举足轻重的角色。IPM 模块作为实现家电变频功能的核心功率半导体器件，市场需求十分广阔。根据产业在线数据，2024 年中国白色家电市场总产量同比上涨 15.80%，对 IPM 模块的国内需求规模达到 4.4 亿颗，同比增长 20.8%。白色家电市场规模庞大，发展前景广阔。

本项目的实施是公司对国家“双碳”战略的积极响应，满足下游变频白色家电客户对 IPM 模块的市场需求。

（2）增加 IPM 模块产能，扩大公司业务规模

根据 ICV、产业在线、家电消费网数据，2026 年全球和中国变频白色家电 IPM 模块市场规模将稳健增长至 210.49 亿元人民币和 103.85 亿元人民币，2022 年至 2026 年复合增速分别为 7.41%和 7.68%，具备广阔的市场空间。目前，公司已在大型商用变频空调领域积累了一大批高黏性的家电行业客户，为进一步提升公司在白色家电领域的市场份额，匹配下游客户市场需求，公司亟需增加 IPM 模块产能，进一步丰富产业布局，扩大公司业务规模。

3、项目实施的可行性

（1）变频白色家电行业广阔的市场空间为项目实施提供了坚实的市场基础

IPM 模块是变频白色家电中的核心器件，广泛应用于变频空调、冰箱、洗衣机等领域。根据国家家用电器工业信息中心发布的《2024 年中国家电行业年度报告》，2024 年中国家电市场零售额为 8,468 亿元，同比增长 9.0%。其中，空调销售规模约为 1,826 亿元，同比增长 11.8%；冰箱销售规模约为 1,159 亿元，同比增长 8.3%；洗衣机销售规模约为 925 亿元，同比增长 10.3%。根据产业在线数据，2024 年中国白色家电市场对 IPM 模块的国内需求规模达到 4.4 亿颗，同比增长 20.8%。目前，我国正不断加大对绿色智能家电的政策倾斜力度，持续推进白色家电节能减排和产品结构调整，空调、冰箱及洗衣机等白色家电的变频市场份额占比也在不断提升，IPM 模块的需求量将持续增大。

变频白色家电行业广阔的市场空间为项目实施提供了坚实的市场基础。

(2) 公司成熟的产品体系以及稳定优质的客户基础为项目实施提供了重要支撑

公司 IPM 模块已在工业变频器、伺服器、车用空调等领域广泛应用，产品技术成熟、质量稳定，得到了客户的高度认可。白色家电行业是公司重点布局行业之一，公司在该领域获取了稳定的客户群体，与美的、格力、海信、海尔等国内主流家电行业客户形成了密切的合作关系。公司在行业深耕多年积累的成熟产品体系和稳定优质的客户基础，为项目实施提供了重要支撑。

4、项目投资概算及建设周期

本项目建设共需资金 30,080.35 万元，项目建设资金拟使用本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 27,000.00 万元，其余部分由公司自筹解决，如果募集资金不够，将由公司通过自有资金补充方式解决。

本项目建设周期为 4 年，整体进度安排如下：

项目名称	建设期第 1 年				建设期第 2 年				建设期第 3 年				建设期第 4 年			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
土地购置	▲	▲														
工程前期工作	▲	▲														
工程建设	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲								
设备购置及安装调试			▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲		
系统运行											▲	▲	▲	▲	▲	▲
竣工验收															▲	▲

5、效益预测的假设条件及主要计算过程

募投项目效益预测系公司基于当前市场情况对募投项目效益的合理预期，其实现取决于国家宏观经济政策、市场状况变化等多种因素。

根据测算，本项目建成后，项目内部收益率为 16.00%（所得税后），预计投资回收期（所得税后）为 8.46 年（含建设期 4 年）。

(1) 营业收入预计

本项目营业收入的测算系以公司同类型产品平均销售单价为基础，结合市场情况，

并根据各年预计销量情况测算得出。项目建成后，达产年的预计销售收入为 66,000.00 万元。

（2）营业成本及费用测算

本项目主营业务成本根据公司 2022-2024 年现有同类产品成本结构，同时结合募投项目相较历史新增产品类型预计情况综合预估，项目相关产品主营业务成本由原材料、人工成本、其他制造费及折旧摊销组成。销售费用、管理费用及研发费用按照营业收入的一定比例测算。

（3）税金及附加

本项目产品增值税税率 13%；城建税及教育费附加（含地方教育费附加）各按实交流转税的 7%和 5%征收；实施主体所得税率 25%。

6、项目建设用地及项目备案、环评情况

（1）项目备案及环评批复情况

本项目已获得《重庆市企业投资项目备案证》（项目代码：2510-500356-07-01-247407），环评手续正在办理中。

（2）土地情况

本项目由斯达半导体（重庆）有限公司实施，项目实施地点为重庆市高新区，相关土地使用权正在获取中。

（三）车规级 GaN 模块产业化项目

1、项目基本情况

本项目拟投资 30,107.68 万元，拟使用本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 20,000.00 万元，其余部分由公司自筹解决。本项目拟于上海市嘉定区购买土地、新建厂房、洁净车间及相关配套基础设施，购置先进制造设备，建设车规级 GaN 模块生产线。

2、项目实施的必要性

（1）增强车规级功率模块的技术积累，保持技术领先地位

GaN 具有高电子迁移率、高饱和漂移速度、高热稳定性和高耐辐照性等优点，在

高频、高效率及高温环境的应用场景下表现优异，已成为继 SiC 之后最受关注的第三代半导体材料。基于上述特性，GaN 模块目前已大批量应用于新能源汽车充电桩、车载充电机（OBC）等场景，实现了降低电能损耗、节省充电桩体积、提高充电速率的效果，并减少了外围电容、电感等其他组件的成本。此外，目前 GaN 模块已经在新能源汽车主电机控制器中进行批量验证，预计 GaN 模块后续将大量应用于新能源汽车主电机控制器中。

本项目的实施将进一步增强公司车规级功率模块的技术积累，有助于公司抢占市场先机、保持技术领先地位。

（2）丰富公司产品品类，增强公司的行业影响力

在新能源汽车主电机控制器领域，除车规级 IGBT 模块和 SiC MOSFET 模块外，GaN 模块也逐步成为解决方案之一；在新能源汽车充电桩、OBC 等场景中，GaN 模块已成为主流解决方案之一。公司作为国内新能源汽车功率半导体模块的主要供应商，需要丰富自身产品结构，为客户提供全系列的解决方案。本项目的实施将实现车规级 GaN 模块的产业化，拓展公司产品在新能源汽车领域的应用场景，丰富公司在新能源汽车领域的产品品类，进一步增强公司在新能源汽车行业的影响力。

3、项目实施的可行性

（1）车规级 GaN 模块在新能源汽车领域应用的不断深化为项目实施提供市场基础

根据 CASA Research 的数据，目前国内第三代功率半导体已开始进入高速增长阶段，2023 年第三代功率器件模块市场规模约为 153.2 亿元，同比增长 45%，其中新能源汽车用第三代功率器件模块市场约 104.1 亿元，预计到 2027 年将达到 347.3 亿元。GaN 凭借其高频、高效、耐高温的特性，在第三代半导体中占据不可替代的地位。根据 Yole 数据，2023 年全球 GaN 功率器件市场规模约为 2.6 亿美元，2023-2029 年复合增长率约 41%，2029 年预计达 20.1 亿美元。在新能源汽车领域，车规级 GaN 模块的高频、高效率特性在充电应用中逐渐显现优势，已在 30kW 以下的充电桩 DC-DC 模块或车载充电机（OBC）中大批量应用。随着 GaN 芯片耐压能力和功率的提升，未来将应用于新能源汽车主电机控制器。车规级 GaN 模块在新能源汽车领域应用的不断深化为项目实施提供市场基础。

（2）公司丰富的人才和技术储备为项目的顺利实施提供了有力支撑

公司是国内功率半导体行业的领军企业，拥有多名具有国际著名功率半导体公司研发经历的一流研发技术专家，并培养了一批具备超过十五年工作经验的研发骨干。同时，公司具有全球化的研发布局，分别于 2014 年和 2023 年在德国纽伦堡和瑞士苏黎世设立了研发中心，广纳国际人才。

公司持续开展车规级第三代功率半导体模块封装技术的研发及产业化，较早地将车规级 GaN 模块封装的相关技术和产业化应用列入了重点发展方向，陆续攻克了多项关键工序的技术难点，并于 2024 年开发出了车规级 GaN 模块，针对 30kW-150kW 车用驱动应用，预计将于 2027 年进入装车应用阶段。

公司丰富的人才和技术储备为项目的顺利实施提供了有力支撑。

4、项目投资概算及建设周期

本项目建设共需资金 30,107.68 万元，项目建设资金拟使用本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 20,000.00 万元，其余部分由公司自筹解决，如果募集资金不够，将由公司通过自有资金补充方式解决。

本项目建设周期为 4 年，整体进度安排如下：

项目名称	建设期第 1 年				建设期第 2 年				建设期第 3 年				建设期第 4 年			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
土地购置	▲	▲														
工程前期工作	▲	▲														
工程建设	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲								
设备购置及安装调试			▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲		
系统运行											▲	▲	▲	▲	▲	▲
竣工验收															▲	▲

5、效益预测的假设条件及主要计算过程

募投项目效益预测系公司基于当前市场情况对募投项目效益的合理预期，其实现取决于国家宏观经济政策、市场状况变化等多种因素。

根据测算，本项目建成后，项目内部收益率为 18.73%（所得税后），预计投资回收期（所得税后）为 8.06 年（含建设期 4 年）。

（1）营业收入预计

本项目营业收入的测算系以公司同类型产品平均销售单价为基础，结合市场情况，并根据各年预计销量情况测算得出。项目建成后，达产年的预计销售收入为 45,140.00 万元。

（2）营业成本及费用测算

本项目主营业务成本根据公司 2022-2024 年现有同类产品成本结构，同时结合募投项目相较历史新增产品类型预计情况综合预估，项目相关产品主营业务成本由原材料、人工成本、其他制造费及折旧摊销组成。销售费用、管理费用及研发费用按照营业收入的一定比例测算。

（3）税金及附加

本项目产品增值税税率 13%；城建税及教育费附加（含地方教育费附加）各按实交流转税的 7%和 5%征收；实施主体所得税率 15%。

6、项目建设用地及项目备案、环评情况

1) 项目备案及环评批复情况

本项目已获得《上海市企业投资项目备案证明》（项目代码：2510-310114-04-01-545395），环评手续正在办理中。

2) 土地情况

本项目由上海道之实施，项目实施地点为上海市嘉定区，相关土地使用权正在获取中。

（四）补充流动资金

1、项目基本情况

公司拟将本次向不特定对象发行可转债募集的部分资金用于补充公司流动资金，金额为 43,000.00 万元，以满足公司业务不断发展对营运资金的需求，并增强公司资金实力，支持公司主营业务的长期持续发展。

2、项目实施的必要性和合理性

近年来，公司业务保持快速发展，资产规模稳步提升。随着业务规模的扩大，公司仅依靠内部经营积累和间接融资较难满足业务持续快速扩张对营运资金的需求。本次公

司拟将募集资金中的 43,000.00 万元用于补充流动资金，符合公司所处行业发展现状及公司业务发展需求。募集资金到位后，公司营运资金需求将得到有效满足，资产结构更加稳健，可进一步提升公司的整体抗风险能力，保障公司持续稳定发展，具备必要性和合理性。

3、本次发行补充流动资金规模符合规定

公司本次募集资金总额不超过 150,000.00 万元，其中非资本性支出 43,000.00 万元，占本次发行募集资金总额的比例为 28.67%，未超过募集资金总额的 30%，符合《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见-证券期货法律适用意见第 18 号》的要求。

三、本次募投项目与前次募投项目的区别和联系

公司 2020 年 IPO 募投项目聚焦于突破主要产品 IGBT 模块制造的产能瓶颈以及开展前沿研发活动。为把握汽车产业电动化、智能化、网联化发展带来的市场机遇，满足快速增长的市场需求，突破产能限制，公司实施了年新增 120 万个新能源汽车用 IGBT 模块扩产项目，以满足市场需求；为了加大研发力度，扩充研发团队，持续投入 IGBT 芯片、快恢复二极管芯片的研发和 IGBT 模块的设计，以保证在日益激烈的竞争中，进一步缩小与国际领先企业的差距，公司实施了技术研发中心扩建项目。

公司 2021 年度非公开发行募投项目通过生产线自动化改造增加了 400 万个 IGBT 模块年产能，以及向公司上游芯片制造环节进行延伸。考虑到当时公司产品所需的 3300V 以上高压特色工艺功率芯片及 SiC 芯片和公司现有的 600V-1700V 中低压 IGBT 芯片在生产工艺平台要求上存在一定差异，无法在现有代工厂平台上实现研发和量产，因此公司自建生产线进行投片生产。

公司本次募投项目则是在现有产品结构基础上，紧密结合下游行业需求与技术发展方向，进行第三代功率半导体模块产品的前瞻性布局与多元化拓展。公司在充分考虑新能源汽车主电机控制器、OBC、充电桩、AI 服务器电源等下游行业的需求以及技术发展趋势，依托现有技术，进而实施车规级 SiC MOSFET 模块扩产项目和车规级 GaN 模块产业化项目，抢占第三代功率半导体技术制高点，丰富公司产品矩阵。同时，依托公司在大型商用变频空调领域积累的一大批高黏性的家电行业客户，实施 IPM 模块制造项目，进一步提升公司在白色家电领域的市场份额，匹配下游客户市场需求，扩大公司

业务规模。

四、本次募集资金用于扩大既有业务的相关说明

（一）既有业务的发展情况

1、公司主营业务

公司主营业务是以 IGBT、SiC 为主的功率半导体芯片和模块的设计研发、生产及销售。公司总部位于浙江嘉兴，在上海、浙江、重庆和欧洲均设有子公司，并在国内和欧洲均设有研发中心。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业，行业代码为“C39”；根据国家统计局发布的《国民经济行业分类（2017 年修订）》（GB/T4754-2017），公司所属行业为半导体分立器件制造，行业代码为“C3972”。

2、公司的主要产品

公司长期致力于为高能效、绿色化和智能化应用提供全面的半导体及系统解决方案，产品组合覆盖 IGBT、SiC MOSFET、GaN HEMT、快恢复二极管等功率半导体器件以及汽车级与工业级 MCU、栅极驱动 IC 芯片等，广泛应用于新能源、新能源汽车、工业控制与电源、白色家电、AI 服务器电源、数据中心、机器人及低空/高空飞行器等领域。

作为电力电子第三次革命的核心代表，IGBT、SiC 和 GaN 等功率半导体器件被誉为工业控制与自动化领域的“心脏”，承担对电压、电流、频率、相位等关键参数的高效调控。2024 年，公司正式成立 MCU 事业部，专注于高端工规与车规级主控 MCU 的研发。MCU 作为电子设备的“大脑”，负责信号处理、逻辑判断与系统控制，实现对功率半导体等执行单元的精准调度。而栅极驱动 IC 则扮演“神经枢纽”的关键角色，负责将 MCU 发出的控制信号进行放大与调理，以高效、可靠地驱动 IGBT、SiC、GaN 等功率器件，确保“大脑”指令的准确执行与系统的快速响应。

MCU、功率半导体与栅极驱动 IC 三者的协同，构建起智能化系统中至关重要的“脑-心-神经”协同架构。这一完整产品链弥补了当前国内产业链的关键短板，进一步增强了公司为客户提供系统级解决方案的能力，有助于为下游行业提供更高性能、更优成本、更快响应的一体化解决方案，尤其在新能源、新能源汽车、机器人、低空/高空经济、AI 服务器电源、数据中心等高速增长领域，形成显著的技术协同与竞争优势，为公司持续引领行业创新注入新动能。

（二）新增产能的消化措施

公司本次募集资金投资项目包括车规级 SiC MOSFET 模块制造项目、IPM 模块制造项目、车规级 GaN 模块产业化项目。公司本次募集资金投资项目的下游应用领域主要包含新能源汽车行业、变频白色家电行业等。

根据中国汽车工业协会数据，2024 年，中国新能源汽车产销累计完成 1,288.8 万辆和 1,286.6 万辆，同比分别增长 34.4%和 35.5%，中国新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的 40.9%；根据中国科学技术协会的数据，2024 年，全球新能源汽车产销累计完成 1,770.7 万辆，同比增长了 24%，全球新能源汽车销量达到汽车总销量的 19.3%，持续保持快速增长态势。

根据全国家用电器工业信息中心发布的《2024 年中国家电行业年度报告》，2024 年中国家电市场零售额为 8,468 亿元，同比增长 9.0%。其中，空调销售规模约为 1,826 亿元，同比增长 11.8%；冰箱销售规模约为 1,159 亿元，同比增长 8.3%；洗衣机销售规模约为 925 亿元，同比增长 10.3%。根据产业在线数据，2024 年中国白色家电市场对 IPM 模块的国内需求规模达到 4.4 亿颗，同比增长 20.8%。目前，我国正不断加大对绿色智能家电的政策倾斜力度，持续推进白色家电节能减排和产品结构调整，空调、冰箱及洗衣机等白色家电的变频市场份额占比也在不断提升。

公司是国内功率半导体领域的领军企业，在多年的发展中形成了较强的产品竞争力以及广泛的客户基础。新能源汽车、变频白色家电行业的蓬勃发展以及公司市场份额的不断提高为本次募投产品的产能消化提供了有力的保障。

（三）技术、人员、市场方面储备

在技术方面，公司的核心技术均为自主研发创新，主要涵盖 IGBT 芯片、快恢复二极管芯片、SiC MOSFET 芯片等功率半导体芯片的设计、工艺和测试及功率半导体模块的设计、制造和测试。本次募投项目车规级 SiC MOSFET 模块制造项目、IPM 模块制造项目属于对公司现有产能的扩充，公司已具备成熟的技术储备；GaN 模块产业化项目方面，公司已经掌握诸多核心技术（包含氮化镓芯片铝带键合技术、氮化镓器件测试技术、氮化镓器件多芯片并联技术、氮化镓器件驱动技术、氮化镓器件可靠性技术等）并实现 GaN 模块批量化生产。

在人员方面，公司创始人为半导体行业技术专家，具备丰富的知识、技术储备及行

业经验；公司拥有多名具有国内外一流研发水平的技术人员，多人具备在国际著名功率半导体公司承担研发工作的经历，并培养了一批具备超过十五年工作经验的研发骨干。公司将不断补充高素质的专业技术团队，进一步加大对 IGBT、SiC、MCU、GaN 芯片以及先进的模块封装技术研发力度。同时，公司具有全球化的研发布局，2023 年，公司在瑞士苏黎世成立新的研发中心，苏黎世研发中心是公司 2014 年成立德国纽伦堡研发中心后在欧洲设立的第二个海外研发中心。专业的人才团队为本次募投项目的实施提供了充足的人才储备。

在市场方面，公司是国内功率半导体行业的领军企业，具有良好的市场基础。在新能源汽车领域，公司是国内车规级 IGBT/SiC MOSFET 模块的主要供应商，公司积极开拓海外市场并获得了多家国外头部 Tier 1 的项目定点；在新能源发电领域，公司已是国内多家主流光伏逆变器客户、风电逆变器客户的主要供应商，并且与头部企业建立了深入的战略合作关系；在白色家电领域，公司已成为美的、格力、海信、海尔等国内主流白色家电行业客户的主要供应商之一。

五、本次募集资金用于研发投入的情况

公司本次募投项目为“车规级 SiC MOSFET 模块制造项目”、“IPM 模块制造项目”、“车规级 GaN 模块产业化项目”和“补充流动资金”，不涉及研发项目，亦不涉及研发投入资本化的情形。

六、本次募投项目符合国家产业政策

公司主营业务是以 IGBT、SiC 为主的功率半导体芯片和模块的设计研发和生产，并以 IGBT 模块、SiC MOSFET 模块形式对外实现销售。本次募集资金拟投向车规级 SiC MOSFET 模块制造项目、IPM 模块制造项目和车规级 GaN 模块产业化项目等，募投项目不属于《产业结构调整指导目录（2024 年本）》中的淘汰类、限制类产业，不属于产能过剩行业，符合国家产业政策要求。

七、本次发行对公司的影响分析

（一）对公司经营管理的影响

本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金在扣除发行费用后，拟全部用于车规级 SiC MOSFET 模块制造项目、IPM 模块制造项目、车规级 GaN 模块产业化项目

和补充流动资金。本次募投项目符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益，有利于促进公司长期稳定可持续发展。随着本次发行可转债的完成及募集资金投资项目的实施，公司的核心竞争能力及抗风险能力将进一步增强，符合公司长远发展。

（二）对公司财务状况的影响

本次发行将进一步扩大公司的资产规模，如本次发行的可转债逐渐转股，公司的资产负债率将逐步降低，净资产提高，财务结构进一步优化，抗风险能力将得到提升。

新建项目产生效益需要一定的过程和时间，若本次发行的可转债转股较快，募投项目效益尚未完全实现，则可能出现每股收益等财务指标在短期内小幅下滑的情况。但是，随着本次募集资金投资项目的有序开展，公司的发展战略将得以有效实施，公司未来的盈利能力、经营业绩将会得到提升。

第八节 历次募集资金运用

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

1、2020 年首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于核准嘉兴斯达半导体股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2019] 2922 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,000.00 万股，发行价格为每股 12.74 元，募集资金总额人民币 50,960.00 万元，扣除承销费和保荐费人民币 3,500.00 万元（含税价）后的募集资金为人民币 47,460.00 万元，已于 2020 年 1 月 21 日全部到账。本次募集资金总额人民币 50,960.00 万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 5,010.67 万元后，实际募集资金净额人民币 45,949.33 万元。上述资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字[2020]第 ZA10026 号”验资报告验证确认。

2、2021 年非公开发行股票

2021 年 9 月，中国证券监督管理委员会《关于核准嘉兴斯达半导体股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021] 3201 号）核准公司非公开发行不超过 1,600 万股新股。

公司实际向 J.P. Morgan Chase Bank, National Association、富国基金管理有限公司、BARCLAYS BANK PLC 等 14 位认购人合计发行人民币普通股股票 10,606,060 股，每股面值 1.00 元，发行价格 330.00 元/股，共计募集资金人民币 349,999.98 万元，扣除承销费人民币 2,200.00 万元（含税价）后的募集资金为人民币 347,799.98 万元，已于 2021 年 11 月 3 日全部到账。本次募集资金总额人民币 349,999.98 万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 2,304.93 万元后，实际募集资金净额人民币 347,695.05 万元。上述资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字[2021]第 ZA15756 号”验资报告验证确认。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

1、2020 年首次公开发行股票

公司按照相关监管规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金户的存储情况如下：

单位：元

账户名称	开户银行名称	银行账号	初始存放金额	截止日余额
嘉兴斯达半导体股份有限公司	交通银行股份有限公司嘉兴分行营业部	334899991013000045994	117,991,300.00	-
嘉兴斯达半导体股份有限公司	中国农业银行股份有限公司嘉兴南湖支行	19310101040021256	200,000,000.00	-
嘉兴斯达半导体股份有限公司	杭州银行股份有限公司嘉兴分行	3304040160000575875	156,608,700.00	-
上海道之科技有限公司	杭州银行股份有限公司嘉兴分行	3304040160000630548	-	-
合计	-	-	474,600,000.00	-

注：截止 2025 年 6 月 30 日，上述募集资金专户已办理销户手续。

2、2021 年非公开发行股票

公司按照相关监管规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金户的存储情况如下：

单位：元

账户名称	开户银行名称	银行账号	初始存放金额	截止日余额
斯达半导体股份有限公司	杭州银行股份有限公司嘉兴分行	3304040160000746187	700,000,000.00	-
斯达半导体股份有限公司	中国农业银行股份有限公司嘉兴南湖支行	19310101040050016	-	-
斯达半导体股份有限公司	中国民生银行嘉兴分行	633749183	1,977,999,800.00	-
斯达半导体股份有限公司	中国农业银行股份有限公司嘉兴南湖支行	19310101040024557	800,000,000.00	-
嘉兴斯达微电子有限公司	交通银行股份有限公司嘉兴分行	334899991013000255187	-	-
嘉兴斯达微电子有限公司	中国农业银行股份有限公司嘉兴南湖支行	19310101040033368	-	-
嘉兴斯达微电子有限公司	杭州银行股份有限公司嘉兴分行	3304040160000749264	-	-
合计	-	-	3,477,999,800.00	-

注：截止 2025 年 6 月 30 日，上述募集资金专户已办理销户手续。

二、前次募集资金使用情况

（一）前次募集资金的实际使用情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司 2020 年首次公开发行股票募集资金的实际使用情况如下：

单位：万元

募集资金总额：			45,949.33			已累计使用募集资金总额：		46,543.94		
						各年度使用募集资金总额：		46,543.94		
变更用途的募集资金总额：			不适用			2020 年：		30,934.20		
						2021 年：		9,516.78		
变更用途的募集资金总额比例：			不适用			2022 年：		5,867.53		
						2023 年：		225.43		
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	新能源汽车用 IGBT 模块扩产项目	新能源汽车用 IGBT 模块扩产项目	15,949.33	15,949.33	16,054.98	15,949.33	15,949.33	16,054.98	105.65	2022 年 1 月
2	技术研发中心扩建项目	技术研发中心扩建项目	10,000.00	10,000.00	10,218.03	10,000.00	10,000.00	10,218.03	218.03	2022 年 1 月
3	补充流动资金	补充流动资金	20,000.00	20,000.00	20,270.93	20,000.00	20,000.00	20,270.93	270.93	不适用

截至 2025 年 6 月 30 日，公司 2021 年非公开发行股票募集资金的实际使用情况如下：

单位：万元

募集资金总额：			347,695.05			已累计使用募集资金总额：		362,366.20		
						各年度使用募集资金总额：		362,366.20		
变更用途的募集资金总额：			不适用			2021 年：		95,972.07		
						2022 年：		47,389.98		
变更用途的募集资金总额比例：			不适用			2023 年：		155,215.55		
						2024 年：		63,788.60		
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定 可使用状态日 期（或截止日项 目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额	实际投资金 额与募集后 承诺投资金 额的差额	
1	高压特色工艺 功率芯片研发 及产业化项目	高压特色工艺 功率芯片研发 及产业化项目	147,695.05	147,695.05	153,259.94	147,695.05	147,695.05	153,259.94	5,564.89	2024 年 11 月
2	SiC 芯片研发 及产业化项目	SiC 芯片研发 及产业化项目	50,000.00	50,000.00	55,773.42	50,000.00	50,000.00	55,773.42	5,773.42	2024 年 11 月
3	功率半导体模 块生产线自动 化改造项目	功率半导体模 块生产线自动 化改造项目	70,000.00	70,000.00	71,636.99	70,000.00	70,000.00	71,636.99	1,636.99	2024 年 11 月
4	补充流动资金	补充流动资金	80,000.00	80,000.00	81,695.85	80,000.00	80,000.00	81,695.85	1,695.85	不适用

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

公司前次募集资金均不存在实际投资项目发生变更的情况。

（三）前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

公司前次募集资金均不存在投资项目对外转让或置换情况

（四）前次募集资金前期投入和置换情况

1、2020 年首次公开发行股票

截止 2020 年 6 月 16 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币 6,148.06 万元。公司第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 6,148.06 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。上述代垫投入的自筹资金，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了《专项鉴证报告》（信会师报字[2020]第 ZA15013 号）。

2、2021 年非公开发行股票

截止 2021 年 12 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的实际投资金额为人民币 16,088.32 万元。公司第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 16,088.32 万元置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。上述代垫投入的自筹资金，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了《专项鉴证报告》（信会师报字[2022]第 ZA10711 号）。

（五）暂时闲置募集资金的使用情况说明

1、闲置募集资金暂时补充流动资金情况

（1）2020 年首次公开发行股票

公司于 2020 年 6 月 23 日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，将不超过 10,000.00 万元暂时闲置募集资金用于补充公司流动资金。使用期限自董事会审议通过

之日起不超过 12 个月。公司独立董事、监事会对该事项发表了同意意见，保荐机构也出具了核查意见。截至 2021 年 6 月 21 日，公司实际使用募集资金暂时补充流动资金总额为 10,000 万元，并已全部归还至募集资金专用账户。

公司于 2021 年 7 月 6 日召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，将不超过 8,000.00 万元暂时闲置募集资金用于补充公司流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司独立董事、监事会对该事项发表了同意意见，保荐机构也出具了明确同意的核查意见。

截止 2025 年 6 月 30 日，公司实际使用募集资金暂时补充流动资金总额为 5,724.40 万元，并已全部归还至募集资金专用账户。

（2）2021 年非公开发行股票

本公司 2021 年非公开发行股票募集资金不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

2、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

（1）2020 年首次公开发行股票

公司于 2020 年 4 月 28 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过了《关于 2020 年度使用部分暂时闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》，同意为了提高资金使用效率，增加现金资产收益，授权公司管理层使用额度不超过人民币 50,000.00 万元暂时闲置资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型银行结构性存款、理财产品。期限为股东大会审议批准之日起至下次有权授权机构批准作出新的决议前有效。在上述额度在决议有效期内，可以滚动使用。

（2）2021 年非公开发行股票

公司于 2021 年 12 月 3 日召开的 2021 年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意为了提高资金使用效率，增加现金资产收益，授权公司管理层使用额度不超过人民币 250,000.00 万元的暂时闲置资金和不超过 250,000.00 万元的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动

性好的保本型银行结构性存款、理财产品。期限为自公司股东大会审议通过之日起至股东大会（或公司有权机构）审议批准下一年度募集资金进行现金管理有关授权之日止，投资额度在上述投资期限内可滚动使用。

公司于 2023 年 4 月 28 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意为充分利用公司闲置资金，进一步提高闲置资金的使用效率，增加公司现金资产收益，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的同时，拟授权公司管理层使用额度不超过人民币 300,000.00 万元的暂时闲置资金和不超过 300,000.00 万元的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本理财产品。期限为股东大会审议批准之日起至下次有权授权机构批准作出新的决议前有效。在上述额度在决议有效期内，可以滚动使用。

公司于 2024 年 4 月 29 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意为了提高资金使用效率，增加现金资产收益，授权公司管理层使用额度不超过人民币 60,000.00 万元的暂时闲置资金和不超过 150,000.00 万元的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型银行结构性存款、理财产品。期限为自公司股东大会审议通过之日起至股东大会（或公司有权机构）审议批准下一年度募集资金进行现金管理有关授权之日止，投资额度在上述投资期限内可滚动使用。

截止 2025 年 6 月 30 日，公司无对闲置募集资金进行现金管理金额。

（六）前次募集资金投资项目实现效益情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司 2020 年首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况如下：

单位：万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用 率	承诺效益	最近三年一期实际效益				截止日累 计实现 效益	是否达 到预计 效益
序号	项目名称			2022 年度	2023 年度	2024 年度	2025 年 1-6 月		
1	新能源汽车用 IGBT 模 块扩产项目[注 1]	238.63%	达产年的所得税税后 利润为 5,440.00 万元	12,944.97 [注 2]	14,320.14 [注 2]	9,168.82 [注 2]	4,859.79 [注 2]	41,293.71	是
2	技术研发中心扩建 项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注 1：截止日投资项目产能利用率为项目达到预计可使用状态 2022 年 1 月至 2025 年 6 月 30 日止期间累计实际产量与设计产量之比。

注 2：各年度效益测算按当年募投设备折旧金额占生产设备总折旧金额比例模拟计算募投项目的销售收入、销售成本以及实际产量。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司 2021 年非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况如下：

单位：万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年一期实际效益				截止日 累计实 现效益	是否达 到预计 效益
序号	项目名称			2022 年度	2023 年度	2024 年度	2025 年 1-6 月		
1	高压特色工艺功率芯 片研发及产业化项目	不适用	达产年的所得税税 后利润为 48,410.90 万元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	SiC 芯片研发及产业 化项目	不适用	达产年的所得税税 后利润为 20,999.10 万元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	功率半导体模块生产 线自动化改造项目	不适用	达产年的所得税税 后利润为 23,461.30 万元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年一期实际效益				截止日 累计实 现效益	是否达 到预计 效益
序号	项目名称			2022 年度	2023 年度	2024 年度	2025 年 1-6 月		
4	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注：募投项目承诺效益约定为达产年的所得税税后利润，截止日募投项目均未达产。

（七）前次募集资金节余使用情况

1、2020 年首次公开发行股票

公司于 2023 年 4 月 8 日披露《关于首次公开发行募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》，公司首次公开发行股票募集资金项目已全部完成建设并达到预定可使用状态，项目可予以结项。鉴于首次公开发行股票募集资金项目已建设完毕并达到了预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司将节余募集资金合计人民币 225.57 万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

公司于 2023 年 6 月对募集资金专户办理了注销手续，节余募集资金已全部划转至公司的自有资金账户，实际转出金额为 225.68 万元。

2、2021 年非公开发行股票

公司于 2024 年 10 月 30 日披露《关于 2021 年非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》，公司非公开发行股票募集资金项目已全部完成建设并达到预定可使用状态，项目可予以结项。鉴于非公开发行募集资金投资项目已建设完毕并达到了预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司将节余募集资金合计人民币 1,594.04 万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

公司于 2024 年 11 月对募集资金专户办理了注销手续，节余募集资金已全部划转至公司的自有资金账户，实际转出金额为 1,594.04 万元。

三、注册会计师对前次募集资金使用情况的审核意见

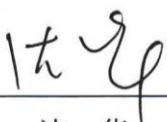
立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2025 年 8 月 27 日出具《关于斯达半导体股份有限公司截至 2025 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况报告的鉴证报告》（信会师报字[2025]第 ZA14871 号），认为斯达半导截至 2025 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的相关规定编制，如实反映了斯达半导截至 2025 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况。

第九节 声明

一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明

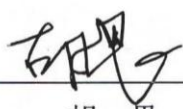
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

全体董事签名：

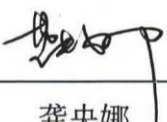


沈 华

陈幼兴



胡 畏



龚央娜

沈小军

崔晓钟

吴兰鹰

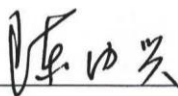


第九节 声明

一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

全体董事签名：

_____ 沈 华	 _____ 陈幼兴	_____ 胡 畏
_____ 龚央娜	_____ 沈小军	_____ 崔晓钟
_____ 吴兰鹰		

斯达半导体股份有限公司

2025 年 10 月 24 日

第九节 声明

一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

全体董事签名：

沈 华

陈幼兴

胡 畏

沈小军

龚央娜

沈小军

崔晓钟

吴兰鹰

斯达半导体股份有限公司
2025 年 10 月 17 日



第九节 声明

一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

全体董事签名：

沈 华

陈幼兴

胡 畏

龚央娜

沈小军

崔晓钟

吴兰鹰

斯达半导体股份有限公司

2025 年 10 月 23 日

第九节 声明

一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

全体董事签名：

沈 华

陈幼兴

胡 畏

龚央娜

沈小军

崔晓钟

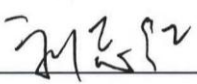
吴兰鹰



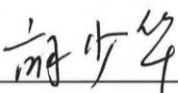
一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

全体监事签名：



刘志红



胡少华



毛国锋

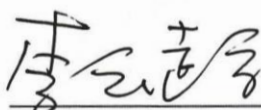


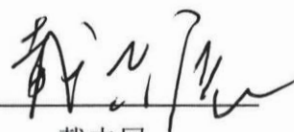
一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明

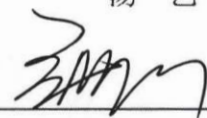
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

除董事、监事以外的全体高级管理人员签名：


汤 艺


李云超


戴志展

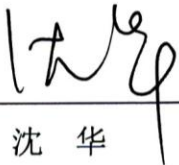

张 哲



二、控股股东、实际控制人声明

本公司或本人承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

实际控制人：



沈 华



胡 畏

控股股东：

香港斯达控股有限公司

(盖章)

董事：



沈 华

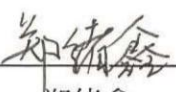
斯达半导体股份有限公司

2025年3月25日

三、保荐机构（主承销商）声明

本公司已对募集说明书进行了核查，确认本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

保荐代表人：

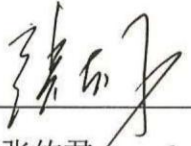

郑绪鑫


孟 夏

项目协办人：


孙 骏

法定代表人：


张佑君

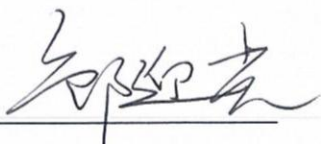


2025年10月23日

保荐机构总经理声明

本人已认真阅读募集说明书的全部内容,确认本募集说明书内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任。

总经理:


邹迎光



保荐机构董事长声明

本人已认真阅读募集说明书的全部内容，确认本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

董事长：

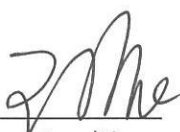

张佑君

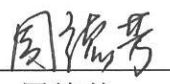


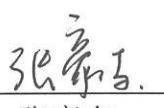
四、律师事务所声明

本所及经办律师已阅读募集说明书，确认募集说明书与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及经办律师对发行人在募集说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认募集说明书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

经办律师：


王 振


周德芳


张豪东

律师事务所负责人：

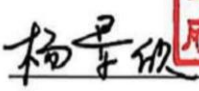
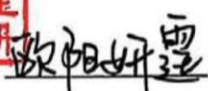

颜克兵


北京海润天睿律师事务所
2016年10月23日

五、会计师事务所声明

本所及签字注册会计师已阅读募集说明书，确认募集说明书与本所出具的审计报告等文件不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在募集说明书中引用的审计报告等文件的内容无异议，确认募集说明书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本声明仅供斯达半导体股份有限公司申请向不特定对象发行可转换债券之用，不适用于任何其他目的。

签字注册会计师：    
杨景欣 欧阳妍霆
杨景欣 欧阳妍霆

周芳芳
(已离职)

会计师事务所负责人：  
杨志国

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

2025年10月23日

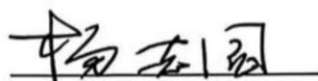
关于签字会计师离职说明

本所作为斯达半导体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的审计机构，于 2023 年 4 月 7 日出具了报告号为信会师报字(2023)第 ZA10942 号审计报告、2024 年 4 月 7 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZA10608 号审计报告，周芳芳为上述报告签字注册会计师之一。

截至本说明出具之日，周芳芳因个人原因已从本所离职，因此周芳芳无法在斯达半导体股份有限公司本次发行声明文件中审计机构声明中签字。

特此说明。

会计师事务所负责人：



杨志国



立信会计师事务所(特殊普通合伙)



2025 年 10 月 23 日

六、资信评级机构声明

本机构及签字资信评级人员已阅读募集说明书，确认募集说明书与本机构出具的资信评级报告不存在矛盾。本机构及签字资信评级人员对发行人在募集说明书中引用的资信评级报告的内容无异议，确认募集说明书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

签字评级人员：

张行行

张行行

房思旗

房思旗

资信评级机构负责人/授权代理人：

席宁

席宁

大公国际资信评估有限公司



授权书

授权人: 吕柏乐 大公国际资信评估有限公司 法定代表人

被授权人: 席宁 大公国际资信评估有限公司 评级总监

一、授权委托事项:

授权被授权人席宁代为审阅、签署下述文件, 被授权人超越授权范围须经授权人另行授权, 否则无效。

- 1、募集说明书中的资信评级机构声明;
- 2、可转换公司债券会后重大事项承诺函;
- 3、公司债券(含企业债券)、小微企业增信集合债券评级中的评级信用承诺书;
- 4、公司债券(含企业债券)专项核查工作中的自查报告。

二、授权委托期限:

该授权有效期自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止, 有效期满后授权人将另行授权。

在授权期限内被授权人应谨慎使用授权, 不得滥用授权或作出有损授权人及公司利益的行为, 被授权人工作职责调整的, 本授权自动失效。

授权人: 吕柏乐

大公国际资信评估有限公司
2025年10月23日

七、发行人董事会关于本次发行的声明及承诺

（一）关于除本次发行可转换公司债券外未来十二个月内其他股权融资计划，发行人董事会作出如下声明

自本次向不特定对象发行可转换公司债券方案被公司股东大会审议通过之日起，公司未来十二个月将根据业务发展情况确定是否实施其他再融资计划。

（二）发行人董事会按照国务院和中国证监会相关规定，对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺

为使公司填补回报措施能够得到切实履行，公司全体董事承诺如下：

“1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

2、承诺对本人的职务消费行为进行约束；

3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；

4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

5、承诺如公司未来实施股权激励方案，则未来股权激励方案的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

6、本承诺出具日后至公司本次向不特定对象发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会、上海证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会、上海证券交易所该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会、上海证券交易所的最新规定出具补充承诺；

7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。”

（三）发行人按照国务院和中国证监会相关规定，对公司填补回报的具体措施作出如下声明

保证本次募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄的风险和提高未来的回报能力，公司拟通过严格执行募集资金管理制度，巩固和提升主营业务，提高募集资金使用

效率，优化内部控制，强化投资者回报机制等措施，提升资产质量，实现可持续发展，以填补股东回报。具体措施如下：

1、完善公司法人治理结构，加强经营管理和内部控制

公司已根据法律法规和规范性文件的规定建立健全了股东大会、董事会及其各专门委员会、监事会、独立董事、董事会秘书和高级管理层的管理结构，夯实了公司经营管理和内部控制的基础。未来几年，公司将严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构。同时，公司将全面有效地控制公司经营和管控风险，继续不断完善并强化各项程序，提升公司的经营管理水平，加强公司内部控制。

2、加强募集资金管理，保障募集资金合理规范使用

公司已根据《公司法》《证券法》和《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定并完善了《斯达半导体股份有限公司募集资金管理制度》。本次可转债的募集资金到位后，将存放于公司董事会决定的专项账户中，公司将定期对募集资金进行检查，并配合监管银行和保荐机构对募集资金使用进行监督，以保证募集资金合理规范使用，合理防范募集资金使用风险。

3、加快募投项目建设进度，提高募集资金使用效率

公司已对本次募集资金投资项目的可行性进行了充分论证，募投项目符合产业发展趋势和国家产业政策，具有较好的市场前景和盈利能力。在本次发行募集资金到位前，为使募集资金投资项目尽快实施，公司将积极调配资源，实施募投项目的建设；本次发行募集资金到位后，公司将加快推进募投项目建设，争取募投项目早日达产并实现预期效益。随着本次募集资金投资项目的实施，公司现有的生产能力和产品品质将得到一定程度上的提高，公司的持续经营能力和盈利能力都将得到进一步增强，本次发行导致的股东即期回报摊薄风险将持续降低。

4、完善利润分配政策，强化投资者回报机制

公司现行《公司章程》中已对利润分配政策进行了明确规定，充分考虑了对投资者的回报，公司将按照《公司章程》及未来三年股东分红回报规划的约定向股东分配股利。未来公司将按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上

市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告〔2025〕5号）等相关文件规定，结合公司实际经营状况和《公司章程》的规定，严格执行现行分红政策，在符合条件的情况下积极推动对广大股东的利润分配以及现金分红，提升股东回报水平。

本次可转债发行完成后，公司将持续完善法人治理结构，合理规范使用募集资金，提高资金使用效率，加快募投项目实施进度，尽快实现项目预期效益。由于公司经营所面临的风险客观存在，上述填补回报措施的制定和实施，不等于对公司未来利润做出保证。

（以下无正文）

（此页无正文，为本募集说明书《发行人董事会声明》之盖章页）

斯达半导体股份有限公司董事会



2025年 6 月 23 日

第十节 备查文件

一、备查文件内容

- （一）发行人最近三年的财务报告及审计报告，以及最近一期的财务报告；
- （二）保荐人出具的发行保荐书、发行保荐工作报告和尽职调查报告；
- （三）法律意见书和律师工作报告；
- （四）董事会编制、股东大会批准的关于前次募集资金使用情况的报告以及会计师出具的鉴证报告；
- （五）资信评级报告；
- （六）其他与本次发行有关的重要文件。

二、备查文件查询时间及地点

投资者可在发行期间每周一至周五上午九点至十一点、下午三点至五点，于下列地点查阅上述文件：

（一）发行人：斯达半导体股份有限公司

办公地址：浙江省嘉兴市南湖区科兴路 988 号

联系人：李君月

电话：0573-82586699

传真：0573-82588288

（二）保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

办公地址：上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 36 层

联系人：郑绪鑫、孟夏

电话：021-20262370

传真：021-20262344

投资者亦可在公司的指定信息披露网站（www.sse.com.cn）查阅本募集说明书全文。

附件一：发行人及其控股子公司专利情况

序号	专利类别	专利号	专利名称	专利权人	申请日期	取得方式	他项权利
1	外观设计	2024306121841	功率半导体模块（塑封的三相桥）	发行人	2024-09-25	原始取得	无
2	发明授权	2024103074320	一种超级结 IGBT 半元胞结构、器件及制备方法	浙江大学, 发行人	2024-03-18	原始取得	无
3	发明授权	2021108064270	一种双工作模式碳化硅功率器件结构及其制作方法	发行人	2021-07-16	原始取得	无
4	实用新型	202421171752X	一种自动拆分焊接夹具机构	发行人	2024-05-27	原始取得	无
5	发明授权	2021107345493	一种带有集成自举电路的 IPM 模块	发行人	2021-06-30	原始取得	无
6	外观设计	2024303704970	功率半导体模块（独立塑封的三相桥）	发行人	2024-06-17	原始取得	无
7	实用新型	202420535034X	一种带模制爬电外凸结构的半导体塑封功率模块	发行人	2024-03-19	原始取得	无
8	外观设计	2024303891591	功率半导体模块（插针式独立塑封）	发行人	2024-06-24	原始取得	无
9	外观设计	2024303705009	功率半导体器件	发行人	2024-06-17	原始取得	无
10	实用新型	2024201057203	一种带水冷散热的基板以及光伏用功率模块	发行人	2024-01-16	原始取得	无
11	实用新型	202420956166X	一种自动贴胶带纸机构	发行人	2024-05-06	原始取得	无
12	实用新型	2024203237855	一种新型功率半导体模块铜带连接结构	发行人	2024-02-21	原始取得	无
13	实用新型	2023233494469	一种半导体功率模块和激光焊接铜端子的焊接设备	发行人	2023-12-08	原始取得	无
14	实用新型	2023231582982	一种水冷散热基板结构	发行人	2023-11-22	原始取得	无
15	实用新型	2023235215520	一种晶圆键合结构	发行人	2023-12-22	原始取得	无
16	实用新型	2023231583006	一种车用功率模块的液冷散热基板	发行人	2023-11-22	原始取得	无
17	实用新型	2023233205365	一种智能功率模块	发行人	2023-12-06	原始取得	无
18	实用新型	2023232214009	一种新型的半导体模组	发行人	2023-11-28	原始取得	无
19	实用新型	2023232052451	一种功率半导体模块烧结用压头	发行人	2023-11-27	原始取得	无
20	实用新型	2023232214013	一种双脉冲测试电路及三电平模块	发行人	2023-11-28	原始取得	无
21	实用新型	2023235036022	一种车用功率模块自动封壳生产线	发行人	2023-12-21	原始取得	无
22	实用新型	2023235036361	一种使用铜线键合表面金属化镀铜芯片的半导体功率模块	发行人	2023-12-21	原始取得	无

序号	专利类别	专利号	专利名称	专利权人	申请日期	取得方式	他项权利
23	实用新型	2023232579173	一种 IPM 老化测试夹具	发行人	2023-11-30	原始取得	无
24	实用新型	2023232375655	一种可调负载电感的功率半导体双脉测试电路	发行人	2023-11-29	原始取得	无
25	实用新型	2023235215658	一种具有针翅散热基板的三电平功率模块	发行人	2023-12-22	原始取得	无
26	实用新型	2023232375689	一种功率模块的驱动测试电路	发行人	2023-11-29	原始取得	无
27	实用新型	2023226216914	一种降低杂散电感的分立器件	发行人	2023-09-26	原始取得	无
28	实用新型	2023232739238	一种双面焊接的功率模块	发行人	2023-12-01	原始取得	无
29	实用新型	2023225608148	一种新型近芯片端连接技术的 IGBT 车用单管功率模块	发行人	2023-09-20	原始取得	无
30	实用新型	2023230021092	一种避免键合线歪斜的智能功率模块封装结构	发行人	2023-11-07	原始取得	无
31	实用新型	2023228121092	一种功率模块封装结构	发行人	2023-10-19	原始取得	无
32	实用新型	2023225608129	一种多孔小板结构 IGBT 真空回流治具	发行人	2023-09-20	原始取得	无
33	外观设计	2023306791834	散热基板（带 Pressfit 针型菱形）	发行人	2023-10-19	原始取得	无
34	实用新型	2023230021088	一种用于半导体模块可靠性实验的连接夹具	发行人	2023-11-07	原始取得	无
35	外观设计	2023306156460	功率半导体模块	发行人	2023-09-20	原始取得	无
36	外观设计	202330770025X	功率模块（单管）	发行人	2023-11-23	原始取得	无
37	实用新型	202322754744X	一种易安装键合机劈刀的结构	发行人	2023-10-13	原始取得	无
38	实用新型	2023227547420	一种镀金银线键合的智能功率模块	发行人	2023-10-13	原始取得	无
39	实用新型	2023225019317	一种具有银浆烧结层的功率模块	发行人	2023-09-14	原始取得	无
40	外观设计	2023306870978	散热基板（菱形单面 sic）	发行人	2023-10-23	原始取得	无
41	实用新型	2023230159350	一种多注胶头封装模具的自动化注塑作业系统	发行人	2023-11-08	原始取得	无
42	外观设计	2023307777162	功率半导体模块（光储用）	发行人	2023-11-27	原始取得	无
43	发明授权	2021102592615	一种利用电子表格的 IGBT 结温迭代快速计算方法	发行人	2021-03-10	原始取得	无
44	外观设计	2023306614399	晶闸管模块外壳	发行人	2023-10-12	原始取得	无
45	外观设计	2023307129865	功率半导体模块	发行人	2023-11-01	原始取得	无
46	外观设计	2023306827677	半导体模块（工业功率）	发行人	2023-10-20	原始取得	无

序号	专利类别	专利号	专利名称	专利权人	申请日期	取得方式	他项权利
47	外观设计	2023307129846	车用功率模块（六单元）	发行人	2023-11-01	原始取得	无
48	外观设计	202330712987X	光伏模块基板（带储水槽）	发行人	2023-11-01	原始取得	无
49	外观设计	202330615648X	水冷散热模块	发行人	2023-09-20	原始取得	无
50	外观设计	2023306977104	功率半导体模块（F6 储水槽）	发行人	2023-10-26	原始取得	无
51	外观设计	2023307129884	功率半导体模块（E6）	发行人	2023-11-01	原始取得	无
52	外观设计	2023307196446	功率半导体模块（N8）	发行人	2023-11-03	原始取得	无
53	实用新型	2023225019321	一种半导体功率模块	发行人	2023-09-14	原始取得	无
54	外观设计	2023307129850	功率模块（集成水道）	发行人	2023-11-01	原始取得	无
55	实用新型	2023223317063	一种自动灌胶烘烤的生产装置	发行人	2023-08-29	原始取得	无
56	实用新型	2023213809112	一种不增加杂散电感的短路保护测试电路	发行人	2023-06-01	原始取得	无
57	实用新型	2023214877761	一种三电平逆变器应用模块	发行人	2023-06-12	原始取得	无
58	实用新型	2022235408745	一种 IGBT 器件	发行人	2022-12-29	原始取得	无
59	实用新型	2023213948064	一种全自动真空灌胶烘烤固化及降温冷却缓存装置	发行人	2023-06-02	原始取得	无
60	实用新型	2023212246740	一种绝缘型功率模块器件的封装结构	发行人	2023-05-19	原始取得	无
61	实用新型	2023213948079	一种具有新型散热结构的功率模块	发行人	2023-06-02	原始取得	无
62	实用新型	2022235564762	一种具有开孔焊片的功率模块	发行人	2022-12-29	原始取得	无
63	实用新型	202223495817X	一种功率半导体模块	发行人	2022-12-27	原始取得	无
64	实用新型	2022234963680	一种可快速修改回路电感的功率测试板	发行人	2022-12-27	原始取得	无
65	发明授权	2017100467402	一种新型压接型功率模块	发行人	2017-01-22	原始取得	无
66	实用新型	2022234319373	一种焊接冲压针的智能功率模块	发行人	2022-12-21	原始取得	无
67	发明授权	2022111963464	一种 SiC 功率器件的栅氧结构制备方法和栅氧结构	浙江大学,浙江大学杭州国际科创中心,发行人	2022-09-29	原始取得	无
68	实用新型	2022235173025	一种折弯夹具	发行人	2022-12-28	原始取得	无
69	实用新型	2022235563632	一种可控制焊料厚度的功率模块引线框架及功率模块结构	发行人	2022-12-29	原始取得	无

序号	专利类别	专利号	专利名称	专利权人	申请日期	取得方式	他项权利
70	发明专利	2017100760107	一种压力接触连接的功率端子及使用方法	发行人	2017-02-13	原始取得	无
71	实用新型	2022235776982	一种电子器件的宇宙射线可靠性测试结构	发行人	2022-12-30	原始取得	无
72	实用新型	2022233117976	一种具有银浆烧结层的功率模块	发行人	2022-12-05	原始取得	无
73	实用新型	2022221667918	一种车用级压接功率模块	发行人	2022-08-17	原始取得	无
74	发明专利	2022111663050	一种 SiCMOSFET 器件及其制备方法	浙江大学杭州国际科创中心,浙江大学,发行人	2022-09-23	原始取得	无
75	实用新型	2022218227556	一种水冷散热器基板	发行人	2022-07-15	原始取得	无
76	实用新型	2022206679001	一种通过键合铝带结合的半导体功率模块	发行人	2022-03-25	原始取得	无
77	实用新型	2021232717418	一种半导体芯片用双面直接水冷模块	发行人	2021-12-20	原始取得	无
78	实用新型	2021228710115	一种具有金属连接框架的功率模块	发行人	2021-11-22	原始取得	无
79	外观设计	2022301270018	车用功率模块（高集成度）	发行人	2022-03-11	原始取得	无
80	实用新型	2021228710242	一种功率半导体模块	发行人	2021-11-22	原始取得	无
81	实用新型	202123248857X	一种带式锡片矫平装置	发行人	2021-12-22	原始取得	无
82	外观设计	2021305294214	无基板半导体芯片（小功率）	发行人	2021-08-16	原始取得	无
83	外观设计	2021305294125	半导体模块装置（变频器用高集成）	发行人	2021-08-16	原始取得	无
84	外观设计	2021305294055	功率半导体模块（黑色 C6 系列）	发行人	2021-08-16	原始取得	无
85	外观设计	2021305293974	功率半导体模块（黑色 C5 系列）	发行人	2021-08-16	原始取得	无
86	实用新型	2021216606356	一种功率半导体模块的新型封装结构	发行人	2021-07-21	原始取得	无
87	实用新型	202120331562X	一种用于超声波金属焊接的焊头结构	发行人	2021-02-05	原始取得	无
88	实用新型	2021203315545	功率模块封装结构	发行人	2021-02-05	原始取得	无
89	实用新型	2021203315634	一种新型高可靠性大功率模块	发行人	2021-02-05	原始取得	无
90	实用新型	2021206787285	一种车用贴装式功率半导体模块	发行人	2021-04-02	原始取得	无
91	实用新型	2021200431328	一种功率模块的半自动测试夹具	发行人	2021-01-08	原始取得	无
92	实用新型	2021203315507	一种使用超音波焊接引线框架的 IPM 模块	发行人	2021-02-05	原始取得	无

序号	专利类别	专利号	专利名称	专利权人	申请日期	取得方式	他项权利
93	实用新型	2021203315687	一种沟槽绝缘栅双极型晶体管的元胞结构	发行人	2021-02-05	原始取得	无
94	实用新型	2021205067499	一种无引线框架的嵌入式 IPM 封装结构	发行人	2021-03-10	原始取得	无
95	实用新型	2021203310043	一种防止端子脱落的插接式功率模块外壳	发行人	2021-02-05	原始取得	无
96	实用新型	2021200431332	一种新型封装的功率模块	发行人	2021-01-08	原始取得	无
97	实用新型	2020231352934	一种功率模块的缺针测试治具	发行人	2020-12-23	原始取得	无
98	实用新型	2020231353532	一种低杂散电感的封装结构	发行人	2020-12-23	原始取得	无
99	外观设计	2021301286168	贴装式功率半导体	发行人	2021-03-10	原始取得	无
100	实用新型	2020231284532	一种高集成 IPM 封装结构	发行人	2020-12-23	原始取得	无
101	实用新型	2020228385398	一种超声波焊接 PIN 针的半导体功率模块	发行人	2020-12-01	原始取得	无
102	外观设计	2021300111700	功率半导体分立器件	发行人	2021-01-08	原始取得	无
103	实用新型	2020213485730	一种沟槽 RC-IGBT 器件结构	发行人	2020-07-10	原始取得	无
104	实用新型	2020203744796	散热基板压凸包装置	发行人	2020-03-23	原始取得	无
105	实用新型	2020203752379	一种沟槽 RC-IGBT 器件结构	发行人	2020-03-23	原始取得	无
106	实用新型	2019220120729	全桥功率模块	发行人	2019-11-20	原始取得	无
107	外观设计	2018307702220	车用半导体功率模块	发行人	2018-12-29	原始取得	无
108	实用新型	2018220246436	车用级高可靠功率模块	发行人	2018-12-04	原始取得	无
109	外观设计	2018307702042	水冷散热功率模块	发行人	2018-12-29	原始取得	无
110	外观设计	2018307715964	功率半导体模块	发行人	2018-12-29	原始取得	无
111	发明授权	2016101365774	一种功率模块连接质量的检测方法	发行人	2016-03-10	原始取得	无
112	实用新型	2018204143722	一种汽车级功率模块用散热结构	发行人	2018-03-23	原始取得	无
113	发明授权	2015102285626	一种用激光阻焊的功率模块	发行人	2015-05-07	继受取得	无
114	实用新型	2018203136007	沟槽栅场截止逆导型 IGBT	发行人	2018-03-07	原始取得	无
115	实用新型	2017214793559	一种功率模块的插接端子	发行人	2017-11-08	原始取得	无
116	实用新型	2017200806727	一种功率半导体模块	发行人	2017-01-22	原始取得	无

序号	专利类别	专利号	专利名称	专利权人	申请日期	取得方式	他项权利
117	发明专利	2014100334197	一种智能半导体功率模块	发行人	2014-01-24	继受取得	无
118	发明专利	201410033389X	一种四象限绝缘栅双极性晶体管模块	发行人	2014-01-24	继受取得	无
119	发明专利	2014100345596	一种功率模块封装结构	发行人	2014-01-25	原始取得	无
120	发明专利	2014100340145	一种带电极压力装置的功率半导体模块	发行人	2014-01-24	继受取得	无
121	发明专利	2014100334464	一种组合式键合外壳	发行人	2014-01-24	继受取得	无
122	发明专利	2014100345577	一种功率半导体用新型金属-陶瓷绝缘基板	发行人	2014-01-25	原始取得	无
123	发明专利	2014100340605	一种将功率半导体模块端子焊接到基板的方法	发行人	2014-01-24	继受取得	无
124	实用新型	2016201825152	集成在散热基板上的双面焊接单面散热功率模块	发行人	2016-03-10	原始取得	无
125	发明专利	2014100339190	一种小功率绝缘栅双极性晶体管全桥模块	发行人	2014-01-24	继受取得	无
126	发明专利	2014100333300	一种便于安装的功率半导体模块	发行人	2014-01-24	继受取得	无
127	实用新型	2016201783361	一种带弹片双层灌胶的功率模块	发行人	2016-03-09	原始取得	无
128	发明专利	2014100332933	一种大功率半桥模块	发行人	2014-01-24	继受取得	无
129	发明专利	2011104499509	功率器件的功率循环系统	发行人	2011-12-29	继受取得	无
130	发明专利	201010543790X	IGBT 器件结构及制备方法	发行人	2010-11-15	原始取得	无
131	发明专利	2011101349374	一种半桥功率模块	发行人	2011-05-24	原始取得	无
132	发明专利	2010105304202	一种新型无底板功率模块	发行人	2010-11-04	继受取得	无
133	发明专利	2010105500814	大厚度氧化层场板结构及其制造方法	发行人	2010-11-10	原始取得	无
134	发明专利	2009100974154	功率端子直接键合的功率模块	发行人	2009-04-02	继受取得	无
135	发明专利	2009100974135	低杂散电感的功率模块	发行人	2009-04-02	继受取得	无
136	发明专利	2009101022473	高集成智能型功率模块	发行人	2009-09-10	继受取得	无
137	发明专利	2009100974116	一种用于绝缘栅双极型晶体管模块的基板	发行人	2009-04-02	继受取得	无
138	发明专利	200910097414X	带门极电阻布局的功率 MOSFET 模块	发行人	2009-04-02	继受取得	无
139	发明专利	2009100974101	新型直接敷铜基板布局的绝缘栅双极性晶体管模块	发行人	2009-04-02	继受取得	无
140	发明专利	2022108337253	一种碳化硅场效应管器件的制作方法	斯达微电子	2022-07-15	原始取得	无

序号	专利类别	专利号	专利名称	专利权人	申请日期	取得方式	他项权利
141	外观设计	2024305851315	功率半导体分立器件	斯达微电子	2024-09-12	原始取得	无
142	实用新型	2024215864994	一种拆分夹具压力传感器保护装置	斯达微电子	2024-07-05	原始取得	无
143	实用新型	2023235891186	一种自动装夹和回收 DBC 的辅助装置	斯达微电子	2023-12-27	原始取得	无
144	实用新型	2023235891171	一种用于拆解直插式部件的电烙装置	斯达微电子	2023-12-27	原始取得	无
145	实用新型	2023231724339	一种 IGBT 模块上信号端子的结构	斯达微电子	2023-11-23	原始取得	无
146	实用新型	2023236062448	一种覆铜陶瓷基板结构	斯达微电子	2023-12-27	原始取得	无
147	实用新型	2023235215501	一种功率模块	斯达微电子	2023-12-22	原始取得	无
148	实用新型	2023235215499	一种塑封功率模块	斯达微电子	2023-12-22	原始取得	无
149	实用新型	2023235652325	一种功率模块焊接时焊盘衬底的固定装置	斯达微电子	2023-12-26	原始取得	无
150	实用新型	2023232579313	一种碳化硅场效应管模块的双脉冲测试装置	斯达微电子	2023-11-30	原始取得	无
151	实用新型	2023231438712	一种可快速修改的电流采样电路及电流测试电路	斯达微电子	2023-11-21	原始取得	无
152	实用新型	2023231438727	一种插装式功率端子的外壳组件	斯达微电子	2023-11-21	原始取得	无
153	实用新型	2023231438642	一种可切换测试管位的绝缘栅双极晶体管测试电路	斯达微电子	2023-11-21	原始取得	无
154	外观设计	2023303865855	功率半导体模块（单管）	斯达微电子	2023-06-21	原始取得	无
155	实用新型	2022232237133	一种 IGBT 模组的双脉冲测试电路	斯达微电子	2022-12-02	原始取得	无
156	实用新型	202223265907X	一种功率半导体模块阻焊结构	斯达微电子	2022-12-07	原始取得	无
157	实用新型	2022231407527	一种用于检测半导体功率模块铜线键合点虚焊的装置	斯达微电子	2022-11-25	原始取得	无
158	实用新型	2022232100408	一种功率模块的连接端子	斯达微电子	2022-12-01	原始取得	无
159	实用新型	2022233522572	一种车用功率模块	斯达微电子	2022-12-12	原始取得	无
160	实用新型	2022232658984	一种功率模块的封装结构	斯达微电子	2022-12-07	原始取得	无
161	实用新型	2022232237010	一种功率模块测试板	斯达微电子	2022-12-02	原始取得	无
162	外观设计	2022307674706	半导体集成模块（C5IPM 定制）	斯达微电子	2022-11-17	原始取得	无
163	外观设计	2022308241247	水功率模块	斯达微电子	2022-12-08	原始取得	无
164	实用新型	202222939348X	一种适配全自动键合机的专用键合夹具	斯达微电子	2022-11-04	原始取得	无

序号	专利类别	专利号	专利名称	专利权人	申请日期	取得方式	他项权利
165	实用新型	2022229385854	一种大功率模块的封装结构	斯达微电子	2022-11-04	原始取得	无
166	外观设计	2022307705121	半导体集成模块（抽屉式）	斯达微电子	2022-11-18	原始取得	无
167	实用新型	2022233015879	一种功率模块的塑壳以及功率模块	斯达微电子	2022-12-07	原始取得	无
168	实用新型	2022229392839	一种铜带键合的环氧塑封车用功率模块封装结构	斯达微电子	2022-11-04	原始取得	无
169	实用新型	2022234957868	一种具有焊接铜排的环氧塑封半桥模块	斯达微电子	2022-12-27	原始取得	无
170	实用新型	2022230569469	一种新能源模块连接结构	斯达微电子	2022-11-17	原始取得	无
171	外观设计	2022307712587	功率半导体模块	斯达微电子	2022-11-18	原始取得	无
172	实用新型	2022227114754	一种 IGBT 过流保护电路	斯达微电子	2022-10-14	原始取得	无
173	外观设计	2022306799992	功率半导体模块（塑封）	斯达微电子	2022-10-14	原始取得	无
174	实用新型	2022231277449	一种低压可控继电器功率模块	斯达微电子	2022-11-24	原始取得	无
175	实用新型	2022227546917	一种超声波焊接引线框架的功率半导体模块	斯达微电子	2022-10-19	原始取得	无
176	实用新型	202223066475X	一种铜带键合的碳化硅车用功率模块封装结构	斯达微电子	2022-11-18	原始取得	无
177	外观设计	2022307815530	功率半导体模块（L2）	斯达微电子	2022-11-22	原始取得	无
178	实用新型	2022221128965	一种弹夹式自动上料机构及双向装配机构	斯达微电子	2022-08-11	原始取得	无
179	实用新型	202222110120X	一种环保无焊料宽禁带高可靠性注塑成型封装模块	斯达微电子	2022-08-11	原始取得	无
180	实用新型	2022206678920	一种智能功率模块	斯达微电子	2022-03-25	原始取得	无
181	实用新型	2022206679139	一种智能功率模块的封装结构	斯达微电子	2022-03-25	原始取得	无
182	实用新型	2022209815879	一种智能功率模块	斯达微电子	2022-04-26	原始取得	无
183	实用新型	2022200199000	一种功率模块用水冷散热基板	斯达微电子	2022-01-05	原始取得	无
184	实用新型	2022200217649	一种绝缘栅双极晶体管及元胞结构	斯达微电子	2022-01-05	原始取得	无
185	外观设计	2024306352687	散热基板（功率模块用）	上海道之	2024-10-09	原始取得	无
186	发明授权	2021102610045	一种大型功率模块的回流夹具结构	上海道之	2021-03-10	原始取得	无
187	实用新型	2023235663989	一种用于方便切除刀口多余铝线铜线的辅助装置	上海道之	2023-12-26	原始取得	无
188	实用新型	2023235652306	一种用于模块信号端子的焊接工具	上海道之	2023-12-26	原始取得	无

序号	专利类别	专利号	专利名称	专利权人	申请日期	取得方式	他项权利
189	发明专利	2021109344457	一种改善反向恢复特性的超结 MOSFET 器件	上海道之	2021-08-16	原始取得	无
190	实用新型	2023235205730	一种功率模块激光打标夹具	上海道之	2023-12-22	原始取得	无
191	实用新型	2023235241953	一种热敏电阻回流焊接的夹具结构	上海道之	2023-12-24	原始取得	无
192	实用新型	202323520568X	一种防元件移位的贴装及烧结结构	上海道之	2023-12-22	原始取得	无
193	发明专利	2021105574182	一种超结 MOSFET 功率器件的版图结构	上海道之	2021-05-21	原始取得	无
194	发明专利	2021111590337	一种混动车用功率模块	上海道之	2021-09-30	原始取得	无
195	发明专利	202110160286X	一种双面焊接的功率模块及焊接工艺	上海道之	2021-02-05	原始取得	无
196	发明专利	2021111585644	一种上下结构的屏蔽栅 MOSFET 器件的制作方法	上海道之	2021-09-30	原始取得	无
197	发明专利	202110823621X	一种新型低电感 SiCMosfet 车用功率模块	上海道之	2021-07-21	原始取得	无
198	发明专利	2021108237392	一种全桥直接水冷 SiC 车用模块	上海道之	2021-07-21	原始取得	无
199	发明专利	2021106965446	一种可提高模块安装可靠性的双面冷却功率模块	上海道之	2021-06-23	原始取得	无
200	发明专利	2021105577015	一种高雪崩耐量的屏蔽栅 MOSFET 器件及其制作方法	上海道之	2021-05-21	原始取得	无
201	实用新型	2023235891152	低杂散电感的大功率半导体模组	上海道之	2023-12-27	原始取得	无
202	实用新型	2023235895238	一种功率半导体装置	上海道之	2023-12-27	原始取得	无
203	实用新型	2023231438661	一种新型功率模块端子	上海道之	2023-11-21	原始取得	无
204	实用新型	2023230021035	一种功率模块的高温性能测试辅助装置	上海道之	2023-11-07	原始取得	无
205	实用新型	2023230292696	一种绝缘栅双极晶体管的驱动电路	上海道之	2023-11-09	原始取得	无
206	实用新型	2023230292658	一种绝缘栅双极型晶体管的分级关断控制电路	上海道之	2023-11-09	原始取得	无
207	实用新型	2023216339034	一种碳化硅器件的终端结构	上海道之	2023-06-26	原始取得	无
208	实用新型	2022233064273	一种可移动旋转的键合后目检装置	上海道之	2022-12-09	原始取得	无
209	实用新型	2021223919105	一种混动车用功率模块	上海道之	2021-09-30	原始取得	无
210	实用新型	2021219068656	一种内嵌安装螺母的注塑功率模块	上海道之	2021-08-16	原始取得	无
211	实用新型	2021216605315	一种功率模块用水冷散热基板	上海道之	2021-07-21	原始取得	无
212	实用新型	2021219067390	一种立式功率端子双面散热功率模块	上海道之	2021-08-16	原始取得	无

序号	专利类别	专利号	专利名称	专利权人	申请日期	取得方式	他项权利
213	外观设计	2021304095904	低电感车用功率模块	上海道之	2021-06-30	原始取得	无
214	外观设计	2021307660380	多合一车用功率模块	上海道之	2021-11-19	原始取得	无
215	外观设计	2021306530464	混动车用功率模块（新型）	上海道之	2021-09-30	原始取得	无
216	实用新型	2021216606498	一种新型低电感 SiC Mosfet 车用功率模块	上海道之	2021-07-21	原始取得	无
217	实用新型	2021216602730	一种全桥直接水冷 SiC 车用模块	上海道之	2021-07-21	原始取得	无
218	实用新型	2021216605531	一种低压屏蔽栅 MOSFET 器件	上海道之	2021-07-21	原始取得	无
219	实用新型	2021216602726	一种带挡墙的水冷散热基板	上海道之	2021-07-21	原始取得	无
220	实用新型	2021216601704	一种汽车级功率模块用散热结构	上海道之	2021-07-21	原始取得	无
221	实用新型	2021216606290	一种混动车用水冷功率模块	上海道之	2021-07-21	原始取得	无
222	外观设计	2021301571595	带散热针车用功率模块（N6）	上海道之	2021-03-23	原始取得	无
223	实用新型	2021213584251	一种全超结 MOSFET 器件结构	上海道之	2021-06-18	原始取得	无
224	外观设计	2021303780010	车用功率模块（新型高功率密度）	上海道之	2021-06-18	原始取得	无
225	外观设计	2021303064114	双面圆针直接水冷车用功率模块	上海道之	2021-05-21	原始取得	无
226	实用新型	202120331587X	车用级高功率集成封装模块	上海道之	2021-02-05	原始取得	无
227	外观设计	2021304096057	塑封车用三相桥功率半导体模块	上海道之	2021-06-30	原始取得	无
228	外观设计	2021303893409	立式功率端子双面冷却半导体模块	上海道之	2021-06-23	原始取得	无
229	外观设计	2021304093824	调压逆变车用功率模块	上海道之	2021-06-30	原始取得	无
230	外观设计	202130389324X	立式功率端子单面冷却半导体模块	上海道之	2021-06-23	原始取得	无
231	实用新型	2021203315899	高可靠性低杂散电感的车用功率模块	上海道之	2021-02-05	原始取得	无
232	实用新型	202120331636X	双面水冷式功率模块	上海道之	2021-02-05	原始取得	无
233	实用新型	2021203315865	银浆烧结双面散热功率模块	上海道之	2021-02-05	原始取得	无
234	实用新型	2021203310221	无引线键合的双面散热 IGBT 模块	上海道之	2021-02-05	继受取得	无
235	实用新型	2021203315742	一种双面焊接的功率模块	上海道之	2021-02-05	原始取得	无
236	实用新型	2020203752398	一种快恢复二极管器件结构	上海道之	2020-03-23	原始取得	无

序号	专利类别	专利号	专利名称	专利权人	申请日期	取得方式	他项权利
237	外观设计	2019303775227	功率半导体模块	上海道之	2019-07-16	原始取得	无
238	实用新型	2019220128805	新型封装的分立器件	上海道之	2019-11-20	原始取得	无
239	外观设计	2019306205282	功率半导体模块（N4）	上海道之	2019-11-12	原始取得	无
240	外观设计	2019306206618	功率半导体模块（S1）	上海道之	2019-11-12	原始取得	无
241	外观设计	2019306401771	功率半导体分立器件	上海道之	2019-11-20	原始取得	无
242	实用新型	2019211105876	一种高集成度的车用级功率模块	上海道之	2019-07-16	原始取得	无
243	实用新型	2019212031992	一种带有内置电流传感器的沟槽 IGBT 器件结构	上海道之	2019-07-29	原始取得	无
244	实用新型	2019211100622	新型封装的分立器件	上海道之	2019-07-16	原始取得	无
245	实用新型	2018201359208	芯片双面焊接的环氧塑封车用功率模块	上海道之	2018-01-26	原始取得	无
246	实用新型	2018201365707	双面散热环氧塑封的车用功率模块	上海道之	2018-01-26	原始取得	无
247	实用新型	2017208638382	水冷绝缘栅双极型晶体管 IGBT 模块	上海道之	2017-07-17	原始取得	无
248	实用新型	201720863840X	一种功率模块用水冷散热基板	上海道之	2017-07-17	原始取得	无
249	实用新型	2017208647911	绝缘栅双极型晶体管模块	上海道之	2017-07-17	原始取得	无
250	实用新型	2017200810794	绝缘栅双极型晶体管模块	上海道之	2017-01-22	原始取得	无
251	实用新型	2017200808277	集成水冷散热器的功率模块	上海道之	2017-01-22	原始取得	无
252	实用新型	2016201783484	一种无铜基板散热的功率模块	上海道之	2016-03-09	原始取得	无
253	实用新型	2016201783450	一种功率半导体模块	上海道之	2016-03-09	原始取得	无
254	实用新型	2016201783499	均热板散热基板功率模块结构	上海道之	2016-03-09	原始取得	无
255	实用新型	2016201825218	一种用于功率模块的卡环固定结构	上海道之	2016-03-10	原始取得	无
256	实用新型	2015208710047	一种具有双缓冲层的 FS 型 IGBT 器件	上海道之	2015-11-04	原始取得	无
257	发明授权	2010105387597	一种功率模块测试夹具	上海道之	2010-11-11	继受取得	无
258	发明授权	2010105403301	一种优化的智能功率模块的功率封装结构	上海道之	2010-11-12	继受取得	无
259	发明授权	2010105304039	一种封装结构的大功率模块	上海道之	2010-11-04	继受取得	无
260	发明授权	2010105304058	一种集成功率半导体功率模块	上海道之	2010-11-04	继受取得	无

序号	专利类别	专利号	专利名称	专利权人	申请日期	取得方式	他项权利
261	发明专利	2010105304170	一种紧凑型功率模块	上海道之	2010-11-04	继受取得	无
262	发明专利	2021113763307	一种功率模块	美垦半导体	2021-11-19	原始取得	无
263	发明专利	2020113840794	智能功率模块、电控组件及空调器	美垦半导体	2020-11-30	继受取得	无
264	发明专利	2020116445477	智能功率模块、变频器及空调器	美垦半导体	2020-12-31	继受取得	无
265	实用新型	2024210764970	智能功率模块和用电设备	美垦半导体	2024-05-16	原始取得	无
266	发明专利	2020108319896	高压集成模块、智能功率模块及其控制方法、空调器	美垦半导体	2020-08-18	继受取得	无
267	实用新型	202322752708X	欠压保护电路和高压集成电路芯片	美垦半导体	2023-10-12	原始取得	无
268	实用新型	2023226961635	智能功率模块及其保护电路、电器设备	美垦半导体	2023-10-07	原始取得	无
269	实用新型	202322752722X	高压集成电路、智能功率模块和电器设备	美垦半导体	2023-10-12	原始取得	无
270	实用新型	2023226700387	功率器件的终端结构和功率器件	美垦半导体	2023-09-28	原始取得	无
271	实用新型	2023202836775	功率模块	美垦半导体	2023-02-21	原始取得	无
272	实用新型	2023210261515	半导体结构及半导体功率器件	美垦半导体	2023-04-28	原始取得	无
273	实用新型	2023210080115	半导体器件	美垦半导体	2023-04-27	原始取得	无
274	发明专利	2022100723518	一种控制方法、装置、变频设备及计算机可读存储介质	美垦半导体	2022-01-21	原始取得	无
275	实用新型	2020231377537	智能功率模块、电控组件及空调器	美垦半导体	2020-12-22	继受取得	无
276	发明专利	2021109353579	放大器电路、芯片、家电设备	美垦半导体	2021-08-16	原始取得	无
277	实用新型	2022216127093	智能功率模块及其具有的智能控制系统	美垦半导体	2022-06-24	原始取得	无
278	实用新型	2022216126940	智能功率模块	美垦半导体	2022-06-24	原始取得	无
279	实用新型	202221612706X	智能功率模块	美垦半导体	2022-06-24	原始取得	无
280	实用新型	2022200806836	集成驱动电路的 IGBT 结构和智能功率模块	美垦半导体	2022-01-13	原始取得	无
281	实用新型	202122976706X	焊盘结构和线路板	美垦半导体	2021-11-30	原始取得	无
282	实用新型	2021228925761	一种功率模块	美垦半导体	2021-11-19	原始取得	无
283	发明专利	2020102432946	功率模块的供电方法、供电装置、功率模块和电子设备	美垦半导体	2020-03-31	继受取得	无
284	发明专利	2019103426757	高集成智能功率模块及其制作方法以及空调器	美垦半导体	2019-04-25	继受取得	无

序号	专利类别	专利号	专利名称	专利权人	申请日期	取得方式	他项权利
285	实用新型	2021225318432	智能功率模块和电器	美垦半导体	2021-10-20	原始取得	无
286	实用新型	2021219968363	半导体结构及绝缘栅双极型晶体管	美垦半导体	2021-08-23	原始取得	无
287	实用新型	2021223835237	功率器件	美垦半导体	2021-09-28	原始取得	无
288	实用新型	2021220557210	智能功率模块及其过流检测电路、家电设备	美垦半导体	2021-08-27	原始取得	无
289	实用新型	2021220518678	功率模块与家电设备	美垦半导体	2021-08-27	原始取得	无
290	实用新型	202121792332X	智能功率模块	美垦半导体	2021-08-03	原始取得	无
291	实用新型	2021206491996	智能功率模块和空调器	美垦半导体	2021-03-30	继受取得	无
292	实用新型	2021213066549	智能功率模块 IPM 及家用电器	美垦半导体	2021-06-11	原始取得	无
293	实用新型	2021213221845	智能功率模块及其驱动电路、家用电器	美垦半导体	2021-06-11	原始取得	无
294	实用新型	2021214097262	过流保护电路、高压驱动芯片、智能功率模块和变频设备	美垦半导体	2021-06-23	原始取得	无
295	实用新型	2021216431845	功率模块以及电器设备	美垦半导体	2021-07-19	原始取得	无
296	实用新型	2021204732343	高集成智能功率模块以及空调器	美垦半导体	2021-03-03	继受取得	无
297	实用新型	202121752369X	智能功率模块以及空调器	美垦半导体	2021-07-29	原始取得	无
298	实用新型	2020233401333	智能功率模块、变频器以及空调器	美垦半导体	2020-12-30	继受取得	无
299	实用新型	2020227158467	温度检测电路、驱动芯片、智能功率模块及空调器	美垦半导体	2020-11-19	继受取得	无
300	实用新型	2021214348646	智能功率模块及变频设备	美垦半导体	2021-06-25	原始取得	无
301	发明授权	2020102541873	脉冲电路、半桥驱动电路、线路板及空调器	美垦半导体	2020-04-02	继受取得	无
302	实用新型	202120939463X	智能功率模块及家用电器	美垦半导体	2021-04-30	原始取得	无
303	实用新型	2021206158635	智能功率模块和空调器	美垦半导体	2021-03-25	继受取得	无
304	实用新型	2020228457752	智能功率模块、电控组件及空调器	美垦半导体	2020-12-01	继受取得	无
305	发明授权	2018101440863	氧化锌半导体材料及其制备方法、半导体器件以及空调器	美垦半导体	2018-02-10	继受取得	无
306	实用新型	2020229145067	高集成智能功率模块及空调器	美垦半导体	2020-12-07	继受取得	无
307	实用新型	2020228303222	高集成智能功率模块及空调器	美垦半导体	2020-11-30	继受取得	无
308	发明授权	201711389932X	绝缘栅双极晶体管、IPM 模块及空调器	美垦半导体	2017-12-18	继受取得	无

序号	专利类别	专利号	专利名称	专利权人	申请日期	取得方式	他项权利
309	发明专利	2019102900248	集成式空调控制器和空调器	美垦半导体	2019-04-11	继受取得	无
310	实用新型	2020233495504	智能功率模块、变频器及空调器	美垦半导体	2020-12-31	继受取得	无
311	实用新型	2020228421623	高集成智能功率模块、电控组件及空调器	美垦半导体	2020-11-30	继受取得	无
312	实用新型	2020225607940	智能功率模块、变频器及空调器	美垦半导体	2020-11-06	继受取得	无
313	发明专利	2019104681423	智能功率模块及空调器	美垦半导体	2019-05-30	继受取得	无
314	发明专利	2019104683378	智能功率模块及空调器	美垦半导体	2019-05-30	继受取得	无
315	发明专利	2018101003772	IGBT 过流保护方法、电路及用电设备	美垦半导体	2018-01-31	继受取得	无
316	实用新型	2020212340912	集成芯片、智能功率模块及空调器	美垦半导体	2020-06-29	继受取得	无
317	发明专利	2018103677905	异质结碳化硅的绝缘栅极晶体管及其制作方法	美垦半导体	2018-04-23	继受取得	无
318	发明专利	2019102284617	空调器及集成式空调控制器	美垦半导体	2019-03-25	继受取得	无
319	实用新型	2020209155691	一种电路封装芯片	美垦半导体	2020-05-26	继受取得	无
320	实用新型	2020200222154	智能功率模块及空调器	美垦半导体	2020-01-06	继受取得	无
321	实用新型	2020200293709	绝缘栅双极型晶体管、智能功率模块及空调器	美垦半导体	2020-01-07	继受取得	无
322	实用新型	2020200294010	智能功率模块、风机控制电路及空调器	美垦半导体	2020-01-07	继受取得	无
323	发明专利	2018102684583	IGBT 管门极电阻调节电路及空调器	美垦半导体	2018-03-28	继受取得	无
324	实用新型	2020200163762	一种智能功率模块及设备	美垦半导体	2020-01-03	继受取得	无
325	实用新型	2019221089920	功率调节装置、电机控制电路及空调器	美垦半导体	2019-11-29	继受取得	无
326	发明专利	2018102640072	智能功率模块及空调器	美垦半导体	2018-03-28	继受取得	无
327	实用新型	2019218783822	高集成智能功率模块及空调器	美垦半导体	2019-11-01	继受取得	无
328	实用新型	2019215784325	电控组件和空调器	美垦半导体	2019-09-20	继受取得	无
329	实用新型	2019217904196	智能功率模块的引脚、引脚组件和智能功率模块	美垦半导体	2019-10-22	继受取得	无
330	实用新型	2019215441414	驱动控制集成器件、驱动控制器以及空调器	美垦半导体	2019-09-17	继受取得	无
331	实用新型	2019221089901	功率封装器件、驱动控制组件和家电设备	美垦半导体	2019-11-29	继受取得	无
332	实用新型	2019218796610	安装基板、智能功率模块及空调器	美垦半导体	2019-11-01	继受取得	无

序号	专利类别	专利号	专利名称	专利权人	申请日期	取得方式	他项权利
333	实用新型	2019219088949	智能功率模块及空调器	美垦半导体	2019-11-06	继受取得	无
334	实用新型	201921569688X	智能功率模块、电控器及空调器	美垦半导体	2019-09-20	继受取得	无
335	实用新型	2019216850165	智能功率模块、智能功率模块的制作设备及空调器	美垦半导体	2019-10-08	继受取得	无
336	发明专利	2017106463316	测试方法、测试装置及计算机可读存储介质	美垦半导体	2017-07-31	继受取得	无
337	实用新型	2019215428180	驱动控制集成器件、驱动控制器以及空调器	美垦半导体	2019-09-17	继受取得	无
338	实用新型	2019215428265	驱动控制集成器件、驱动控制器以及空调器	美垦半导体	2019-09-17	继受取得	无
339	实用新型	2019209118100	电控组件、室外机及空调器	美垦半导体	2019-06-17	继受取得	无
340	实用新型	2019206567004	空调器和集成式控制器	美垦半导体	2019-05-08	继受取得	无
341	实用新型	2019212814812	智能功率模块用基板、智能功率模块、空调器	美垦半导体	2019-08-06	继受取得	无
342	实用新型	2019206565812	空调器和集成式控制器	美垦半导体	2019-05-08	继受取得	无
343	实用新型	2019206567362	空调器和集成式控制器	美垦半导体	2019-05-08	继受取得	无
344	发明专利	2017105160547	回流焊接治具及其制备方法和用途	美垦半导体	2017-06-29	继受取得	无
345	发明专利	2018100528152	智能功率模块、空调器控制器及空调器	美垦半导体	2018-01-19	继受取得	无
346	发明专利	2016110620033	等离子体清洗方法、封装方法、功率模块和空调器	美垦半导体	2016-11-24	继受取得	无
347	实用新型	2019205647745	智能功率模块及空调器	美垦半导体	2019-04-22	继受取得	无
348	实用新型	2019205829141	高集成智能功率模块及空调器	美垦半导体	2019-04-25	继受取得	无
349	实用新型	2018222776329	高集成功率模块和电器	美垦半导体	2018-12-29	继受取得	无
350	实用新型	2018222776367	高集成功率模块和电器	美垦半导体	2018-12-29	继受取得	无
351	实用新型	2018222776348	高集成功率模块和电器	美垦半导体	2018-12-29	继受取得	无
352	实用新型	2018222742074	高集成功率模块和空调器	美垦半导体	2018-12-29	继受取得	无
353	实用新型	2018217916748	电器和智能功率模块	美垦半导体	2018-10-31	继受取得	无
354	实用新型	2018222776210	智能功率模块、电器	美垦半导体	2018-12-29	继受取得	无
355	实用新型	201820918456X	空调器和集成式空调控制器	美垦半导体	2018-06-13	继受取得	无
356	实用新型	2018217916767	电器和智能功率模块	美垦半导体	2018-10-31	继受取得	无

序号	专利类别	专利号	专利名称	专利权人	申请日期	取得方式	他项权利
357	实用新型	2018209184593	空调器和集成式空调控制器	美垦半导体	2018-06-13	继受取得	无
358	实用新型	2018217859660	高集成功率模块和电器	美垦半导体	2018-10-31	继受取得	无
359	实用新型	2018217916644	高集成功率模块和电器	美垦半导体	2018-10-31	继受取得	无
360	实用新型	2018217916625	高集成电控板和电器	美垦半导体	2018-10-31	继受取得	无
361	实用新型	2018209184733	空调器和集成式空调控制器	美垦半导体	2018-06-13	继受取得	无
362	实用新型	2018211912160	智能功率模块的驱动 IC 电路、智能功率模块及空调器	美垦半导体	2018-07-24	继受取得	无
363	实用新型	2018209754864	空调器和功率器件	美垦半导体	2018-06-22	继受取得	无
364	实用新型	2018211911948	高集成智能功率模块和空调器	美垦半导体	2018-07-24	继受取得	无
365	实用新型	2018209184589	空调器和集成式空调控制器	美垦半导体	2018-06-13	继受取得	无
366	实用新型	2018209212521	高集成智能功率模块及空调器	美垦半导体	2018-06-13	继受取得	无
367	实用新型	2017209480662	智能功率模块	美垦半导体	2017-07-31	继受取得	无
368	发明授权	2015101300883	功率模块的制作方法	美垦半导体	2015-03-23	继受取得	无
369	实用新型	2017202954653	智能功率模块和空调器	美垦半导体	2017-03-23	继受取得	无
370	发明授权	201510642116X	智能功率模块和空调器	美垦半导体	2015-09-29	继受取得	无
371	发明授权	2013103775337	铝基线路板及其制备方法、电子元件全封装	美垦半导体	2013-08-23	继受取得	无
372	实用新型	2016212573282	智能功率模块	美垦半导体	2016-11-15	继受取得	无
373	实用新型	2016209130679	智能功率模块、电力电子装置和空调器	美垦半导体	2016-08-19	继受取得	无
374	发明授权	2012103758835	一种智能功率模块的制造方法及智能功率模块	美垦半导体	2012-09-29	继受取得	无
375	发明授权	2012104140539	一种智能功率模块的制造方法及智能功率模块	美垦半导体	2012-10-25	继受取得	无
376	实用新型	2024212417289	一种控制键合引线弧度的装置	浙江谷蓝	2024-06-03	原始取得	无
377	实用新型	2023235664002	一种绝缘分立器件的封装结构	浙江谷蓝	2023-12-26	原始取得	无
378	实用新型	2024211987069	一种可调节式半导体封装切筋成型用刀具	浙江谷蓝	2024-05-29	原始取得	无
379	实用新型	2024210650359	一种备料胶水供应装置	浙江谷蓝	2024-05-16	原始取得	无
380	实用新型	2023235895219	一种基于铝带键合的分立器件	浙江谷蓝	2023-12-27	原始取得	无

序号	专利类别	专利号	专利名称	专利权人	申请日期	取得方式	他项权利
381	实用新型	2023233146441	一种缓冲式超声波焊接端子结构	浙江谷蓝	2023-12-06	原始取得	无
382	实用新型	2023235241949	一种工业级功率模块用散热基板	浙江谷蓝	2023-12-24	原始取得	无
383	实用新型	2023234970195	高可靠性绝缘分立器件	浙江谷蓝	2023-12-21	原始取得	无
384	实用新型	2023235146569	一种功率半导体模块	浙江谷蓝	2023-12-22	原始取得	无
385	实用新型	2023232214032	一种测试电容板及双脉冲测试板	浙江谷蓝	2023-11-28	原始取得	无
386	外观设计	2023308284463	绝缘分立器件（光储用）	浙江谷蓝	2023-12-15	原始取得	无
387	外观设计	2023306977091	双面散热功率模块（水冷和导热硅脂）	浙江谷蓝	2023-10-26	原始取得	无
388	实用新型	2022228959762	一种使用铝包铜线键合 SiC 芯片的功率半导体功率模块	浙江谷蓝	2022-11-01	原始取得	无
389	实用新型	2022235464143	一种马达驱动用贴装式功率半导体模块	浙江谷蓝	2022-12-30	原始取得	无
390	实用新型	2022221101229	一种便于识别金属端子位置的功率模块注塑外壳	浙江谷蓝	2022-08-11	原始取得	无
391	实用新型	2022228960755	功率模块全自动生产线	浙江谷蓝	2022-11-01	原始取得	无
392	外观设计	202230452323X	车用功率模块	浙江谷蓝	2022-07-15	原始取得	无
393	实用新型	2022221128452	一种用于功率半导体单管的绝缘片及半导体结构	浙江谷蓝	2022-08-11	原始取得	无
394	实用新型	2022218251837	一种铜桥焊接的碳化硅车用功率模块	浙江谷蓝	2022-07-15	原始取得	无
395	实用新型	2022218724262	一种多维度的智能功率模块封装结构	浙江谷蓝	2022-07-15	原始取得	无
396	实用新型	2022218722801	一种双面散热的智能功率模块封装结构	浙江谷蓝	2022-07-15	原始取得	无
397	实用新型	2022200512673	一种双焊点半导体器件封装结构	浙江谷蓝	2022-01-10	原始取得	无
398	实用新型	2021229367743	一种集成栅极电阻结构	浙江谷蓝	2021-11-26	原始取得	无
399	实用新型	2021234297261	一种分体式 PIN 针结构	浙江谷蓝	2021-12-31	原始取得	无
400	实用新型	2022202393043	一种功率模块塑壳及其功率模块	浙江谷蓝	2022-01-28	原始取得	无
401	外观设计	2021308752892	车用散热功率模块（PINFIN）	浙江谷蓝	2021-12-30	原始取得	无
402	实用新型	202220239781X	一种功率模块压凸台冲针及装置	浙江谷蓝	2022-01-28	原始取得	无
403	实用新型	2021234202685	一种使用铜线键合的功率模块	浙江谷蓝	2021-12-30	原始取得	无
404	实用新型	2022202393039	一种车用级功率模块用散热基板	浙江谷蓝	2022-01-28	原始取得	无

序号	专利类别	专利号	专利名称	专利权人	申请日期	取得方式	他项权利
405	外观设计	2021308752888	功率半导体模块	浙江谷蓝	2021-12-30	原始取得	无
406	实用新型	2021228676843	一种功率半导体的封装结构	浙江谷蓝	2021-11-22	原始取得	无
407	实用新型	2021234115206	一种固定活动端子的半导体功率模块	浙江谷蓝	2021-12-30	原始取得	无
408	外观设计	2022300096955	半导体模块（大功率水冷散热半导体模块）	浙江谷蓝	2022-01-07	原始取得	无
409	外观设计	2021308776261	功率半导体模块（插接式）	浙江谷蓝	2021-12-30	原始取得	无
410	外观设计	2021306283950	功率半导体模块（无基板）	浙江谷蓝	2021-09-22	原始取得	无

附件二：发行人及其控股子公司商标情况

序号	商标	权利人	注册证号	有效期	核定范围	取得方式	他项权利
1		发行人	15103297	2016.03.07-2026.03.06	9	原始取得	无
2		发行人	6000796	2020.02.07-2030.02.06	9	原始取得	无
3	斯达微	发行人	5980351	2020.01.07-2030.01.06	9	原始取得	无
4	dosemi	上海道之	8641105	2021.09.21-2031.09.20	9	继受取得	无
5	GULAN	浙江谷蓝	79530260	2025.03.28-2035.03.27	9	原始取得	无
6	谷蓝	浙江谷蓝	79531979	2025.03.21-2035.03.20	9	原始取得	无
7	美垦	美垦半导体	55990169	2022.06.21-2032.06.20	9	继受取得	无
8	美垦	美垦半导体	56001919	2021.12.14-2031.12.13	42	继受取得	无
9	美恩	美垦半导体	52958313	2021.08.21-2031.08.20	42	继受取得	无
10	美恩	美垦半导体	52963142	2021.08.21-2031.08.20	9	继受取得	无
11	MSCT	美垦半导体	52741225	2021.12.28-2031.12.27	42	继受取得	无
12	MSCT	美垦半导体	52750803	2021.12.28-2031.12.27	9	继受取得	无

附件三：发行人持有的不动产情况

序号	权利人	权证编号	地址	土地使用权			房屋所有权		他项权利
				面积 (m ²)	使用期限	用途	面积 (m ²)	用途	
1	斯达半导	浙（2025）嘉南不动产权第 0017209 号	嘉兴市南湖区科兴路 988 号	17,741.50	2055.12.31	工业用地	8,749.94	工业	无
2	斯达半导	浙（2025）嘉南不动产权第 0017228 号	嘉兴市南湖区科兴路 988 号 7 幢、8 幢	18,858.70	2055.12.31	工业用地	22,374.11	工业	无
3	斯达半导	浙（2025）嘉南不动产权第 0017572 号	嘉兴市南湖区科兴路 988 号 4 幢、6 幢、9 幢、10 幢、11 幢、12 幢、13 幢	34,214.80	2055.12.31	工业用地	12,051.03	工业	无
4	上海道之	沪（2023）嘉字不动产权第 030161 号	嘉定区清能路 85 号	19,880.00	2063.04.10	工业用地	21,043.80	厂房	无
5	浙江谷蓝	海国用（2015）第 05410 号	海洲街道文康路 7 号	9,685.00	2060.01.13	科研办公用地	/	/	无
6	浙江谷蓝	海宁房权证海房字第 00335592 号	海宁市海洲街道文康路 7 号	/	/	/	533.31	科研办公	无
7	浙江谷蓝	海宁房权证海房字第 00335591 号	海宁市海洲街道文康路 7 号	/	/	/	7,521.04	科研办公	无
8	浙江谷蓝	海宁房权证海房字第 00335590 号	海宁市海洲街道文康路 7 号	/	/	/	2,611.62	科研办公	无
9	斯达微电子	浙（2021）嘉南不动产权第 0060715 号	嘉兴科技城，东至永叙路，南至新大公路，北至驰骋路	95,332.32	2071.04.07	工业用地	正在办理竣工验收手续		无
10	斯达微电子	浙（2021）嘉南不动产权第 0076122 号	嘉兴科技城，东至永叙路，南至钱家港，西至汤金桥港，北至新昌路	64,025.00	2071.09.16	工业用地			无
11	斯达微电子	浙（2021）嘉南不动产权第 0076123 号	嘉兴科技城，东至永叙路，西至汤金桥港，北至钱家港	27,023.00	2071.09.13	工业用地			无
12	重庆安达	渝（2023）高新区不动产权第 001296345 号	高新区西永组团 T 分区 T63/05 地块	27,538.95	2073.12.18	工业用地	主体部分建设施工已完成		无